

DPO7000 시리즈, DPO70000/B 및 DSA70000/B 시
리즈
디지털 포스퍼 오실로스코프
빠른 시작 사용 설명서

Copyright © Tektronix. All rights reserved. 사용 계약한 소프트웨어 제품은 Tektronix나 그 계열사 또는 공급업체가 소유하며 대한민국 저작권법과 국제 조약에 의해 보호됩니다.

Tektronix 제품은 출원되었거나 출원 중인 미국 및 외국 특허에 의해 보호됩니다. 본 출판물에 있는 정보는 이전에 출판된 모든 자료를 대체합니다. 본사는 사양과 가격을 변경할 권리를 보유합니다.

TEKTRONIX 및 TEK는 Tektronix, Inc.의 등록 상표입니다.

FastFrame, OpenChoice, iView, Pinpoint, RT-Eye, MyScope, TekLink, TekVPI 및 MultiView Zoom은 Tektronix, Inc.의 상표입니다.

Tektronix 연락처

Tektronix, Inc.
14200 SW Karl Braun Drive
P.O. Box 500
Beaverton, OR 97077
USA

제품 정보, 영업, 서비스 및 기술 지원에 대한 문의:

- 북미 지역에서는 1-800-833-9200번으로 전화하시면 됩니다.
- 기타 지역에서는 www.tektronix.com에서 각 지역 담당자를 찾으실 수 있습니다.

보증서

Tektronix는 이 제품이 그 재료나 공정 기술에 있어서 결함이 없음을 제품을 구입한 날부터 1년의 기간 동안 보증합니다. 만약 보증 기간 내에 해당 제품에 결함이 있음이 증명될 경우, Tektronix는 옵션에 따라 부품 요금이나 공임을 청구하지 않고 결함 제품을 수리하거나, 결함 제품에 대해 교체품을 제공합니다. 보증 업무를 위해 Tektronix에서 사용하는 부품, 모듈 및 교체 제품은 신품 또는 신품의 성능에 가깝게 수리된 것일 수 있습니다. 모든 교체 부품, 모듈 및 제품은 Tektronix의 재산이 됩니다.

본 보증에 의거하여 서비스를 받으려면, 보증 기간이 만료되기 전에 Tektronix에 결함을 통지하고 서비스 실시 시에 필요한 적절한 준비를 해야 합니다. 고객은 결함 제품을 포장하여 Tektronix에서 지정하는 서비스 센터로 발송해야 합니다. 이때 운송 요금은 선불로 지불해야 합니다. 반송 주소지가 서비스 센터 소재 지역 내에 있는 경우 Tektronix에서는 고객에게 제품을 반송하는 운송 요금을 부담합니다. 기타 지역으로 제품을 반송하는 경우에는 고객이 모든 운송 요금, 관세, 세금 및 기타 비용을 부담합니다.

본 보증은 잘못된 사용 또는 잘못되거나 적절치 못한 유지 보수 및 수리로 인하여 발생한 모든 결함, 고장 또는 손상에 대해서는 적용되지 않습니다. Tektronix는 본 보증에 의해 가) Tektronix 공인 기술자가 아닌 사람에 의한 제품의 설치, 수리 또는 서비스로 인하여 발생한 손상의 수리, 나) 잘못된 사용 또는 호환되지 않는 장비와의 연결로 인하여 발생한 손상의 수리, 다) 타사 소모품의 사용으로 인하여 발생한 손상 또는 고장의 수리 또는 라) 개조나 통합 때문에 제품의 서비스 시간이 길어지거나 어려워진 경우에 서비스를 제공할 책임이 없습니다.

이 보증은 명시적이거나 암시적인 다른 모든 보증을 대신해 이 제품과 관련하여 Tektronix에 의해 제공됩니다. Tektronix와 판매업체는 시장성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 어떠한 묵시적 보증도 거부합니다. 결함 제품에 대한 Tektronix의 수리 또는 교체 책임이 본 보증의 위반에 대해 고객에게 제공되는 유일한 보상입니다. Tektronix와 판매업체는 어떤 간접적이거나 특수하거나 부수적이거나 결과적인 손해에 대해 책임을 지지 않으며, 이는 Tektronix와 판매업체가 그와 같은 손해의 가능성을 사전에 통지했든 통지하지 않았든 마찬가지입니다.

[W2 - 15AUG04]

목차

일반 안전 사항 요약	v
표준 준수 정보	vii
EMC 표준 준수	vii
안전 표준 준수	ix
환경 고려 사항	xi
머리말	xii
주요 기능	xii
설명서	xiii
이 설명서에서 사용하는 규약	xiv
장비 설치	1
표준 액세스리	1
작동 요구 사항	2
ESD 방지	4
장비 전원 켜기	5
장비 끄기	7
전원 끄기	7
네트워크에 연결	8
두 번째 모니터 추가	9
운영 체제 복구 CD-ROM 만들기	12
장비에 익숙해지기	13
전면 패널	13
측면 및 후면 패널	14
인터페이스 및 디스플레이	16
제어판	18
온라인 도움말 액세스	19
메뉴 및 제어창 액세스	20
장비 검사	21
내부 진단 통과 확인	21
획득	23
신호 경로 보정	23
신호 입력 설정	25
기본값 설정 사용	26
자동 설정 사용	27
프로브 보정, 교정 및 지연시간 보정	28
획득 개념	28
획득 모드 작동 원리	31
획득 모드 변경	32
획득 시작 및 정지	33
수평 모드 선택	33
고속 획득 사용	35
DSP 향상된 대역폭 사용	36
롤 모드 사용	39

FastFrame 모드 사용	40
FastFrame 프레임 검색기 사용	43
TekLink 및 MultiScope 트리거 사용	44
Pinpoint 트리거	48
트리거링 개념	48
트리거 유형 선택	50
Pinpoint 트리거 선택	51
트리거 상태 확인	53
A(주) 트리거 및 B(지연) 트리거 사용	54
트리거 시 전자 우편 전송	57
수평 지연 사용	57
파형 표시	59
화면 형태 설정	59
화면 지속 설정	60
디스플레이 형식 설정	62
파형 보간 선택	63
화면 문자 추가	63
계수선 유형 설정	65
트리거 레벨 마커 설정	66
날짜 및 시간 표시	66
컬러 팔레트 사용	67
기준 색 설정	68
Math 색 설정	68
MultiView Zoom 사용	69
여러 영역 확대	70
확대된 파형 잠금 및 스크롤	71
확대된 창에서 파형 숨기기	73
파형 검색 및 표시	74
파형 분석	82
자동 측정 수행	82
자동 측정 선택	84
자동 측정 사용자 정의	86
커서 측정	90
히스토그램 설정	93
Math 파형 사용	94
스펙트럼 분석 사용	97
마스크 테스트 사용	100
한계 테스트 사용	104
MyScope	106
새 MyScope 제어창 작성	106
MyScope 제어창 사용	110
정보 저장 및 호출	113
화면 포착 저장	113
파형 저장	114
파형 호출	116

장비 설정 저장.....	117
장비 설정 호출.....	118
측정값 저장	119
결과를 클립보드에 복사	121
하드 카피 인쇄.....	123
애플리케이션 소프트웨어 실행	125
애플리케이션 예제.....	127
일시적인 이상 포착.....	127
효과적인 문서화를 위한 확장 데스크톱 및 OpenChoice 구조 사용.....	130
버스 트리거	132
비디오 신호에서 트리거링	133
이벤트 시 전자 우편 설정	135
Tektronix 오실로스코프 및 로직 분석기 간의 데이터 상호 연계.....	137
한계 테스트를 사용한 성능 확인	138
청소.....	141
색인	

일반 안전 사항 요약

다음 안전 예방책을 확인하여 부상을 방지하고 본 제품이나 관련 제품의 손상을 예방합니다.

잠재적인 부상 위험을 방지하려면 이 제품을 지정된 대로만 사용합니다.

전문 직원만이 서비스 절차를 실시해야 합니다.

이 제품을 사용하는 동안 더 큰 시스템의 다른 부품에 접근해야 할 경우가 있습니다. 시스템 작동에 관련된 경고 및 주의 사항에 대해서는 다른 구성 요소 설명서의 안전 사항 관련 절을 읽으십시오.

화재 또는 부상을 방지하려면

적절한 전원 코드를 사용합니다. 본 제품용으로 지정되고 사용하는 국가에 승인된 전원 코드만 사용합니다.

적절하게 연결하고 분리합니다. 전압 소스에 연결되어 있는 상태에서 프로브 또는 테스트 리드를 연결하거나 분리하지 않습니다.

제품을 접지합니다. 본 제품은 전원 코드의 접지 도체를 통해 접지됩니다. 감전을 예방하려면 접지 도체를 접지에 연결해야 합니다. 제품의 입력이나 출력 단자에 연결하기 전에 제품이 적절히 접지되었는지 확인합니다.

모든 단자 정격을 준수합니다. 화재나 충격 위험을 피하기 위해 모든 정격과 제품의 표시를 준수합니다. 제품에 연결하기 전에 제품 설명서를 참조하여 추가 정격 정보를 확인하십시오.

메인 또는 범주 II, III, IV 회로에 연결하는 경우에는 입력이 작동하지 않습니다.

프로브 기준 리드선은 접지에만 연결합니다.

전원을 끕니다. 전원 코드를 사용하여 제품의 전원을 끕니다. 사용자가 항상 전원 스위치에 액세스할 수 있도록 전원 코드를 차단하지 마십시오.

덮개 없이 작동하지 않습니다. 덮개나 패널을 제거한 상태로 본 제품을 작동하지 않습니다.

고장이 의심되는 제품은 작동하지 마십시오. 제품이 손상된 것으로 여겨지는 경우에는 전문요원의 검사를 받습니다.

노출된 회로를 만지지 않습니다. 전원이 공급 중일 때는 노출된 연결부와 구성품을 만지지 않습니다.

촉촉하고 습기가 많은 환경에서 사용하지 않습니다.

폭발 위험이 있는 장소에서 사용하지 않습니다.

제품 표면을 깨끗하고 건조하게 유지합니다.

적절히 환기합니다. 적절히 환기되도록 제품을 설치하는 자세한 내용은 설명서의 설치 지침을 참조하십시오.

이 설명서의 용어

다음 용어가 본 설명서에 나올 수 있습니다.



경고. 경고문은 부상이나 사망을 초래할 수 있는 조건이나 상황을 명시합니다.



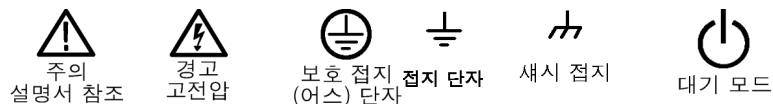
주의. 주의문은 본 제품 또는 기타 재산상에 피해를 줄 수 있는 조건이나 상황을 명시합니다.

제품에 있는 기호 및 용어

다음 용어가 제품에 나올 수 있습니다.

- 위험은 표지를 읽는 즉시 영향을 받을 수 있는 부상 위험을 나타냅니다.
- 경고는 표지를 읽는 즉시 영향을 받지 않는 부상 위험을 나타냅니다.
- 주의는 제품을 포함한 재산상의 위험을 나타냅니다.

다음 기호가 제품에 나올 수 있습니다.



표준 준수 정보

이 절에서는 장비가 준수하는 EMC(전자 환경 양립성), 안전 및 환경 표준에 대해 설명합니다.

EMC 표준 준수

EC 적합성 선언 – EMC

전자 환경 양립성에 대한 Directive 2004/108/EC의 취지에 부합합니다. 유럽 공동체의 공식 저널에 실려 있는 다음 사양에 대한 표준 준수 여부가 증명되었습니다.

EN 61326-1:2006, EN 61326-2-1:2006: 측정, 제어 및 실험실용 전기 장비에 대한 EMC 요구 사항 ^{1 2 3}

- CISPR 11:2003. 복사성 및 전도성 방출, 그룹 1, A 등급
- IEC 61000-4-2:2001. 정전기 방전 차단
- IEC 61000-4-3:2002. RF 전자기장 차단 ⁴
- IEC 61000-4-4:2004. 전기 고속 과도 전류/버스트 차단
- IEC 61000-4-5:2001. 전원선 서지 차단
- IEC 61000-4-6:2003. 전도된 RF 차단 ⁴
- IEC 61000-4-11:2004. 전압 하락과 중단 차단 ⁵

EN 61000-3-2:2006: AC 전원선 고조파 방출

EN 61000-3-3:1995: 전압 변화, 변동 및 깜박거림

유럽 연락처:

Tektronix UK, Ltd.
Western Peninsula
Western Road
Bracknell, RG12 1RF
United Kingdom

- 1 본 제품은 비주거 지역에서만 사용하도록 만들어졌습니다. 주거 지역에서 사용하면 전자파 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 2 이 장비를 테스트 대상에 연결할 때 이 표준에서 요구하는 레벨을 초과하는 방출이 발생할 수 있습니다.
- 3 상호 접속 케이블을 사용하는 경우 012-0991-01, 012-0991-02, 012-0991-03 GPIB 케이블, 012-1213-00(또는 CA 부품 번호 0294-9) RS-232 케이블, 012-1214-00 Centronics 케이블 또는 LCOM 부품 번호 CTL3VGAMM-5 VGA 케이블 등의 Tektronix 부품 번호 또는 동급 제품과 같은 저 EMI 피복 케이블을 사용해야 합니다. 기준 출력 커넥터의 경우에는 012-0482-00 케이블을 사용하십시오.
- 4 오실로스코프가 지속적으로 나타나는 전자기 현상의 영향을 받는 경우 성능 기준: 10mV/구간 – 1V/구간, ≤0.4 구간의 파형 변위 또는 ≤0.8 구간의 피크-피크 노이즈 증가. 오실로스코프가 과도한 전자기 현상의 영향을 받는 경우 성능 기준: 일시적이며 자체 복구 가능한 성능 저하 또는 손실은 허용되지만 실제 작동 상태 변경 또는 저장된 데이터의 손실은 허용되지 않습니다.
- 5 성능 기준 C가 70%/25사이클 전압-하락 및 0%/250사이클 전압-중단 테스트 레벨(IEC 61000-4-11)에 적용되었습니다. 전압 하락 또는 중단으로 인해 장비 전원이 꺼지면 재부팅하는 데 10초 이상 걸립니다.

호주/뉴질랜드 적합성 선언 - EMC

다음 표준에 대해 EMC 무선 통신법 조항을 준수합니다.

- EN 61326-1:2006 및 EN 61326-2-1:2006에 따른 CISPR 11:2003. 복사성 및 전도성 방출, 그룹 1, A 등급

안전 표준 준수

EC 적합성 선언 - 저전압

유럽 공동체의 공식 저널에 실려 있는 다음 사양에 대한 규정 준수 여부가 증명되었습니다.

저전압 Directive 2006/95/EC

- EN 61010-1: 2001. 측정 제어 및 실험용 전기 장비에 대한 안전 요구 사항

미국 국가 공인 테스트 실험실 목록

- UL 61010-1:2004, 2nd Edition. 전기 측정 및 테스트 장비용 표준

캐나다 인증

- CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1:2004. 측정, 제어 및 실험용 전기 장비에 대한 안전 요구 사항 1부

추가 규정 준수

- IEC 61010-1: 2001. 측정, 제어 및 실험용 전기 장비에 대한 안전 요구 사항

장비 유형

테스트 및 측정 장비

안전 등급

등급 1 - 접지 제품

오염 지수 설명

제품 주변 및 제품 내의 환경에서 발생할 수 있는 오염 정도를 측정합니다. 일반적으로 제품 내부 환경과 외부 환경은 동일한 것으로 간주됩니다. 제품은 해당 제품에 대한 등급이 지정된 환경에서만 사용해야 합니다.

- 오염 지수 1. 오염이 없거나 확산되지 않는 약한 오염만이 발생합니다. 이 범주에 속하는 제품은 보통 캡슐화 또는 밀봉되어 있거나 청결한 공간에 배치되어 있습니다.
- 오염 지수 2. 일반적으로 비전도성 건조 오염만이 발생합니다. 가끔 응축으로 인해 발생하는 일시적인 오염 확산이 발생할 수도 있으며, 위치는 일반적인 사무실/가정 환경입니다. 일시적인 응축 현상은 제품을 사용 중이지 않을 때만 발생합니다.
- 오염 지수 3. 응축으로 인해 전도성 오염 또는 전도성이 될 수 있는 비전도성 건조 오염이 발생하며, 위치는 온도와 습도가 모두 제어되지 않는 격리된 위치입니다. 그러나 직사 광선이나 직접적인 비바람으로부터는 보호됩니다.
- 오염 지수 4. 전도성 먼지나 눈비를 통해 지속적인 전도성 물질을 생성하는 오염 형태입니다. 보통 실외입니다.

오염 지수

오염 지수 2(IEC 61010-1에 정의됨) 참고: 실내 사용 전용 등급입니다.

설치(과전압) 범주 설명

본 제품의 단자에는 서로 다른 설치(과전압) 범주가 지정되어 있습니다. 설치 범주는 다음과 같습니다.

- 측정 범주 IV. 저전압 설치 소스에서 수행하는 측정용
- 측정 범주 III. 건물 설치에서 수행하는 측정용
- 측정 범주 II. 저전압 설치에 직접 연결된 회로에 대해 수행하는 측정용
- 설치 범주 I. MAINS에 직접 연결되지 않은 회로에 대해 수행하는 측정용

과전압 범주

기본: 과전압 범주 II

측정 입력: 과전압 범주 I

IEC 61010-1에 정의되어 있습니다.

환경 고려 사항

이 절에서는 제품이 환경에 미치는 영향에 대한 정보를 제공합니다.

제품 폐기 처리

장비나 구성 요소를 재활용할 때 다음 지침을 준수하십시오.

장비 재활용: 이 장비를 생산하기 위해 천연 자원을 추출하여 사용했습니다. 제품을 잘못 폐기하면 장비에 들어 있는 물질이 환경이나 인간의 건강에 해를 끼칠 수 있습니다. 이러한 물질이 환경에 침투하는 것을 막고 천연 자원의 사용량을 줄이기 위해서는 대부분의 재료가 올바르게 재사용 또는 재활용되도록 적절한 시스템에서 이 제품을 재활용하는 것이 좋습니다.



이 기호는 본 제품이 WEEE(폐전기전자 지침) 및 배터리에 대한 Directive 2002/96/EC 및 2006/66/EC에 의거하여 적용 가능한 유럽 연합의 요구 사항을 준수함을 나타냅니다. 재활용 옵션에 대한 자세한 내용은 Tektronix 웹 사이트(www.tektronix.com)의 지원/서비스 절을 확인하십시오.

수은에 대한 알림: 본 제품은 수은이 포함된 LCD 백라이트 램프를 사용합니다. 제품 폐기는 환경 고려 사항에 의해 규제될 수 있으므로, 폐기 또는 재활용 정보는 해당 지역의 관할 기관이나 미국의 경우 E-cycling Central 웹 페이지(www.eiae.org)에 문의하십시오.

과염소산염 자재: 이 제품에는 하나 이상의 CR 리튬 배터리가 포함되어 있습니다. 캘리포니아 주에 따르면 CR 리튬 배터리는 과염소산염 자재로 분류되며 특별한 취급을 요합니다. 자세한 내용은 www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate를 참조하십시오.

유해 물질에 대한 제한

본 제품은 모니터링 및 제어 장비로 분류되며 2002/95/EC RoHS Directive 규정의 적용을 받지 않습니다.

머리말

이 설명서에서는 DPO7000 시리즈, DSA70000/B 시리즈 및 DPO70000/B 시리즈 장비의 설치 및 작동에 대해 설명합니다. 기본적인 운영 방법과 개념에 대해서도 설명하지만 보다 자세한 내용은 장비 온라인 도움말을 참조하십시오. 이 설명서에서는 다음 장비가 지원됩니다.

- DPO72004/B 및 DSA72004/B
- DPO71604/B 및 DSA71604/B
- DPO71254/B 및 DSA71254/B
- DPO70804/B 및 DSA70804/B
- DPO70604/B 및 DSA70604/B
- DPO70404/B 및 DSA70404/B
- DPO7354
- DPO7254
- DPO7104
- DPO7054

주요 기능

DPO7000, DSA70000/B 및 DPO70000/B 시리즈 장비를 사용하면 전자 장비의 설계를 쉽게 확인하고 디버그하고 특성화할 수 있습니다. 이 장비의 주요 기능은 다음과 같습니다.

- DPO72004/B 및 DSA72004/B의 모든 채널에 대한 20GHz 대역폭 및 50GS/s 실시간 샘플링 속도
- DPO71604/B 및 DSA71604/B의 모든 채널에 대한 16GHz 대역폭 및 50GS/s 실시간 샘플링 속도
- DPO71254/B 및 DSA71254/B의 모든 채널에 대한 12.5GHz 대역폭 및 50GS/s 실시간 샘플링 속도
- DPO70804/B 및 DSA70804/B의 모든 채널에 대한 8GHz 대역폭 및 25GS/s 실시간 샘플링 속도
- DPO70604/B 및 DSA70604/B의 모든 채널에 대한 6GHz 대역폭 및 25GS/s 실시간 샘플링 속도
- DPO70404/B 및 DSA70404/B의 모든 채널에 대한 4GHz 대역폭 및 25GS/s 실시간 샘플링 속도
- DPO7354의 모든 채널에 대한 3.5GHz 대역폭 및 10GS/s 실시간 샘플링 속도, 1개 채널에 대한 40GS/s 실시간 샘플링 속도
- DPO7254의 모든 채널에 대한 2.5GHz 대역폭 및 10GS/s 실시간 샘플링 속도, 1개 채널에 대한 40GS/s 실시간 샘플링 속도
- DPO7104의 모든 채널에 대한 1GHz 대역폭 및 5GS/s(옵션 10GS/s) 실시간 샘플링 속도, 1개 채널에 대한 20GS/s(40GS/s 옵션) 실시간 샘플링 속도
- DPO7054의 모든 채널에 대한 500 MHz 대역폭 및 2.5GS/s(옵션 5GS/s) 실시간 샘플링 속도, 1개 채널에 대한 10GS/s(20GS/s 옵션) 실시간 샘플링 속도
- 대역폭을 확장하고 패스밴드를 평준화할 수 있는 DSP(디지털 신호 처리) 필터를 적용할 수 있는 향상된 대역폭 기능. 향상된 대역폭 기능은 활성화된 채널의 샘플링 속도가 최대일 때 해당 채널 전체에 대해 일치하는 응답을 제공합니다. 노이즈 대 신호 비율을 최적화하기 위한 최대 대역폭

으로 500MHz까지 1GHz씩 대역폭을 제한할 수 있습니다. 일부 고성능 프로브 및 팁의 경우 항상 된 대역폭은 프로브 팁까지 확장됩니다.

- 최대 5억 개 샘플의 레코드 길이(모델 및 옵션에 따라 다름)
- 최대 1.0%의 DC 수직 게인 정밀도(모델에 따라 다름)
- 고해상도 모드가 아닐 때 각각 8비트 해상도인 4개 입력 채널, 보조 트리거 입력 및 출력
- 샘플, 엔벨로프, 피크 검출, 고해상도, 파형 데이터베이스, 평균 및 고속 획득 모드
- 포괄적인 GPIB 명령 집합 및 메시지 기반 인터페이스를 통한 완벽한 프로그래밍 기능
- A 및 B 트리거 이벤트에 대해 모두 선택할 수 있는 에지, 로직, 펄스(로직 검정되었을 수 있음) 트리거 유형. 윈도우 트리거 모드는 트리거 소스가 정의된 윈도우 내외부를 통과할 때 트리거됩니다. 트리거는 로직 검정되었을 수 있습니다. 로직 입력이 클럭에 상대적으로 셋업 앤 홀드 시간 내에 상태를 변경하면 셋업 앤 홀드 트리거 모드가 트리거됩니다. 트리거 지터는 모델에 따라 다르며 1ps RMS(편의 사양) 이하입니다. 보통 폭이 200ps 이하인 글리치 또는 펄스에서 트리거할 수 있습니다. 일부 모델 또는 옵션에서 저속 직렬 트리거, 직렬 패턴 트리거 및 패턴 잠금 트리거를 사용할 수 있습니다. 선택할 수 있는 트리거 위치 보정을 통해 더 정확하게 트리거를 배치하고 지터를 줄일 수 있습니다.
- 히스토그램, 자동 측정, 아이 패턴 측정 및 측정 통계를 포함하는 강력한 내장 측정 기능
- 파형의 수학적 결합을 통해 데이터 분석 작업을 지원하는 파형 작성. 연산 등식에는 임의 필터를 사용합니다. 스펙트럼 분석을 사용하여 주파수 도메인에서 파형을 분석합니다.
- 샘플 밀도를 표시하도록 파형 데이터의 컬러 그레이딩을 지원하는 대형 12.1인치(307.3mm) 고해상도 XGA 컬러 디스플레이. 수직 및 수평으로 10개 구간을 표시합니다.
- 한 번에 최대 4개 확대 영역을 표시하여 비교할 수 있는 MultiView Zoom. 최대 4개 확대 영역을 잠가 두고 수동 또는 자동으로 스크롤할 수 있습니다. 줌 창 내에서 파형의 가시성을 제어할 수 있습니다.
- 파형에서 원하는 포인트를 자동으로 찾아서 참조할 수 있도록 자동 이벤트 검색 및 사용자 표시
- DDR 메모리 기술 분석 옵션을 사용한 자동 DDR 분석
- 사용자 정의 가능한 MyScope 제어창
- 구간당 시간과 별개로 샘플 속도 및 레코드 길이 제어 가능
- 화면에서 사용 가능한 내장 온라인 도움말이 포함된 이해하기 쉬운 그래픽 UI(사용자 인터페이스)
- 이동식 내부 디스크 스토리지
- 광범위한 프로빙 솔루션

설명서

이 제품에 대해 사용할 수 있는 여러 가지 유형의 정보를 얻을 수 있는 위치를 확인하려면 아래 내용을 검토해 보십시오.

읽을 내용

설치 및 작동(개요)

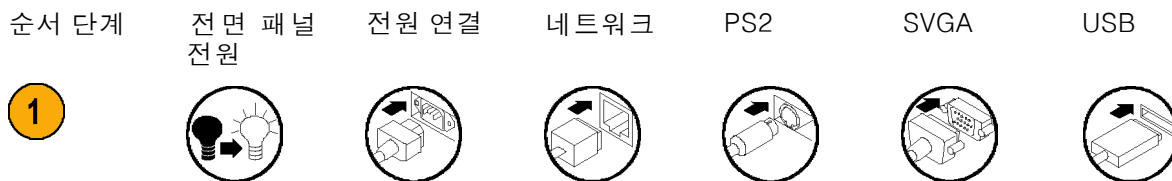
사용할 문서

빠른 시작 사용 설명서. 일반 작동 정보를 제공합니다.

읽을 내용	사용할 문서
심층적인 작동 및 사용자 인터페이스 도움말	온라인 도움말. 장비 기능 사용을 위한 자세한 지침을 제공합니다. 도움말 버튼을 누르거나 도움말 메뉴를 통해 온라인 도움말에 액세스하여 제어 및 요소에 대한 정보를 화면에서 확인할 수 있습니다. (19페이지의 <i>온라인 도움말 액세스</i> 참조)
프로그래머 명령	프로그래머 안내(제품 소프트웨어 DVD에 포함). GPIB 명령의 구문이 들어 있습니다.
서비스 정보	서비스 설명서(제품 소프트웨어 DVD 및 설명서 브라우저에 포함)
분석 및 연결 도구	Getting Started with OpenChoice Solutions Manual (OpenChoice 솔루션 시작 설명서) 장비에서 사용 가능한 다양한 연결 및 분석 도구에 대한 정보를 제공합니다.

이 설명서에서 사용하는 규약

다음 아이콘은 이 설명서 전체에서 사용됩니다.



장비 설치

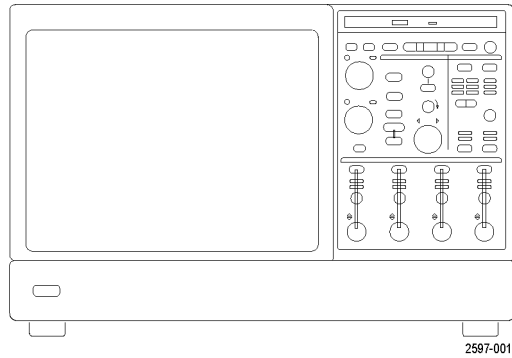
장비의 포장을 풀고 기본 액세서리 목록에 있는 모든 항목을 받았는지 확인합니다. 권장 액세서리, 프로브, 장비 옵션 및 업그레이드는 온라인 도움말의 목록에 나와 있습니다. 최신 정보는 Tektronix 웹 사이트(www.tektronix.com)에서 확인하십시오.

표준 액세서리

액세서리	Tektronix 부품 번호	
DPO7000, DSA70000/B 및 DPO70000/B 디지털 포스퍼 오실로스코프 빠른 시작 사용자 설명서	071-2597-xx	
DPO7000, DSA70000/B 및 DPO70000/B 제품 소프트웨어 DVD	020-2693-xx	
애플리케이션 소프트웨어 DVD 및 설명서 키트(옵션)	020-2700-xx	
온라인 도움말(제품 소프트웨어 일부분)	—	
성능 확인(제품 소프트웨어 DVD의 PDF 파일)	—	
프로그래머 온라인 안내(제품 소프트웨어 DVD의 파일)	—	
NIST, Z540-1 및 ISO9000 교정 인증서	—	
10X 패시브 프로브 4개(500MHz 모델, DPO7054 전용)	P6139A	
한 개의 TekConnect 어댑터, 4GHz 이상 모델에만 해당	TCA-BNC	
네 개의 TekConnect 어댑터, 4GHz 이상 모델에만 해당	TCA-292MM	
키보드, 4GHz 이상 모델에만 해당	119-7083-xx	
광마우스	119-7054-xx	
전면 덮개	200-4963-xx	
액세서리 주머니	4GHz 미만 모델: 016-1966-xx 4GHz 이상 모델: 016-1441-xx	
Nero OEM 소프트웨어 CD	063-3781-xx	
전원 코드	다음 중 하나입니다.	4GHz 미만 모델 4GHz 이상 모델
	북미(옵션 A0)	161-0104-00 161-0213-00
	전 유럽(옵션 A1)	161-0104-06 161-0209-00
	영국(옵션 A2)	161-0104-07 161-0210-00
	오스트레일리아(옵션 A3)	161-0104-05 161-0211-01
	스위스(옵션 A5)	161-0167-00 161-0212-00
	일본(옵션 A6)	161-A005-00 161-0213-00
	중국(옵션 A10)	161-0306-00 161-0320-00
	인도(옵션 A11)	161-0324-00 161-0325-00
	전원 코드 또는 AC 어댑터 없음(옵션 A99)	— —

작동 요구 사항

1. 정비 요구 사항과 치수에 유의하여 장비를 카트 또는 벤치 위에 놓습니다.



	4GHz 미만 모델	4GHz 이상 모델
■ 상단:	0mm(0인치)	0mm(0인치)
■ 왼쪽 및 오른쪽:	76mm(3인치)	76mm(3인치)
■ 하단:	0mm(0인치), 플립을 아래쪽으로 하여 다리로 세움	0mm(0인치), 플립을 아래쪽으로 하여 다리로 세움
■ 후면:	0mm(0인치), 후면 걸쇠에 놓음	0mm(0인치), 후면 걸쇠에 놓음
2. 폭:	456mm(17.96인치)	451mm(17.75인치)
3. 높이:	277mm(10.9인치)	292mm(11.48인치)
4. 장비를 작동하기 전에 주변 온도를 확인하십시오.	+5°C - +45°C(+41°F - +113°F)	+5°C - +45°C(+41°F - +113°F)
5. 작동 습도를 확인하십시오.	+45°C(+113°F) 이하에서 최대 습구 온도 +29°C(+84°F)인 경우 8% - 80% 상대 습도, 비응축식 +45°C(+113°F)에서는 상한을 30% 상대 습도로 줄임	최대 +32°C(+90°F)까지 8% - 80% 상대 습도 +32°C(+90°F) 이상 최대 +45°C(+113°F)까지 5% - 45% 상대 습도, 비응축식, 최대 습구 온도 +29.4°C(+85°F)에 의해 제한됨(+45°C(+113°F)에서 상대 습도를 32%로 줄임)
6. 작동 고도를 확인하십시오.	4GHz 미만 모델 : 3,000m(9,843ft)	4GHz 이상 모델 : 3,000m(9,843ft), 1,500m(4,921.25ft) 고도부터 300m(984.25ft) 올라갈 때마다 1°C씩 최대 작동 온도를 줄입니다.

7. 최대 입력 전압, 4GHz 초과 모델:

50Ω

5V_{rms}, 피크 ±24V 이하

1MΩ

150V, 200KHz 초과, 20dB/decade에서 9V_{rms}로 줄입니다. 중앙 도체 및 접지 사이에서 BNC의 최대 입력 전압은 400V 피크입니다. DC를 포함한 임의 파형의 경우 RMS 전압이 150V 미만으로 제한됩니다. 150V 초과 피크를 가진 임펄스의 경우 최대 펄스 폭은 50μs입니다. 예를 들면 0V - 400V 피크, 직사각형 파형에서 듀티 계수는 14%입니다. 일시적 절연 내압(withstand voltage)의 최대값은 ±800V 피크입니다.

최대 입력 전압, 4GHz 이상 모델:

50Ω

1V/FS 미만 설정에 대해 1V_{rms} 미만 그리고 1 V/FS 이상 설정에 대해 5.5V_{rms} 미만



주의. 적절한 냉각을 위해서는 장비 양쪽 및 하단에 장애물이 없어야 합니다.

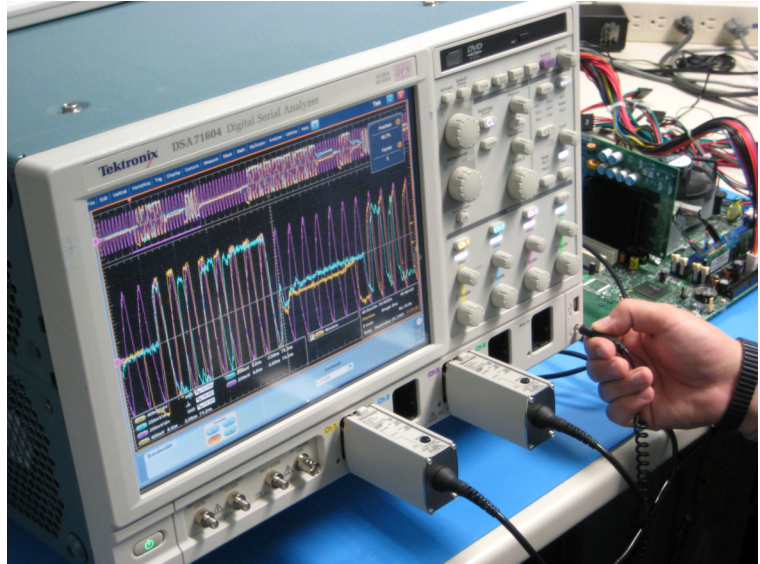
ESD 방지



주의. 직접적인 정전기 방전은 장비 입력에 손상을 줄 수 있습니다. 이 손상을 피하는 방법을 확인하려면 다음 정보를 읽으십시오.

정전기 방전(ESD)은 전기 장비를 취급할 때 주의할 사항입니다. 장비는 강력한 ESD 보호 기능을 제공하도록 설계되지만 신호 입력에 직접적으로 작용하는 상당량의 정전기 방전이 장비에 손상을 줄 가능성은 여전히 있습니다. 장비 손상을 피하려면 다음 기술을 활용하여 장비에 대한 정전기 방전을 방지하십시오.

1. 케이블 및 TekConnect 어댑터를 연결 및 분리할 때는 접지된 정전기 방지 손목띠를 착용하여 신체로부터 정전기가 방전되도록 합니다. 이를 위해 장비에서 전면 패널 연결이 제공됩니다.



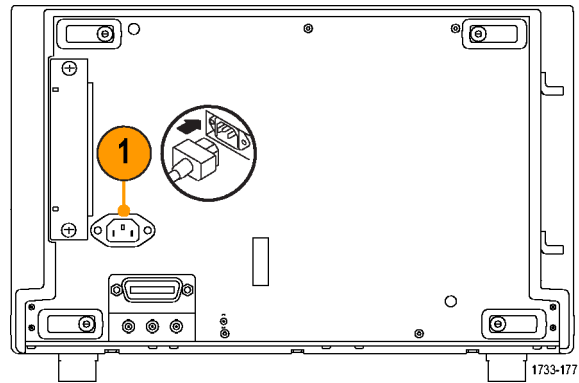
2. 벤치에서 분리되어 있는 케이블은 대량의 정전기를 발생시킬 수 있습니다. 케이블을 장비에 연결하기 전에 케이블의 중앙 도체를 순간적으로 접지하거나 50Ω 종단을 한쪽 끝에 연결하여 케이블을 장비나 테스트 중인 장치에 연결하기 전에 모든 케이블에서 정전기를 방전하십시오.



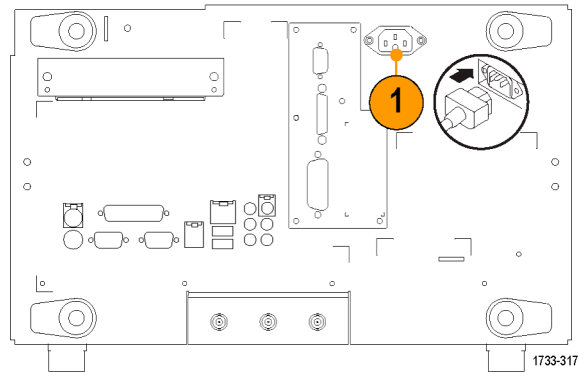
장비 전원 켜기

전력 공급기 요구 사항

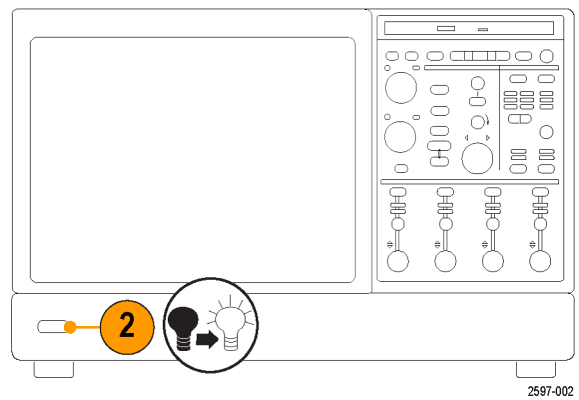
소스 전압 및 주파수	전력 소모
4GHz 미만 모델: 100–240V _{RMS} ±10%, 47–63Hz 또는 115V _{RMS} ±10%, 400Hz	550W 최대
4GHz 이상 모델: 100–240V _{RMS} ±10%, 50–60Hz 또는 115V _{RMS} ±10%, 400Hz CAT II	1100VA 이하



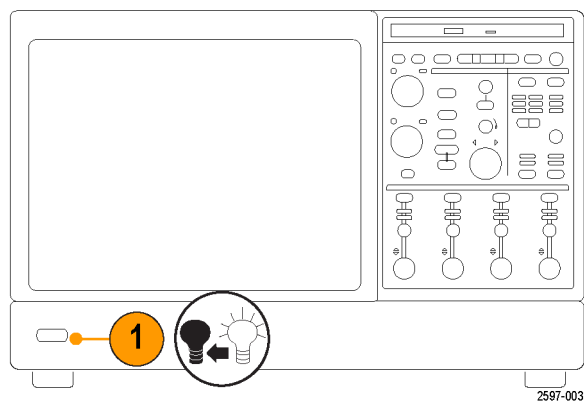
4GHz 미만 모델



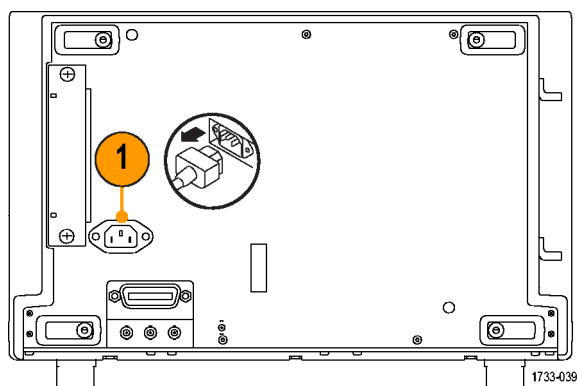
4GHz 이상 모델



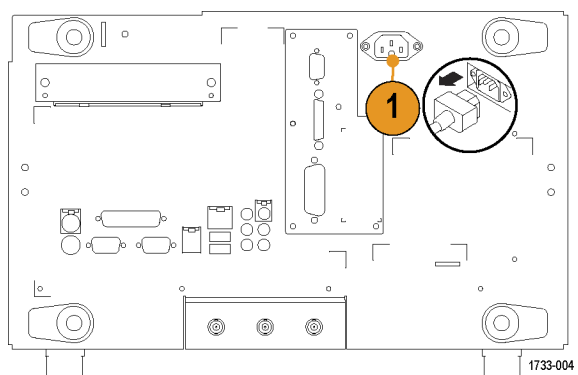
장비 끄기



전원 끄기



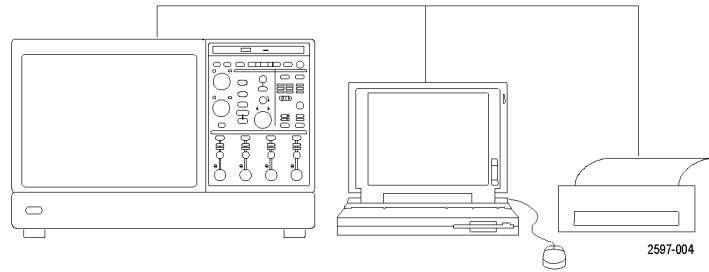
4GHz 미만 모델



4GHz 이상 모델

네트워크에 연결

인쇄, 파일 공유, 인터넷 액세스 및 기타 기능을 위해 장비를 네트워크에 연결할 수 있습니다. 네트워크 관리자에게 문의한 다음 표준 Windows 유틸리티를 사용하여 장비를 네트워크에서 사용할 수 있도록 구성하십시오.



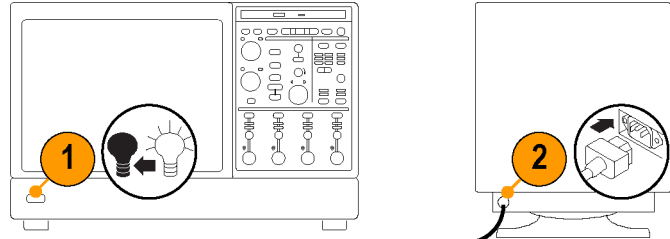
주석노트. 네트워크에서 원격 작동하려면 디스플레이(Display)>디스플레이 원격(Display Remote)을 On으로 전환합니다. 장비와 원격 PC에 VNC 또는 pcAnywhere를 설치해야 합니다. 디스플레이 원격(Display Remote)을 활성화하면 디스플레이 업데이트, 제어창 액세스 및 메뉴 항목이 느려집니다.

두 번째 모니터 추가

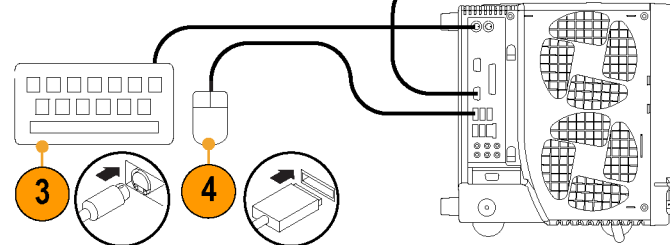
Windows 및 설치된 애플리케이션을 외부 모니터에서 사용하는 동시에 장비를 작동할 수 있습니다. 아래 절차에 따라 이중 모니터 구성을 설정하십시오.

4GHz 미만 모델

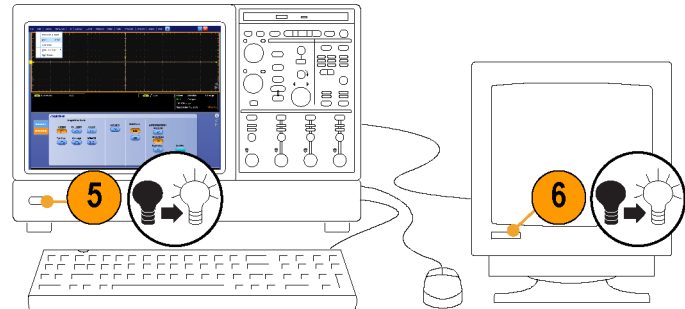
1. 전원을 끕니다.
2. 두 번째 모니터를 연결합니다.



3. 키보드를 연결합니다.
4. 마우스를 연결합니다.



5. 장비 전원을 켭니다.
6. 모니터 전원을 켭니다.

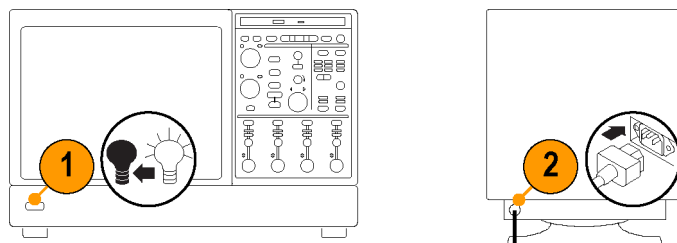


4GHz 미만 모델

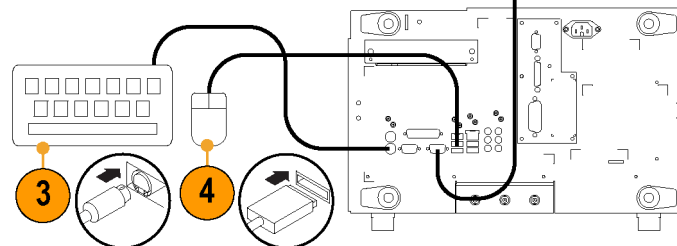
2597-005

4GHz 이상 모델

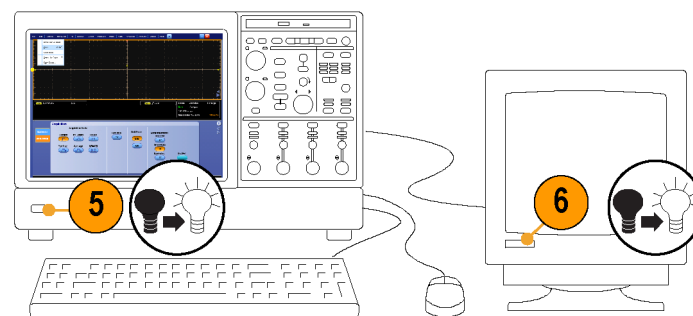
1. 전원을 끕니다.
2. 두 번째 모니터를 연결합니다.



3. 키보드를 연결합니다.
4. 마우스를 연결합니다.



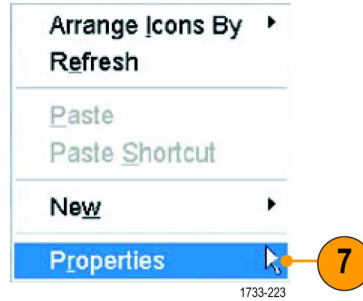
5. 장비 전원을 켭니다.
6. 모니터 전원을 켭니다.



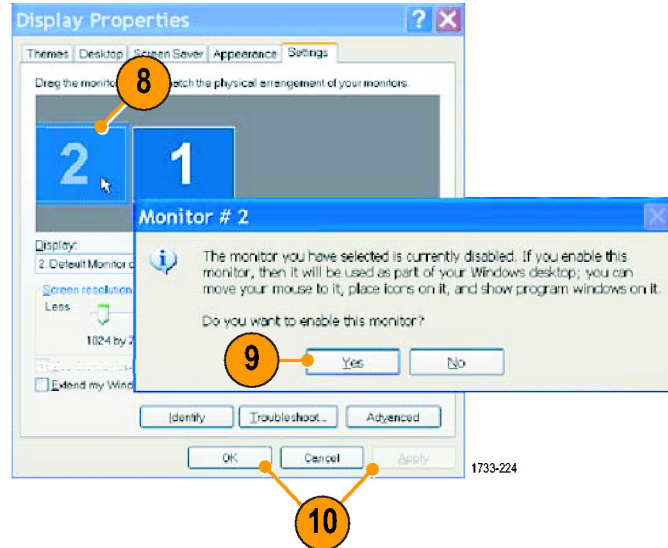
4GHz 이상 모델

2597-012

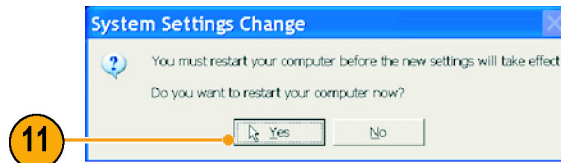
7. Windows 바탕 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 **등록 정보(Properties)**를 선택합니다.



8. **설정값(Settings)**을 선택합니다. 회색으로 표시된 외부 모니터(2)를 클릭하여 모니터 1의 왼쪽으로 끕니다.
9. 새 모니터를 활성화할 것인지를 묻는 메시지가 나타나면 **예(Yes)**를 클릭합니다.



11. **예(Yes)**를 클릭하여 장비를 다시 시작합니다.



운영 체제 복구 CD-ROM 만들기

장비는 운영 체제 복구 DVD와 함께 제공되지 않습니다. 필요한 경우 다음 절차를 사용하여 운영 체제를 복구할 수 있는 CD-ROM을 만듭니다.

주석노트. 이 절차를 사용하면 Microsoft Windows 운영 체제를 위한 복구 CD-ROM을 만들 수 있습니다. 운영 체제를 복구한 후 제품 소프트웨어 CD를 사용하여 장비 애플리케이션 소프트웨어를 다시 설치합니다. 제품 소프트웨어 CD와 함께 제공된 지침을 따라 장비 애플리케이션 소프트웨어를 다시 설치합니다.

복구 CD-ROM 만들기

사전 요구 사항: 빈 CD-R 디스크(백업 파일당 1개)

복구 CD-ROM을 만들려면

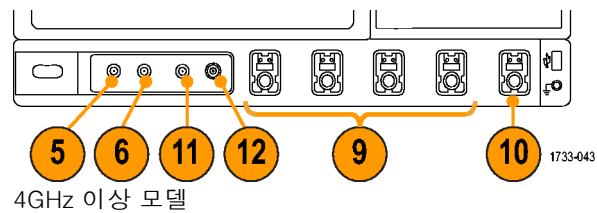
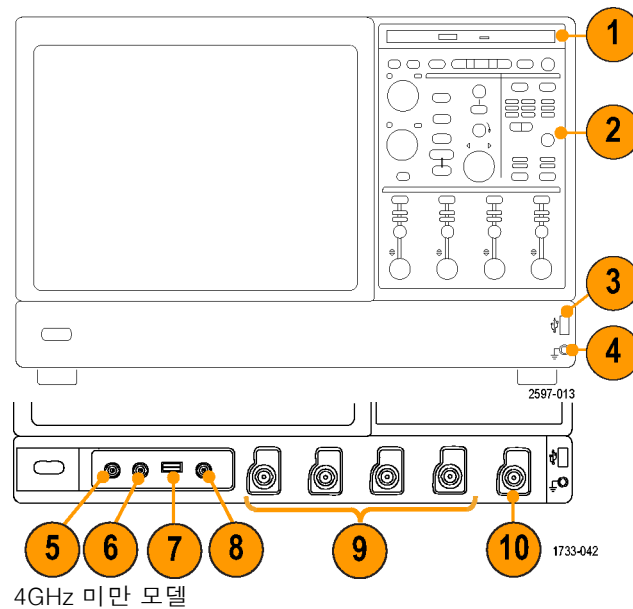
1. 빈 CD-R을 장비 DVD 드라이브에 넣습니다.
2. 시작 > 모든 프로그램 > Nero 7 Essentials > Data > Nero Express Essentials를 클릭합니다.
3. 이미지(Image), 프로젝트(Project), 복사(Copy)를 클릭합니다.
4. 디스크 이미지(Disk Image) 또는 저장된 프로젝트(Saved Project)를 클릭합니다.
5. C:\Wbackup을 탐색합니다.
6. 파일 backup1을 선택하고 열기(Open)를 클릭합니다.
7. 굽기 후 디스크의 데이터 확인(Verify data on disk after burning) 확인란을 클릭하여 이 기능을 활성화합니다.
8. 굽기(Burn) 버튼을 클릭합니다. 애플리케이션에서 백업 파일을 CD-R에 쓴 다음 CD의 데이터가 소스 파일과 일치하는지 확인합니다.
9. 애플리케이션에서 CD 쓰기 프로세스가 성공적으로 완료되었음을 보고하면 CD-R을 제거하고 적절한 라벨(예: 백업 파일 이름, 장비 이름, 장비 일련 번호 및 날짜)을 지정합니다.
10. 나머지 각 백업 파일에 대해 단계 1~9를 반복합니다.
11. C:\Wbackup 디렉토리에 있는 디스크 이미지 파일(*.iso)을 네트워크 위치, 별도의 하드 디스크 또는 백업용 광 미디어에 복사합니다.
12. 회사 정책에서 정의한 대로 백업 CD를 저장합니다.

주석노트. 운영 체제 복구 디스크는 만들어진 장비에서만 사용할 수 있습니다.

장비에 익숙해지기

전면 패널

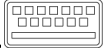
1. DVD/CD-RW 드라이브
2. 전면 패널 컨트롤
3. USB 포트
4. 접지 터미널
5. 복구된 데이터 출력
6. 복구된 클럭 출력
7. 프로브 보정 출력
8. 프로브 교정 출력
9. 채널 1-4 입력
10. 보조 트리거 입력
11. 고속 예지 출력
12. DC 프로브 교정 출력

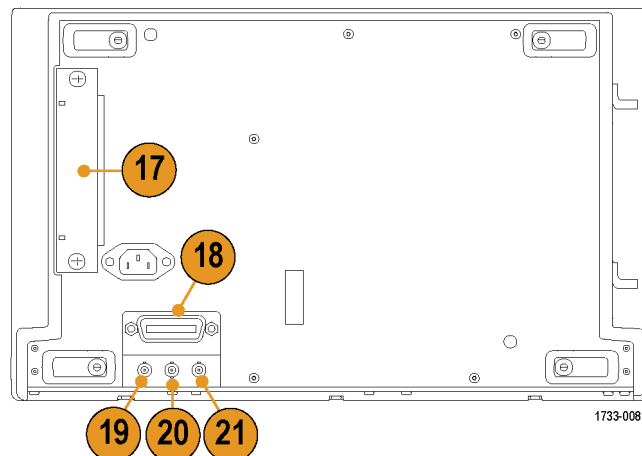
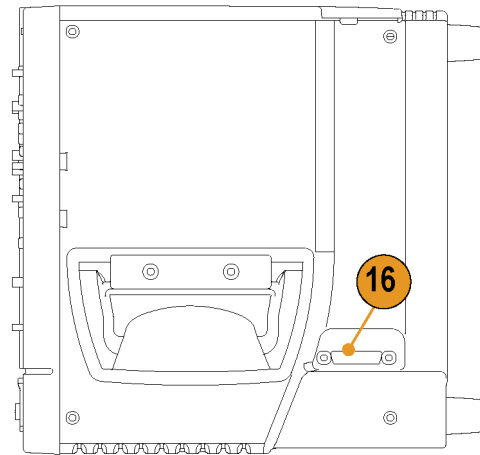
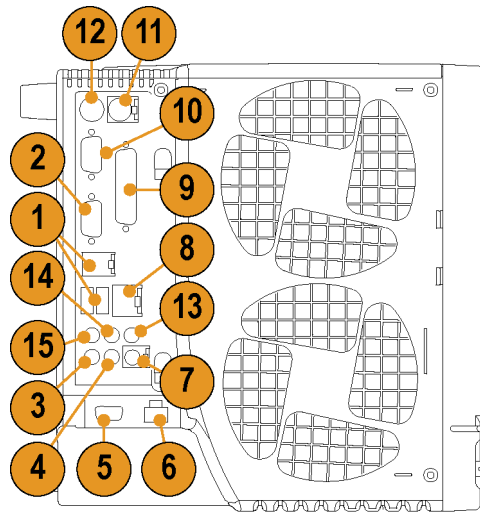


측면 및 후면 패널

1. USB 포트
2. 사이드 바이 사이드 표시를 위한 모니터 연결용 비디오 포트

주석노트. 일부 장비에는 추가 오디오 커넥터가 있을 수 있습니다.

3. 마이크용 마이크 커넥터
4. 스피커용 라인 아웃 커넥터
5. 모니터 연결용 스코프 전용 XGA 출력 비디오 포트
6. 프린터 연결
7. 라인 인 커넥터
8. 네트워크 연결용 RJ-45 LAN 커넥터
9. Centronics 병렬 포트
- 10.COM 1 직렬 포트
11.  마우스용 PS-2 커넥터
12.  키보드용 PS-2 커넥터
- 13.후면 스피커 아웃
- 14.측면 스피커 아웃
- 15.CTR Bass 스피커
- 16.이후 사용을 위한 TekLink 커넥터
- 17.이동식 하드 디스크 드라이브
- 18.컨트롤러 연결용 GPIB 포트
- 19.보조 출력
- 20.채널 3 출력
- 21.외부 기준 입력

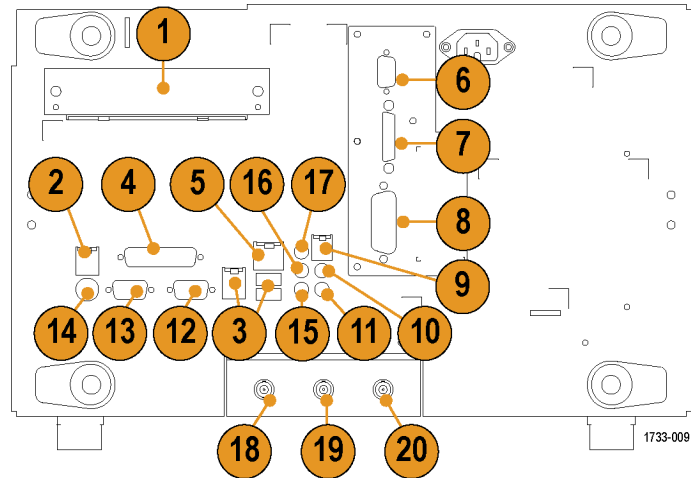


4GHz 미만 모델

1733-008

1. 이동식 하드 디스크 드라이브
2. 마우스용 PS-2 커넥터
3. USB 포트
4. Centronics 병렬 포트
5. 네트워크 연결용 RJ-45 LAN 커넥터
6. 모니터 연결용 비디오 포트
7. TekLink 커넥터
8. 컨트롤러 연결용 GPIB 포트

주석노트. 일부 장비에는 추가 오디오 커넥터가 있을 수 있습니다.



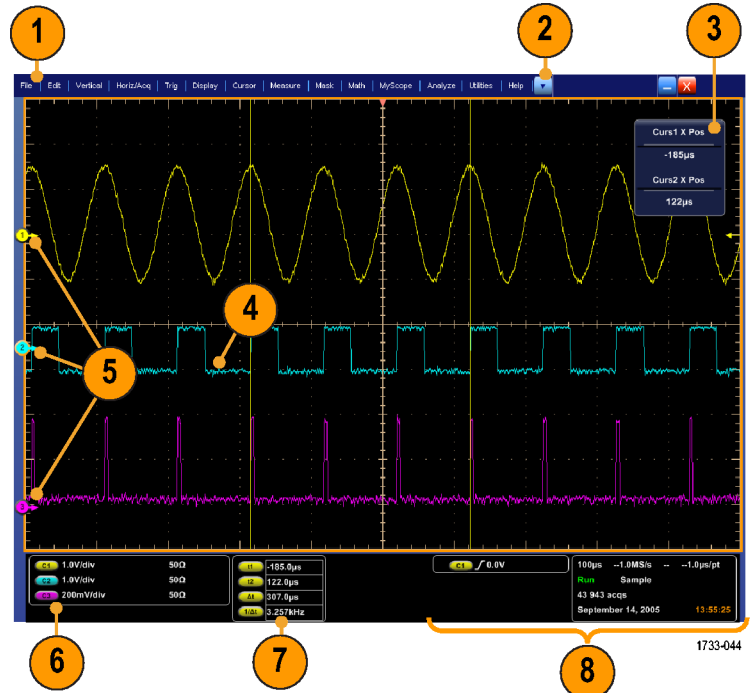
4GHz 이상 모델

9. 라인 인 커넥터
- 10.스피커용 라인 아웃 커넥터
- 11.마이크용 마이크 커넥터
- 12.사이드 바이 사이드 표시를 위한 모니터 연결용 비디오 포트
- 13.COM 1 직렬 포트
- 14.키보드용 PS-2 커넥터
- 15.CTR Bass 스피커
- 16.측면 스피커 아웃
- 17.후면 스피커 아웃
- 18.보조 출력
- 19.기준 출력
- 20.외부 기준 입력

인터페이스 및 디스플레이

메뉴 막대 모드에서는 모든 장비 기능을 제어할 수 있는 명령에 액세스할 수 있습니다. 도구 모음 모드에서는 가장 일반적인 기능에 액세스할 수 있습니다.

1. **메뉴 막대:** 데이터 I/O, 인쇄, 온라인 도움말 및 장비 기능에 액세스합니다.
2. **버튼/메뉴:** 클릭하여 도구 모음 모드 및 메뉴 막대 모드 간을 전환하고 도구 모음을 사용자 정의합니다.
3. **범용 노브 판독값:** 범용 노브가 제어하는 매개 변수를 조정 및 표시합니다.
4. **디스플레이:** 실시간, 기준 및 math 파형이 커서를 따라 여기에 표시됩니다.
5. **파형 처리:** 클릭하고 끌어 파형의 수직 위치를 변경합니다. 핸들을 클릭하고 범용 노브를 사용하여 위치 및 스케일을 변경합니다.
6. **제어 상태:** 수직 선택, 스케일, 오프셋 및 매개 변수를 빠르게 참조할 수 있습니다.
7. **판독값:** 이 영역에 커서 및 측정 판독값이 표시됩니다. 측정값은 메뉴 막대 또는 도구 모음에서 선택할 수 있습니다. 제어창이 표시되는 경우 일부 판독값 조합은 화면으로 이동합니다.

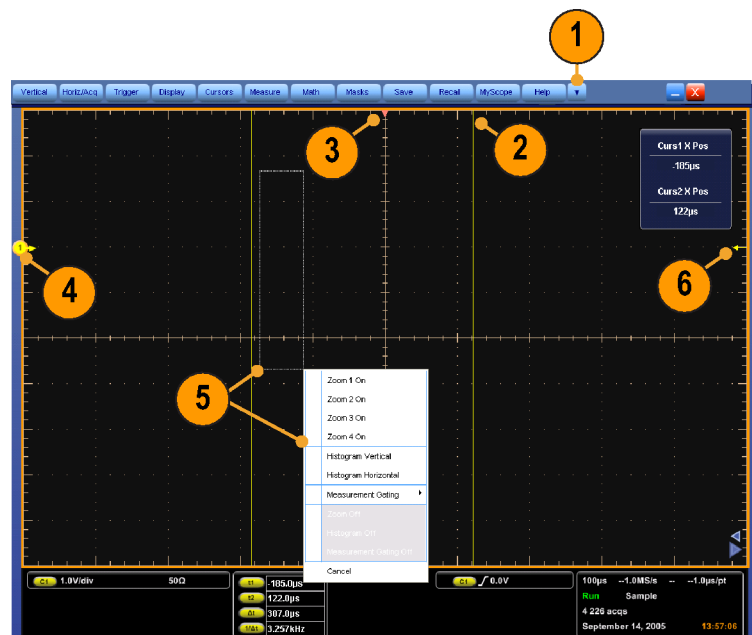




경고. 수직 클리핑이 있는 경우 프로브 팁에 위험 전압이 발생할 수 있지만 판독값에는 저전압이 표시됩니다. 수직 클리핑 조건이 있는 경우 측정 판독값에 기호가 나타납니다. 신호가 수직으로 클리핑되면 자동 진폭 관련 측정의 결과로 잘못된 값이 생성될 수 있습니다. 또한 클리핑으로 인해 파형의 잘못된 진폭 값이 저장되거나 다른 프로그램에서 사용하기 위해 내보내질 수 있습니다. math 파형이 클리핑되는 경우에는 해당 연산 파형의 진폭 측정값에 아무런 영향을 주지 않습니다.

8. 상태: 획득 상태, 모드, 획득 수, 트리거 상태, 날짜 및 시간을 표시하며 레코드 길이 및 수평 매개 변수를 빠르게 참조할 수 있습니다.

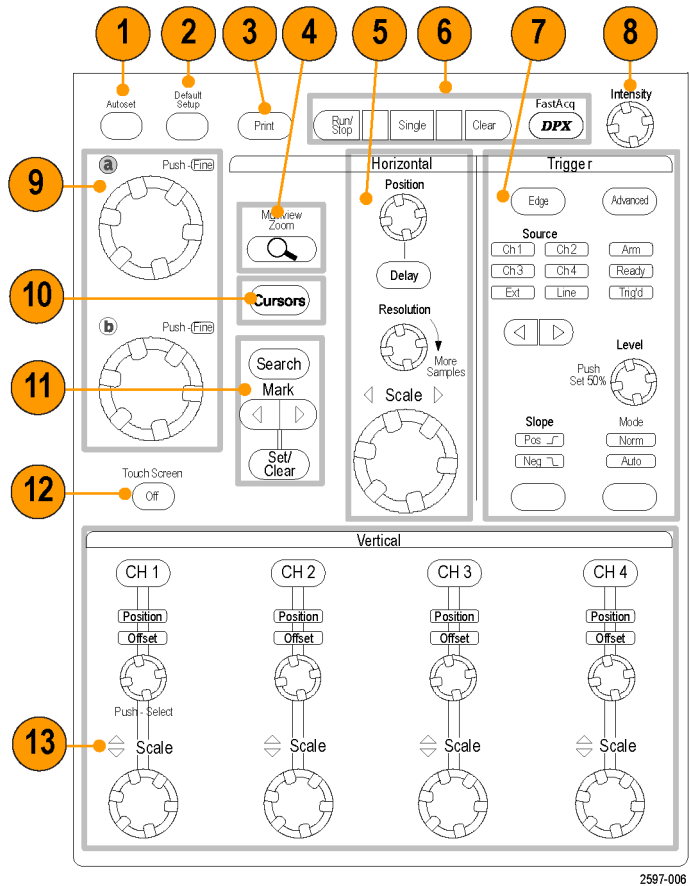
- 1. 버튼/메뉴:** 클릭하여 도구 모음 모드 및 메뉴 막대 모드 간을 전환하고 도구 모음을 사용자 정의합니다.
- 커서를 끌어 화면에서 파형을 측정합니다.
- 위치 아이콘을 끌어 파형 위치를 바꿉니다.
- 아이콘을 클릭하여 범용 노브를 파형 수직 위치 및 스케일에 지정합니다.
- 파형 영역 전체를 끌어 확대를 위한 상자를 작성하고, 히스토그램을 활성화/비활성화하고, 측정값을 게이트합니다.
- 아이콘을 끌어 트리거 레벨을 변경합니다.



1733-045

제어판

1. 선택한 채널을 기준으로 수직, 수평 및 트리거 컨트롤을 자동으로 설정합니다.
2. 설정값을 기본값으로 되돌립니다.
3. 하드 카피를 만들거나 화면 포착을 저장합니다.
4. MultiView Zoom을 켜고 확대된 화면을 디스플레이에 추가합니다.
5. 모든 파형의 레코드 길이(해상도)를 수평으로 스케일, 위치 지정, 지연 및 설정합니다.
6. 획득을 시작 및 정지하거나, 단일 획득 시퀀스를 시작하거나, 데이터를 삭제하거나 빠른 획득을 시작하는 데 사용합니다.
7. 트리거 매개 변수를 설정하는 데 사용합니다. 추가 트리거 기능을 표시하려면 고급(Advanced)을 누르십시오. 준비, 준비 완료 및 트리거 라이트는 획득 상태를 보여줍니다.
8. 파형 밝기를 조정합니다.
9. 화면 인터페이스에서 선택한 매개 변수를 조정합니다. 일반 조정 및 미세 조정 간에 전환합니다.
10. 커서를 켜거나 끕니다.
11. 파형을 검색 및 표시하는 데 사용합니다.
12. 터치 스크린을 켜고 끕니다.
13. 채널 디스플레이를 켜고 끕니다. 수직으로 파형을 스케일, 위치 지정 또는 오프셋합니다. 위치 및 오프셋 간에 전환합니다.

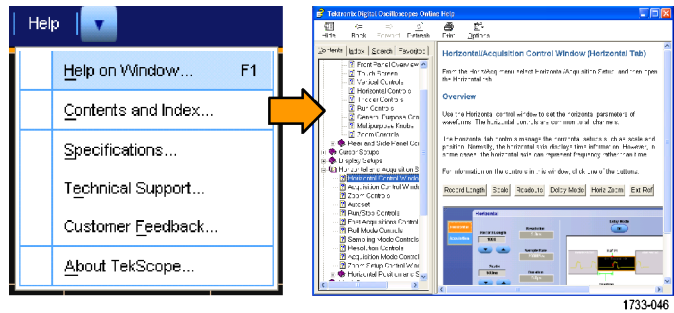


2597-006

온라인 도움말 액세스

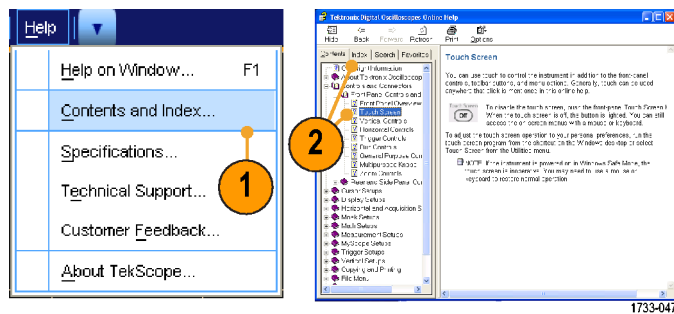
온라인 도움말에서는 장비의 모든 기능에 대한 심층적인 정보를 확인할 수 있습니다.

활성 창에서 구문-검색 도움말에 액세스하려면 **도움말(Help) > Window 도움말...(Help on Window...)**을 선택하거나 F1 키를 누릅니다.



1733-046

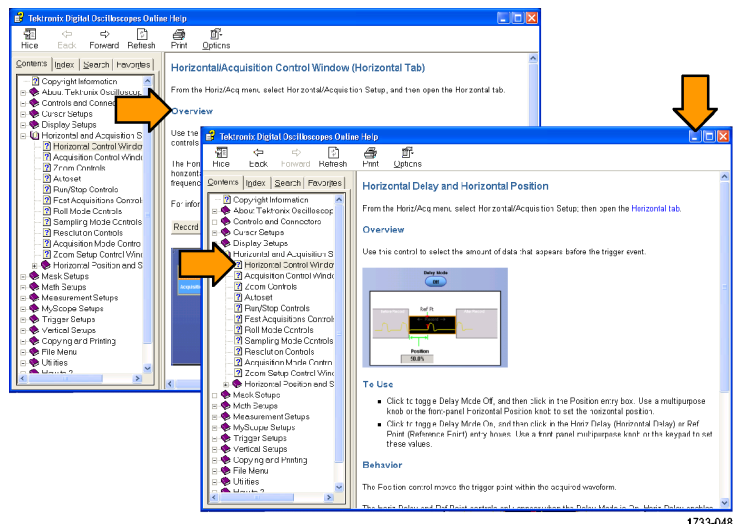
1. 도움말 시스템의 주제에 액세스하려면 **도움말(Help) > 목차 및 색인...(Contents and Index...)**을 선택합니다.
2. 목차(Contents), 색인(Index), 검색(Search) 또는 즐겨찾기(Favorites) 탭을 사용하여 주제를 선택한 다음 **표시(Display)**를 클릭합니다.



1733-047

도움말 시스템에서 탐색하려면 다음을 수행하십시오.

- 도움말 창의 버튼을 클릭하여 개요(Overview) 및 각 주제 간을 탐색합니다.
- 도움말 창을 없애고 장비를 계속 작동시키려면 도움말 창의 **최소화(Minimize)** 버튼을 클릭합니다.
- 마지막 도움말 항목을 다시 보려면 Alt 및 Tab 키를 클릭합니다.

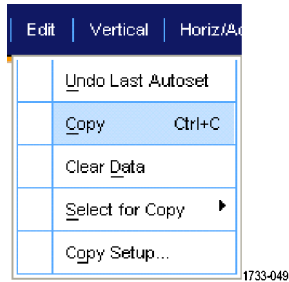


1733-048

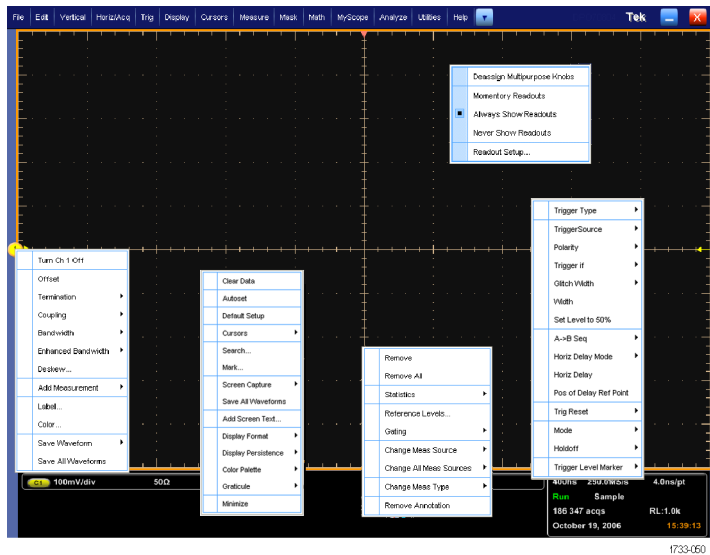
메뉴 및 제어창 액세스

다음 방법을 사용하여 메뉴 및 제어창에 액세스할 수 있습니다.

- 메뉴를 클릭한 다음 명령을 선택합니다.



- 바로 가기 메뉴를 표시하려면 화면의 아무 위치 또는 오브젝트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 바로 가기 메뉴는 상황에 따른 메뉴이며 오른쪽 클릭한 영역이나 오브젝트에 따라 다릅니다. 오른쪽 그림에 일부 예제가 나와 있습니다.



- 도구 모음 모드에서 버튼을 클릭하여 설정 제어창에 빠르게 액세스합니다. (16페이지의 참조)

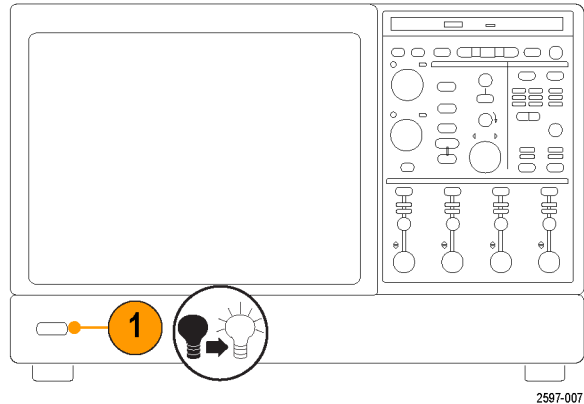


장비 검사

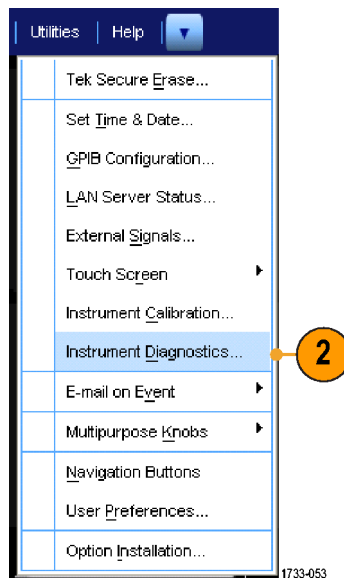
장비 기능을 확인하려면 다음 절차를 사용합니다.

내부 진단 통과 확인

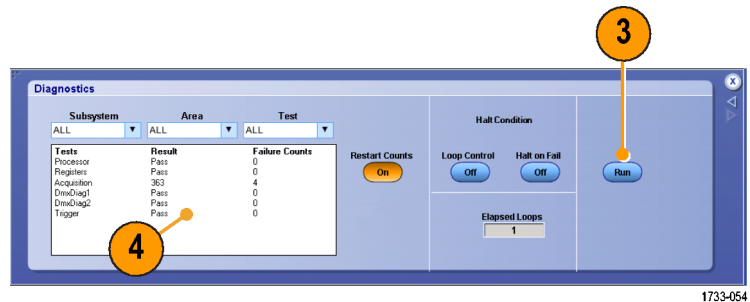
1. 장비 전원을 켭니다.



2. 장비 진단...(Instrument Diagnostics...)을 선택합니다.



3. 실행(Run)을 클릭합니다. 테스트 결과가 진단 제어창에 나타납니다.
4. 테스트에 통과하는지를 확인합니다. 진단 이상이 발생하면 지역 Tektronix 서비스 기술자에게 문의하십시오.



1733-054

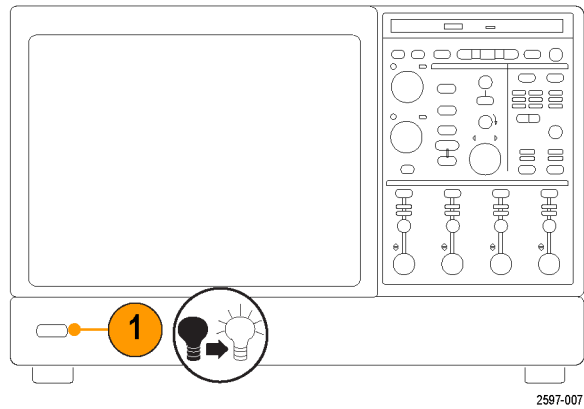
획득

이 절에는 획득 시스템 사용을 위한 개념 및 절차가 포함되어 있습니다.

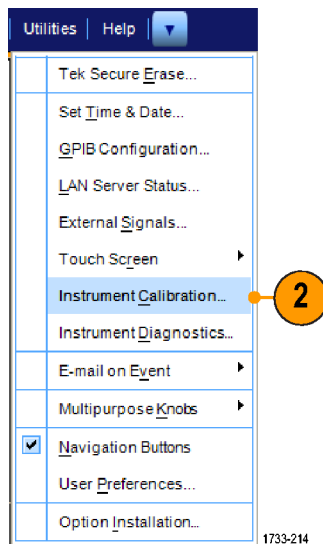
신호 경로 보정

마지막 신호 경로 보정 이후 온도 변화가 5 °C (9 °F)를 초과하는 경우 이 절차를 사용하십시오. 주당한 번씩 신호 경로 보정을 수행하십시오. 이렇게 하지 않으면 장비가 보장된 성능 레벨을 만족하지 않을 수 있습니다.

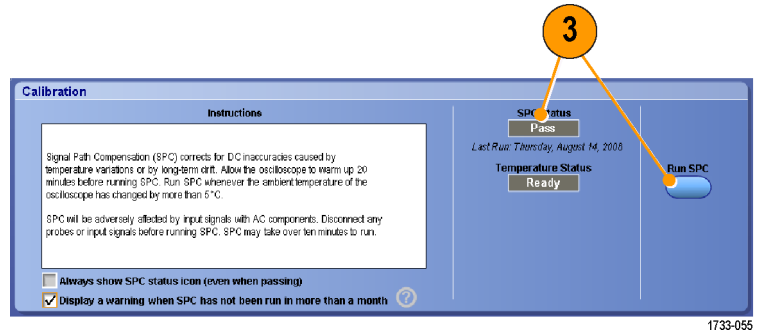
1. 사전 요구 사항: 장비의 전원을 20분간 켜 두고 모든 입력 신호를 제거합니다.



2. 장비 교정 (Instrument Calibration)을 선택합니다.

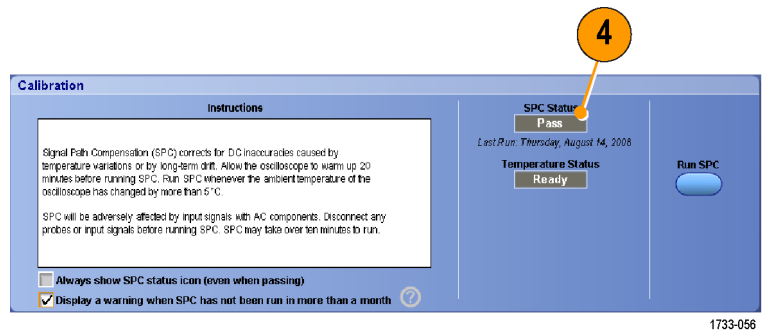


3. 상태가 온도(Temp)로 변경되면 교정(Calibrate)을 클릭하여 교정을 시작합니다. 교정은 10분에서 15분 정도 걸립니다.

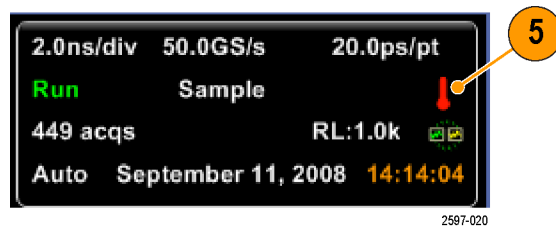


4. 장비가 통과하지 못하면 장비를 다시 교정하거나 전문 서비스 직원의 검사를 받으십시오.

주석노트. SPC 상태 아이콘을 항상 표시하거나 SPC가 두 달 이상 실행되지 않았을 때 경고를 표시하려면 해당 옵션 버튼을 클릭합니다.



5. SPC 필요 아이콘이 빨간색이면 신호 경로 보정을 수행합니다.



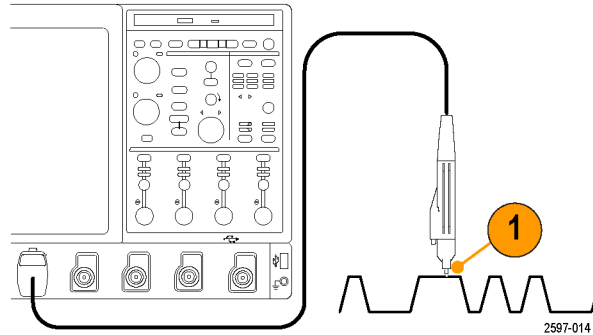
신호 입력 설정

전면 패널 버튼을 사용하여 신호를 획득하도록 장비를 설정합니다.

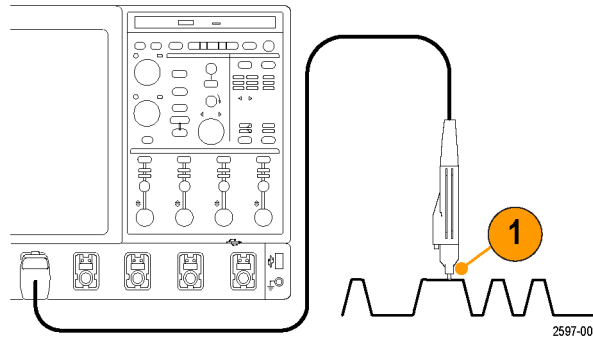
1. 프로브를 입력 신호 소스에 연결합니다.



주의. 장비 손상을 방지하려면 장비에 연결할 때 항상 정전기 방지 손목띠를 착용하고 입력 커넥터에 대한 최대 입력 전압 정격을 준수합니다.

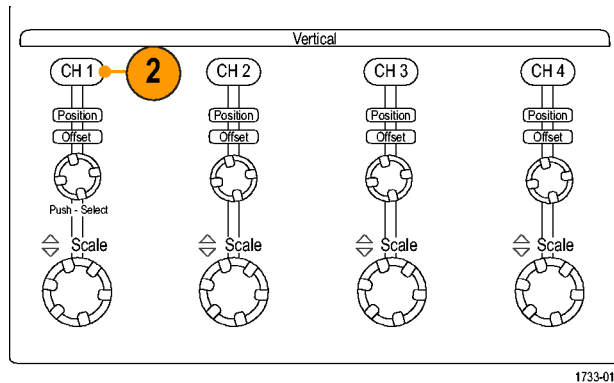


4GHz 미만 모델



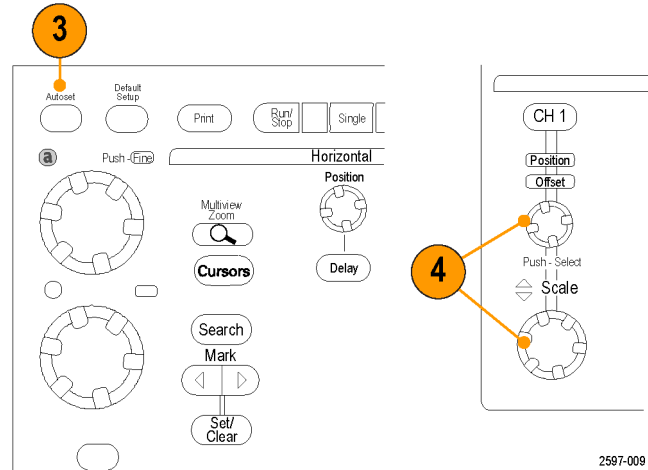
4GHz 이상 모델

2. 전면 패널 버튼을 눌러서 채널 켜기/끄기를 전환하여 입력 채널을 선택합니다.

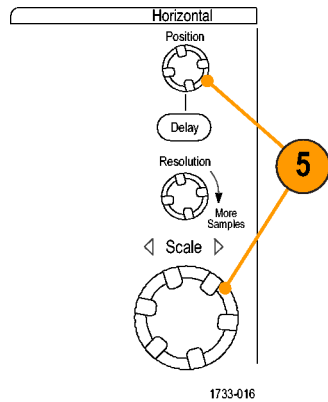


1733-014

3. 자동 설정(Autoset)을 누릅니다.
4. 전면 패널 노브를 사용하여 수직 위치, 스케일 및 오프셋을 조정합니다. 노브를 누르면 위치 및 오프셋 간에 전환할 수 있습니다.

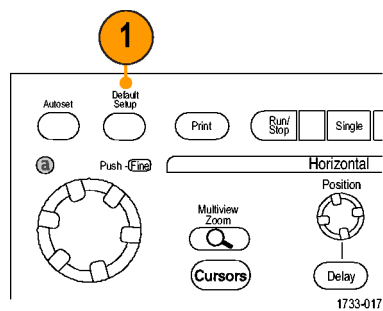


5. 전면 패널 노브를 사용하여 수평 위치 및 스케일을 조정합니다. 수평 위치는 사전 트리거 및 사후 트리거 샘플의 개수를 결정합니다.



기본값 설정 사용

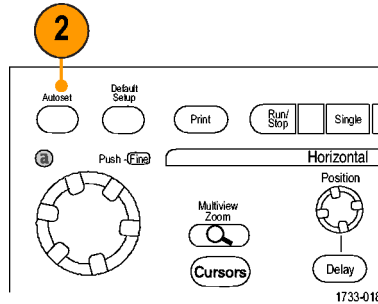
1. 초기 상태 기본값 설정으로 빠르게 되돌리려면 **기본값 설정 (DEFAULT SETUP)**을 누릅니다.



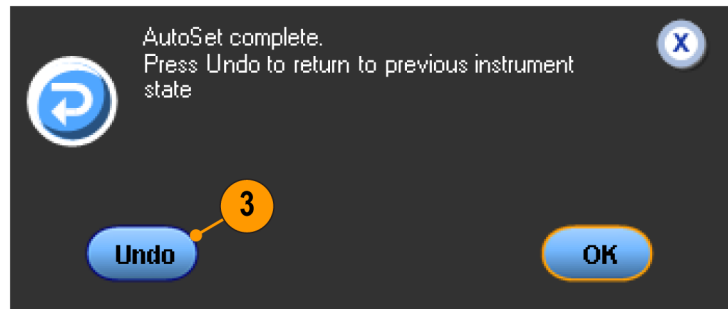
자동 설정 사용

자동 설정을 사용하면 입력 신호의 특징을 기준으로 장비(획득, 수평, 트리거 및 수직)를 빠르게 자동 설정할 수 있습니다. 자동 설정은 중간 레벨 부근에 트리거가 있는 2-3개의 파형 사이클이 표시되도록 신호를 조정합니다.

1. 프로브를 연결한 다음 입력 채널을 선택합니다. (25페이지의 **신호 입력 설정** 참조)
2. 자동 설정 (Autoset)을 실행하려면 **자동 설정(AUTOSET)** 버튼을 누릅니다.



3. 마지막 자동 설정을 실행 취소하려면 **실행 취소(Undo)**를 클릭합니다. 자동 설정의 영향을 받지 않는 매개 변수의 설정은 그대로 유지됩니다.



빠른 팁

- 파형을 올바른 위치에 놓기 위해 자동 설정이 수직 위치를 변경할 수 있습니다. 또한 자동 설정이 수직 오프셋을 조정할 수도 있습니다.
- 하나 이상의 채널이 표시되어 있을 때 자동 설정을 사용하면 장비는 번호가 가장 낮은 채널을 수평 스케일 및 트리거용으로 선택합니다. 각 채널의 수직 스케일을 개별적으로 제어할 수 있습니다.
- 채널이 표시되지 않은 상태에서 자동 설정을 사용하면 장비의 채널 1(Ch 1)이 켜지고 해당 채널이 스케일됩니다.
- X를 클릭하면 자동 설정 실행 취소 제어창이 닫힙니다. 자동 설정 실행 취소를 닫은 후에도 편집 메뉴에서 마지막 자동 설정 실행 취소를 선택하여 마지막 자동 설정을 실행 취소할 수 있습니다.
- 유틸리티 메뉴에서 사용자 기본 설정을 변경하여 자동 설정 실행 취소 제어창이 자동으로 열리지 않도록 할 수 있습니다.

프로브 보정, 교정 및 지연시간 보정

측정 정밀도를 최적화하려면 장비 온라인 도움말을 참조하여 다음 절차를 수행하십시오.

- 패시브 프로브 보정
- 장비 신호 경로 보정
- 활성 프로브 교정
- 입력 채널 지연시간 보정

획득 개념

획득 하드웨어

신호는 스케일 및 디지털화되는 입력 채널을 먼저 통과해야만 표시할 수 있습니다. 각 채널에는 전용 입력 앰프 및 디지털라이저가 있습니다. 각 채널은 장비가 파형 레코드를 추출하는 디지털 데이터의 스트림을 생성합니다.

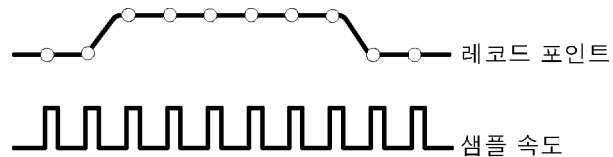
샘플링 프로세스

획득은 아날로그 신호를 샘플링하여 디지털 데이터로 변환하고 파형 레코드로 조합하는 과정을 말합니다. 이러한 데이터는 이후에 획득 메모리에 저장됩니다.



실시간 샘플링

실시간 샘플링에서는 장비가 하나의 트리거 이벤트를 사용하여 획득하는 모든 포인트를 디지털화합니다. 실시간 샘플링을 사용하여 싱글-샷 또는 일시적인 이벤트를 포착합니다.



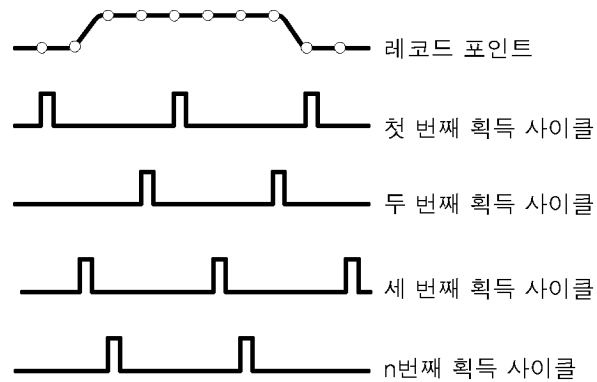
보간된 실시간 샘플링

보간된 실시간 샘플링에서는 장비가 하나의 트리거 이벤트를 사용하여 획득하는 모든 포인트를 디지털화합니다. 장비가 최대 실시간 샘플 속도에서 완전한 파형을 위한 충분한 샘플을 획득하지 못하면 보간을 수행합니다. 보간된 실시간 샘플링을 사용하면 싱글-샷, 일시적인 이벤트 또는 저속 획득을 포착할 수 있습니다.

동등 시간 샘플링

장비는 동등 시간 샘플링을 사용하여 해당 샘플 속도를 실시간 최대 샘플 속도를 초과하도록 확장합니다. 동등 시간 샘플링은 동등 시간이 선택되어 있고 시간축이 실시간 샘플링을 사용하여 파형 레코드를 작성하기에는 너무 빠른 샘플 속도로 설정되어 있는 경우에만 사용됩니다.

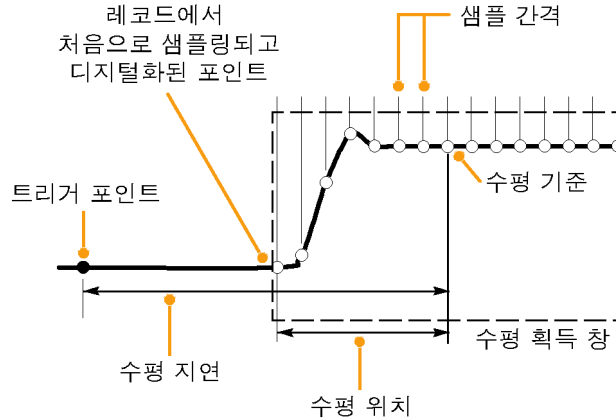
장비는 반복적인 파형을 여러 번 획득하여 하나의 완전한 파형 레코드에 필요한 샘플 밀도를 얻습니다. 그러므로 동등 시간 샘플링은 반복적인 신호에만 사용해야 합니다.



파형 레코드

장비는 다음 매개 변수를 사용하여 파형 레코드를 만듭니다.

- 샘플 간격: 샘플 포인트 간의 시간 간섭입니다.
- 레코드 길이: 파형 레코드를 채우는 데 필요한 샘플 수입니다.
- 트리거 포인트: 파형 레코드의 0 시간 기준입니다.
- 수평 위치: 수평 지연이 꺼져 있으면 수평 위치는 0에서 99.9% 사이의 파형 레코드 백분을입니다. 트리거 포인트 및 수평 기준은 파형 레코드에서 동일한 위치를 나타냅니다. 예를 들어 수평 위치가 50%이면 트리거 포인트는 파형 레코드 중간입니다. 수평 지연이 켜져 있으면 트리거 포인트에서 수평 기준까지의 시간이 수평 지연입니다.



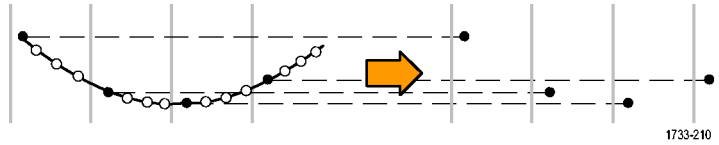
보간

장비는 파형 레코드를 채우는 데 필요한 모든 실제 샘플을 가지고 있지 않을 때 획득하는 샘플 간에 보간을 수행할 수 있습니다. 선형 보간은 직선 맞춤을 사용하여 실제로 획득하는 샘플 간의 레코드 포인트를 계산합니다.

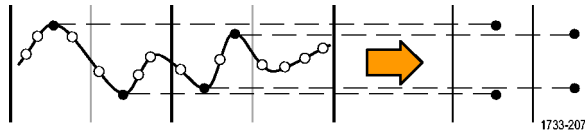
$\sin(x)/x$ 보간은 실제 획득한 값 간의 곡선 맞춤을 사용하여 레코드 포인트를 계산합니다. $\sin(x)/x$ 보간은 파형을 정확하게 표현하는 데 선형 보간보다 적은 실제 샘플 포인트를 필요로 하므로 기본 보간 모드로 사용됩니다.

획득 모드 작동 원리

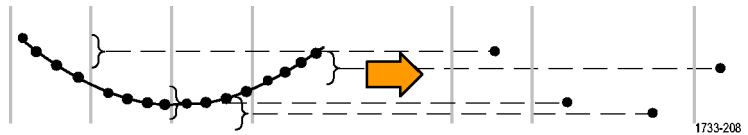
샘플 모드는 각 획득 간격에서 첫 번째 샘플링된 포인트를 유지합니다. 샘플은 기본 모드입니다.



피크 검출 모드는 두 개의 연속적인 획득 간격에 포함된 모든 샘플 중에서 최대값과 최소값을 사용합니다. 이 모드는 보간되지 않는 실시간 샘플링에서만 작동하며 높은 주파수 클리치를 찾는 데 유용합니다.



Hi-Res 모드는 각 획득 간격에서 모든 샘플의 평균을 계산합니다. Hi-Res는 고해상도, 저대역폭 파형을 제공합니다.



엔벨로프 모드는 많은 획득 중에서 최고 및 최저 레코드 포인트를 찾습니다. 엔벨로프는 각 개별 획득을 위해 피크 검출을 사용합니다.



평균 모드는 많은 획득 중에서 각 레코드 포인트에 대해 평균 값을 계산합니다. 평균은 각 개별 획득에 대해 샘플 모드를 사용합니다. 랜덤 노이즈를 줄이려면 평균 모드를 사용하십시오.



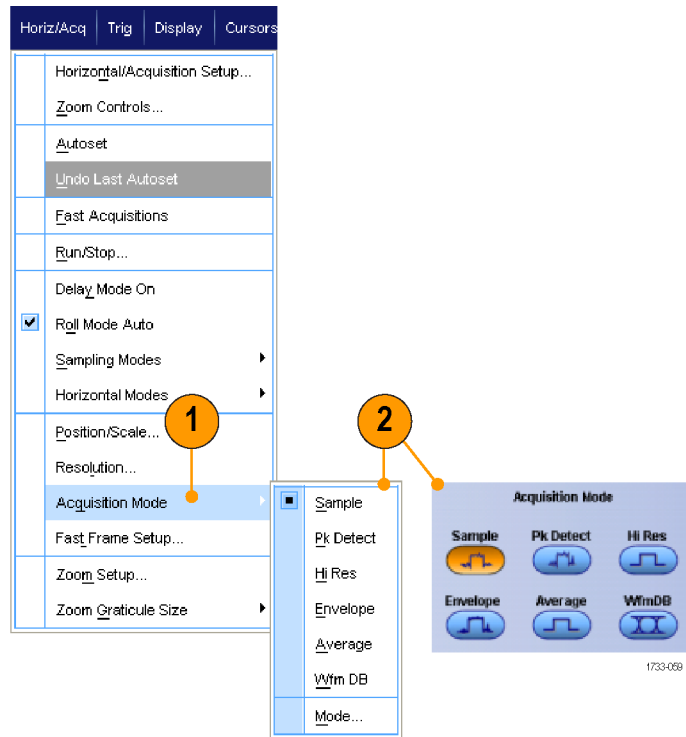
파형 데이터베이스 모드는 여러 획득에 대한 소스 파형 데이터의 3차원 누적입니다. 데이터베이스에는 진폭 및 타이밍 정보뿐 아니라 특정 파형 포인트(시간 및 진폭)를 획득한 횟수가 포함됩니다.



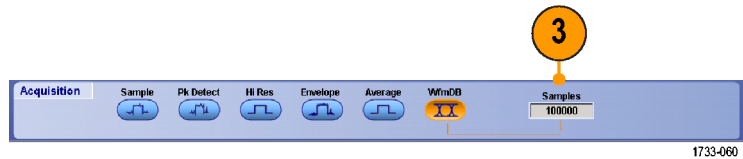
획득 모드 변경

획득 모드를 변경하려면 이 절차를 사용하십시오.

1. 수평/획득(Horiz/Acq) > 획득 모드(Acquisition Mode)를 선택합니다.
2. 획득 모드를 선택하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 메뉴에서 직접 획득 메뉴를 선택합니다.
 - 모드...(Mode...)를 클릭한 다음 획득 모드를 선택합니다.



3. 평균 및 엔벨로프 획득 모드로 들어가려면 **파형 수(# of Wfms)** 컨트롤을 클릭하고 범용 노브로 파형의 숫자를 설정합니다. WfmDB 모드 경우에는 **샘플(Samples)** 컨트롤을 클릭하고 범용 노브로 샘플의 숫자를 설정합니다.



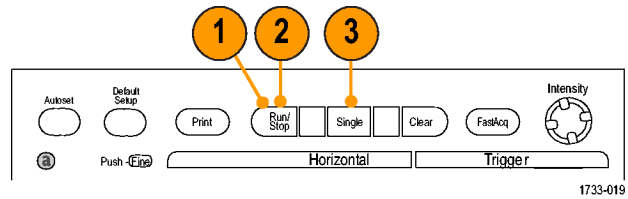
빠른 팁

- 파형 또는 샘플의 수를 설정하려면 키패드 아이콘을 클릭하십시오.

획득 시작 및 정지

획득할 채널을 선택한 후에 다음 절차를 사용하십시오.

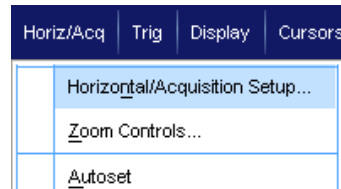
1. 전면 패널 **실행/정지(RUN/STOP)** 버튼을 눌러 획득을 시작합니다.
2. **실행/정지(RUN/STOP)** 버튼을 다시 눌러 획득을 정지합니다.
3. 단일 획득을 수행하려면 **단일(Single)** 버튼을 누릅니다.



수평 모드 선택

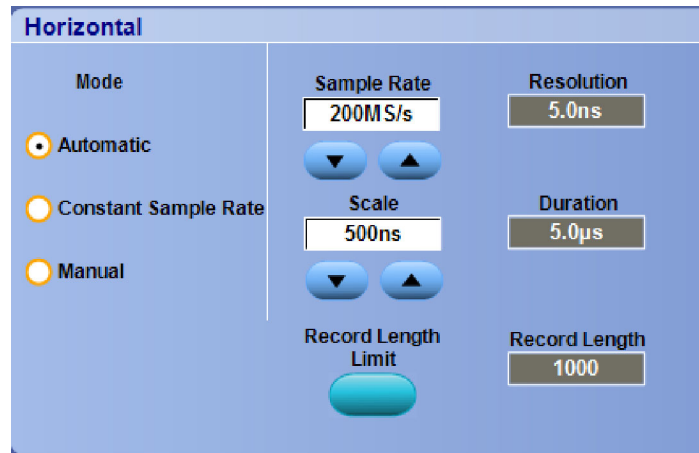
장비에는 세 개의 수평 모드가 있습니다. 자동이 기본 모드입니다. 테스트 설정에 가장 적합한 수평 모드를 선택합니다.

수평 모드를 설정하려면 **수평/획득(Horiz/Acq) > 수평/획득 설정(Horizontal/Acquisition Setup)**을 선택하여 수평 제어창을 엽니다. 아래 설명된 모드 중 하나를 선택합니다.

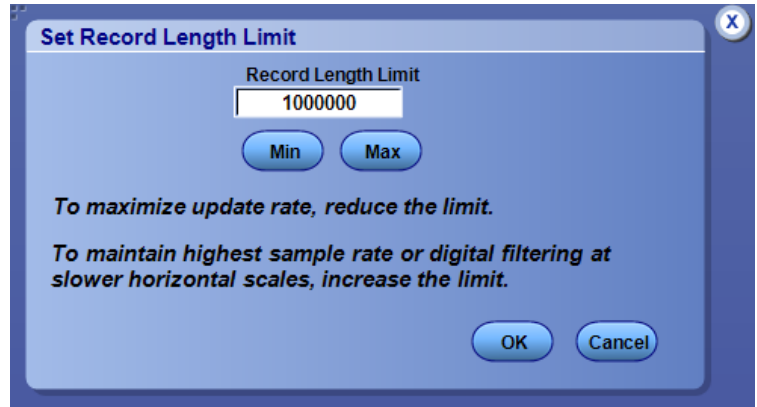


자동 모드에서는 스케일 및 샘플 속도를 설정할 수 있습니다. 레코드 길이는 종속 변수입니다. 스케일 변경으로 인해 레코드 길이가 레코드 길이 제한을 초과할 경우 샘플 속도는 사용 가능한 다음 설정값으로 줄어듭니다.

샘플링 모드가 실시간이고 샘플 속도가 실시간 제한에 도달한 경우에는 샘플 속도를 높일 수 없습니다.

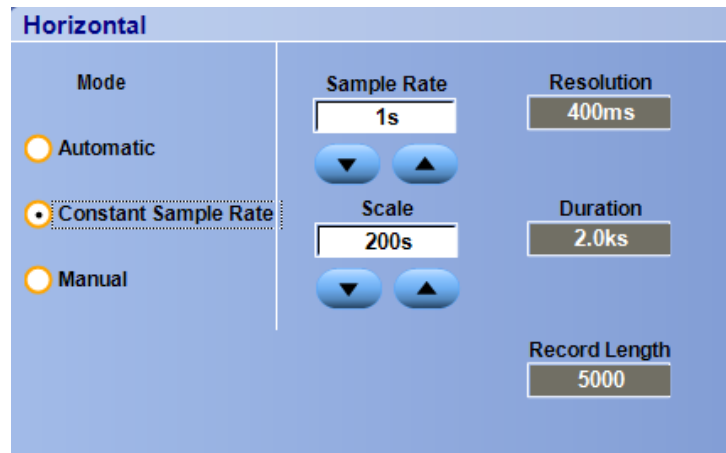


레코드 길이 제한을 설정하려면 **레코드 길이 제한(Record Length Limit)**을 클릭하고 버튼이나 키패드를 사용하여 제한을 설정합니다. 기본 최대 제한은 사용자의 장비 모델 및 레코드 길이 옵션에 따라 다릅니다.



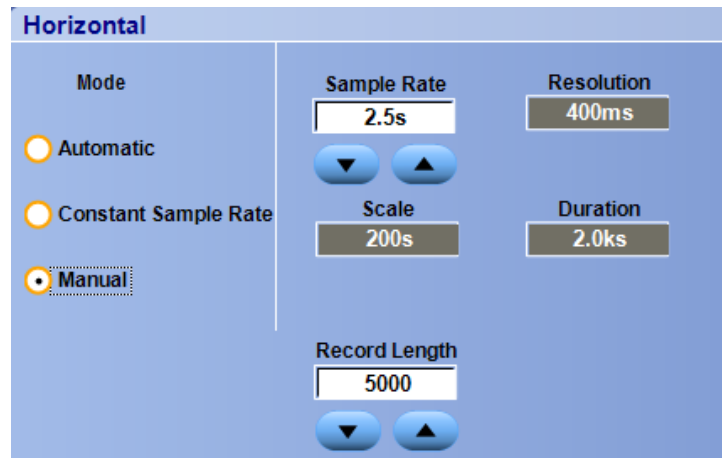
일정 샘플 속도 모드에서는 샘플 속도와 스케일을 설정할 수 있습니다. 기본 샘플 속도에서는 대역폭 필터 작업이 보장됩니다. 레코드 길이는 종속 변수입니다. 최대 레코드 길이는 장비 모델 및 레코드 길이 옵션에 따라 다릅니다.

전면 패널 해상도 노브를 사용하면 자동 샘플 속도 모드와 일정 샘플 속도 모드에서 샘플 속도를 변경할 수 있습니다.



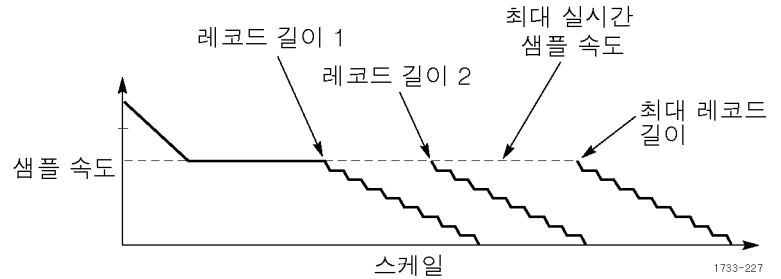
수동 모드에서는 샘플 속도 및 레코드 길이를 설정할 수 있습니다. 수평 스케일은 샘플 속도 및 레코드 길이에 따라 계산되는 종속 변수입니다. 마스크는 수동 모드에서 지원되지 않습니다.

수평 스케일 노브를 사용하면 수동 모드에서 레코드 길이를 변경할 수 있습니다.



세 가지 모드는 모두 그림에서처럼 샘플 속도, 스케일 및 레코드 길이에 있어 상호 작용합니다. 그림의 수평 라인은 최대 실시간 샘플 속도입니다. 각 계단은 스케일을 증가시키면 사용자가 설정한 최대 레코드 길이나 레코드 길이 제한에 도달할 경우 샘플 속도가 줄어들어야 한다는 것을 보여줍니다. 수동 모드는 최대 레코드 길이를 사용합니다.

자동 및 일정 샘플 속도 모드는 동일합니다. 단, 일정 샘플 속도 모드에서는 대역폭 항상 필터를 사용할 수 있는 속도로 샘플 속도가 일정하게 유지됩니다.

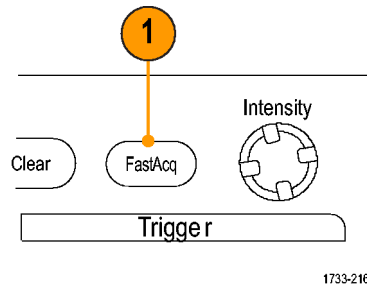


고속 획득 사용

고속 획득 모드를 사용하면 파형 획득 간의 데드 시간이 줄어들기 때문에 글리치 또는 런트 펄스 등의 일시적인 이벤트를 포착 및 표시할 수 있습니다. 고속 획득 모드는 또한 발생률을 반영하는 강도로 파형 현상을 표시할 수 있습니다.

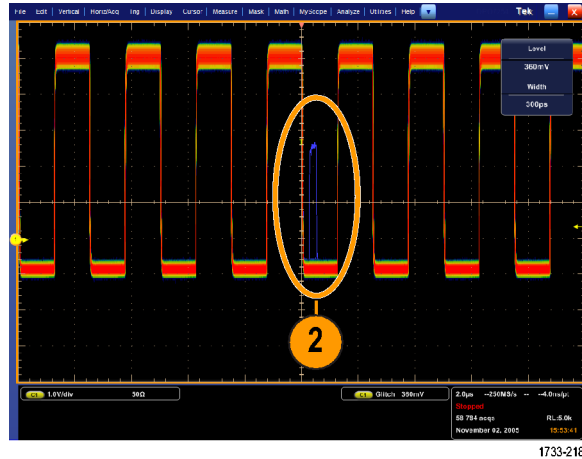
다음 절차를 사용하십시오.

1. 고속 획득(FastAcq)을 누릅니다.



2. 글리치, 일시적인 이벤트 또는 기타 임의 이벤트를 찾습니다.

이상이 발견되면 트리거 시스템이 이를 찾도록 설정합니다. (127페이지의 *일시적인 이상 포착* 참조)



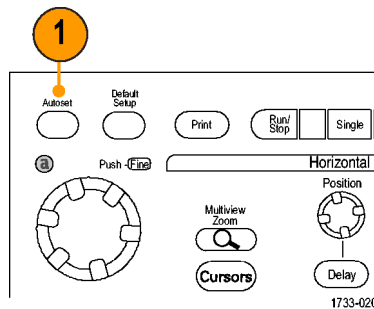
빠른 팁

- 세부 사항 또는 드문 이벤트의 포착을 최적화하려면 수평/획득(Horiz/Acq) > 수평/획득 설정(Horizontal/Acquisition Setup) > 획득(Acquisition) > 고속 획득(Fast Acq)을 선택한 다음 최적화(Optimize For) 세부 사항 포착(Capturing Details) 또는 드문 이벤트 포착(Capturing rare events)을 선택합니다.

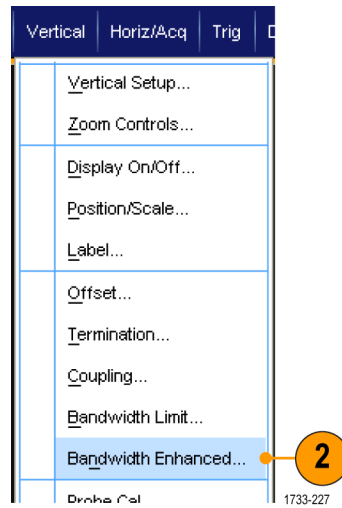
DSP 향상된 대역폭 사용

장비에 향상된 대역폭 기능이 있으면 DSP(디지털 신호 처리) 향상된 대역폭을 사용하여 상승 시간을 보다 정확하게 측정함으로써 대역폭을 확장하고 패스밴드를 전체 샘플 속도로 플랫폼화할 수 있습니다. 향상된 대역폭은 활성화된 채널 전체에 대해 일치하는 응답을 제공하여 채널 간 비교 및 차동 측정을 수행할 수 있도록 합니다.

1. 자동 설정(AUTOSET)을 눌러 수평, 수직 및 트리거 컨트롤을 설정하거나, 해당 컨트롤을 수동으로 설정합니다.



2. 수직 (Vertical) > 향상된 대역폭...(Bandwidth Enhanced...)을 선택합니다 .



3. 향상된 디지털 필터(DSP)(Digital Filters (DSP) Enhanced)를 클릭하여 향상된 대역폭을 켭니다. DSP를 활성화하려면 샘플 속도를 올바르게 설정해야 합니다.
4. DSP 필터를 활성화하는 일정 샘플 속도를 강제로 설정하려면 **일정 샘플 속도 강제(Force Constant Sample Rate)**를 선택합니다.

주석노트. 아직 설정하지 않은 경우 일정 샘플 속도를 선택하여 수평 모드를 일정 샘플 속도로 설정하고 DSP를 허용하도록 샘플 속도를 설정하고 DSP 대역폭을 선택합니다.

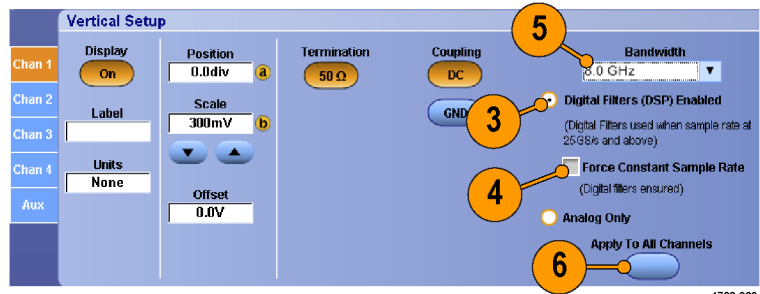
5. **대역폭(Bandwidth)** 목록에서 원하는 대역폭을 선택합니다.

사용 가능한 대역폭 항목은 장비, 프로브 및 프로브 팁에 따라 다릅니다.

아날로그만 해당(Analog Only)을 선택하면 하드웨어(HW) 대역폭이 선택됩니다.

6. 선택 항목을 모든 채널에 적용하려면 **모든 채널에 적용(Apply To All Channels)**을 선택합니다.

다른 프로빙으로 인해 장비에서 모든 채널을 동일하게 설정할 수 없는 경우 각 채널은 가능한 한 가장 가까운 대역폭 값으로 설정됩니다.



1733-239

향상된 대역폭이 켜지면 수직 판독값에 대역폭 표시기가 나타납니다.



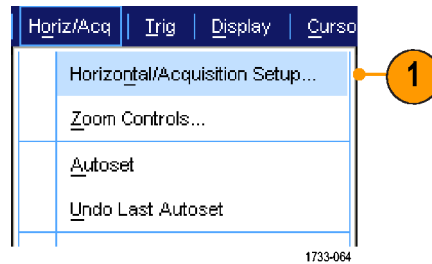
빠른 팁

- 파형 처리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 채널 대역폭 및 기타 향상된 대역폭 설정을 선택할 수 있는 메뉴가 나타납니다.
- DSP 향상된 대역폭은 최대 샘플 속도로 발생합니다.
- 신호의 상승 시간이 50 ps 미만일 때 DSP 향상된 대역폭을 사용하십시오.
- 높은 파형 처리량이 필요하거나 신호가 범위를 초과하는 경우 또는 고유한 DSP 사후 처리를 사용하려는 경우에는 아날로그만 해당(Analog Only)을 선택합니다.
- 수직(Vertical) > 대역폭 제한(Bandwidth Limit)을 선택한 다음 대역폭을 선택하여 장비 대역폭을 제한할 수 있습니다.

롤 모드 사용

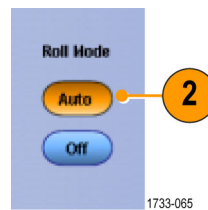
롤 모드는 저주파수 신호를 위한 스트립 차트 레코더와 비슷한 디스플레이를 제공합니다. 롤 모드에서는 전체 파형 레코드가 획득될 때까지 기다리지 않고도 획득한 데이터 포인트를 볼 수 있습니다.

1. 수평/획득(Horiz/Acq) > 수평/획득 설정...(Horizontal/Acquisition Setup...)을 선택합니다.



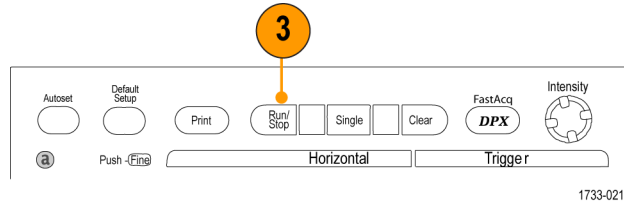
2. 선택되어 있지 않은 경우 **획득(Acquisition)** 탭을 클릭합니다. **자동(Auto)**을 클릭하여 롤 모드를 켭니다.

주석노트. 롤 모드를 사용하려면 샘플, 피크 검출 또는 Hi Res 획득 모드를 사용해야 합니다.



3. 롤 모드에서 획득을 정지하려면

- 단일 순서에 있지 않은 경우 **실행/정지(RUN/STOP)**를 눌러 롤 모드를 정지합니다.
- 단일 순서에 있는 경우에는 완전한 레코드가 획득되면 롤 모드 획득이 자동으로 정지됩니다.



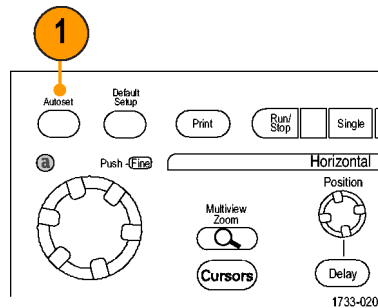
빠른 팁

- 엔벨로프, 평균 또는 WfmDB 획득 모드로 전환하면 롤 모드가 꺼집니다.
- 롤 모드는 수평 스케일을 50ms/div 보다 빠르게 설정할 경우 비활성화됩니다.

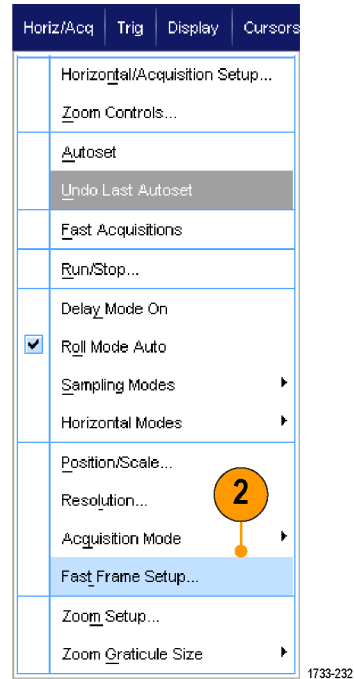
FastFrame 모드 사용

FastFrame을 사용하면 많은 트리거 이벤트를 대형 레코드에 단일 레코드로 포착한 다음 각 레코드를 개별적으로 보고 측정할 수 있습니다. 시간 소인은 특정 프레임의 절대 트리거 시간 및 지정된 두 프레임의 트리거 간의 상대 시간을 표시합니다.

1. **자동 설정(AUTOSET)**을 눌러 수평, 수직 및 트리거 컨트롤을 설정하거나, 해당 컨트롤을 수동으로 설정합니다.

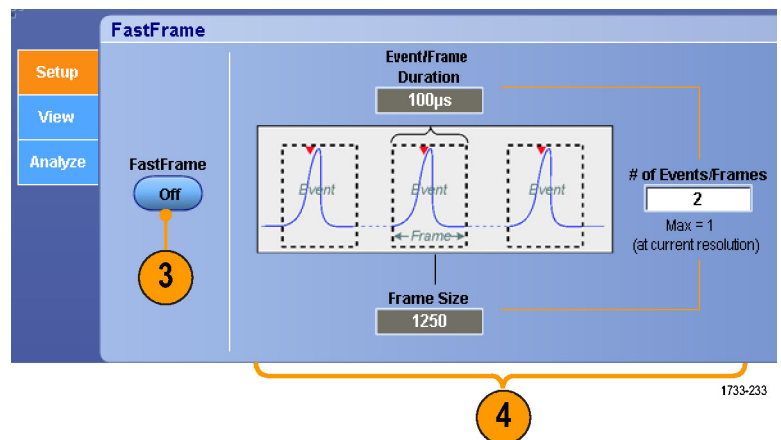


2. 수평 / 획득 (Horiz/Acq) > Fast-Frame 설정 ...(FastFrame Setup...)을 선택합니다.

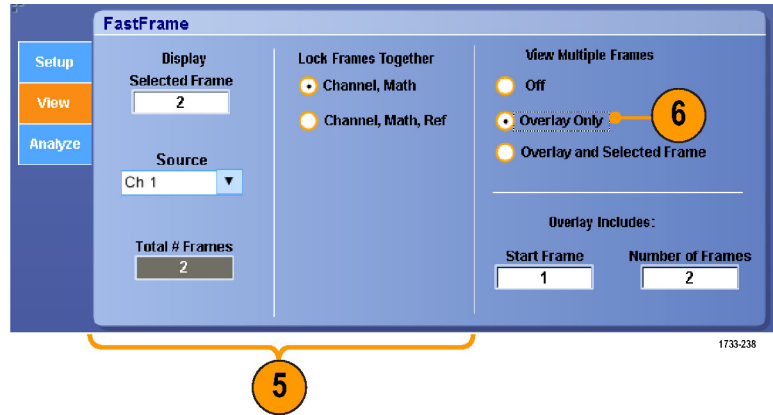


3. FastFrame On을 누릅니다.

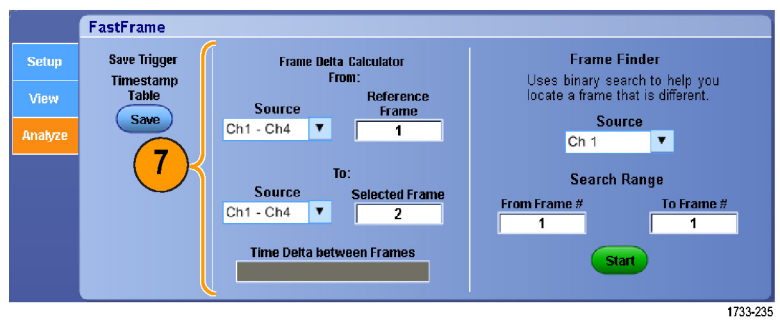
4. 프레임 크기 (Frame Size) 및 이벤트 프레임 수 (# of Events Frames)를 선택합니다. 범용 노브를 사용하여 각각을 설정합니다. 프레임 수는 포착할 트리거 이벤트 수를 나타냅니다. 프레임 크기는 각 트리거 이벤트 또는 프레임과 함께 저장될 샘플 수입니다. 모든 레코드를 저장하기에 메모리가 부족한 경우에는 프레임 수가 줄어듭니다.



5. 프레임 보기(Frame Viewing) 컨트롤을 사용하여 볼 프레임을 선택합니다.
6. 여러 프레임이 서로 겹치게 표시되도록 하려면 오버레이(Overlay)를 선택합니다.



7. 시간 소인(Time Stamps) 컨트롤을 사용하여 기준 프레임의 소스 및 프레임 수를 선택합니다. 두 프레임 간의 상대 시간을 측정할 때는 기준 프레임에서부터 시작합니다.



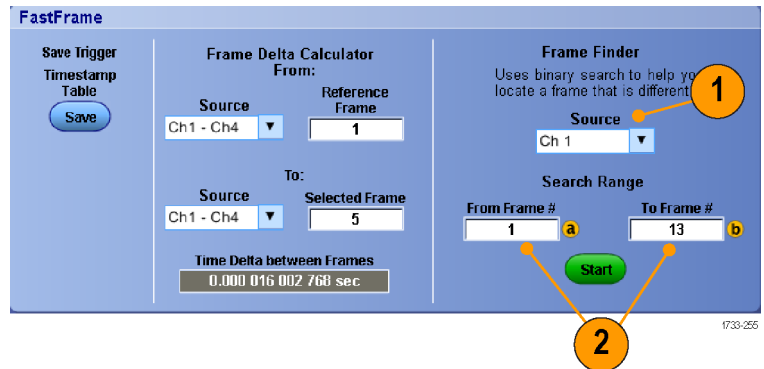
빠른 팁

- 이후 분석 또는 시각적 검사를 위해 각 트리거와 관련된 데이터를 보존하려는 경우에는 FastFrame을 사용하십시오.
- 다중 이벤트를 포착하려는 경우, 각 이벤트 간에 포착할 필요가 없는 데드 시간이 길다면 Fast-Frame을 사용하십시오.
- 다중 프레임은 일반, 녹색 또는 회색 컬러 팔레트에서 가장 잘 볼 수 있습니다. 온도 또는 스펙트럼을 사용하는 경우 진한 파란색으로 선택한 프레임은 구분하기가 어렵기 때문입니다.

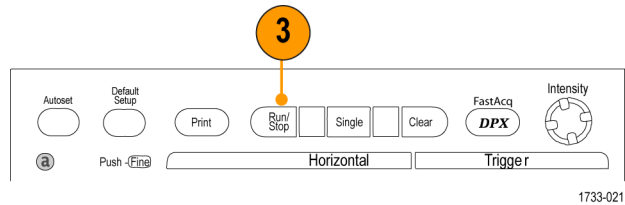
FastFrame 프레임 검색기 사용

프레임 검색기를 사용하면 다른 프레임과 구별되는 FastFrame 프레임을 찾을 수 있습니다.

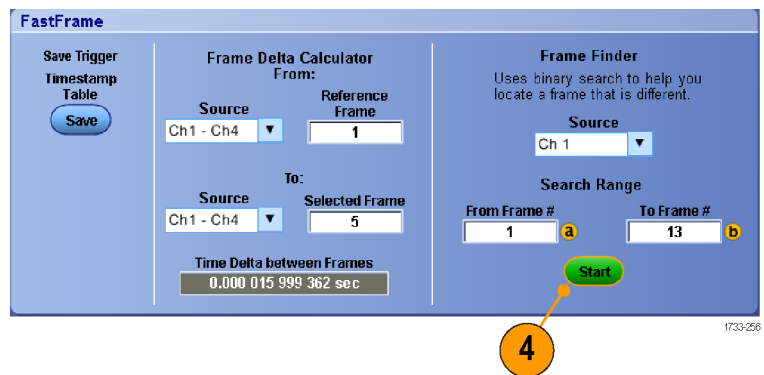
1. FastFrame 프레임의 소스를 선택합니다.
2. 처음 프레임 수(From Frame #)와 마지막 프레임 수(To Frame #)를 입력하여 검색 범위를 설정합니다.



3. 획득을 정지하려면 실행/정지(Run/Stop)를 누릅니다.

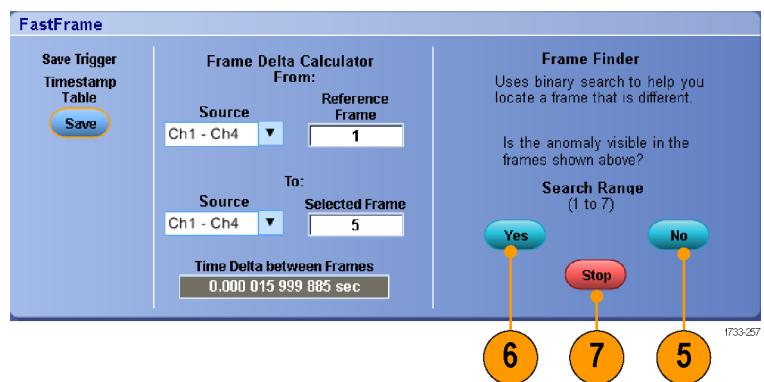


4. 검색을 시작하려면 시작(Start)을 누릅니다.

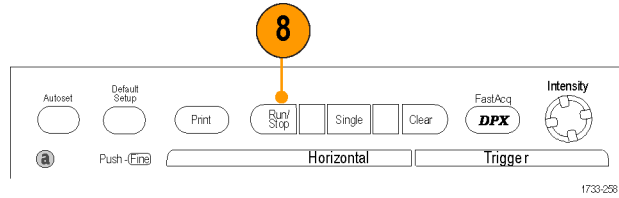


프레임 검색기는 다른 프레임을 검색하여 표시합니다.

5. 찾고 있는 이상이 표시된 프레임에 없는 경우 아니오(No)를 누릅니다. 프레임 검색기는 다른 프레임을 검색합니다.
6. 찾고 있는 이상이 표시된 프레임에 있는 경우 예(Yes)를 누릅니다.
7. 검색을 완료했으면 정지(Stop)를 누릅니다.



8. 획득을 재시작하려면 실행/정지 (Run/Stop)를 누릅니다.



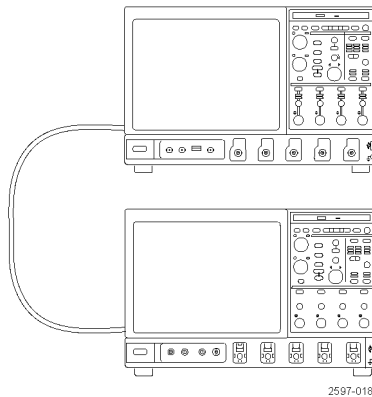
TekLink 및 MultiScope 트리거 사용

5개 이상의 채널을 단일 트리거 이벤트와 연결하려면 채널에서 문제를 조사 중인 5개 이상의 채널을 얻거나 TekLink를 사용하는 5개 이상의 입력으로 큰 AND 게이트를 만드십시오.

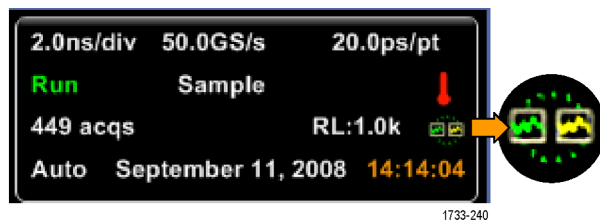
주석노트. MultiScope 트리거를 사용할 때는 B 트리거를 사용할 수 없습니다.

두 대의 장비 연결

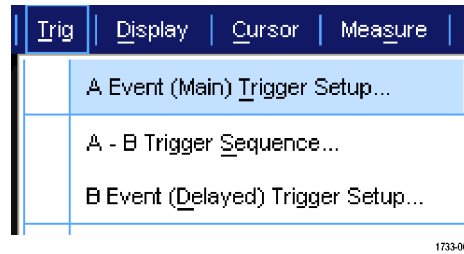
1. TekLink 케이블을 사용하여 두 대의 장비를 연결합니다.



2. TekLink 연결 상태는 수평 판독값에 표시됩니다.



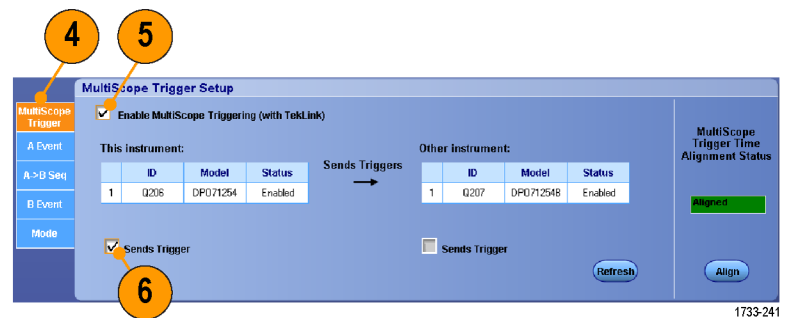
3. 트리거(Trig) > A 이벤트(주) 트리거 설정...(A Event (Main) Trigger Setup...)을 선택합니다.



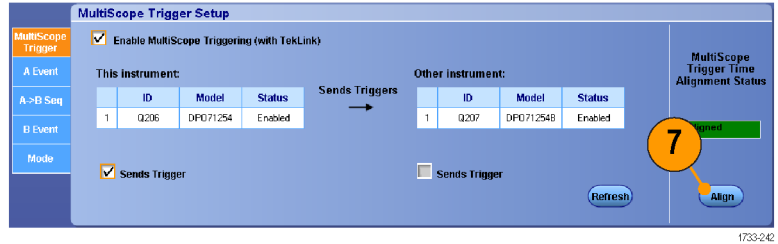
4. MultiScope 트리거 (MultiScope Trigger) 탭을 선택합니다.

5. TekLink로 MultiScope 트리거링 활성화(Enable MultiScope Triggering (with TekLink))를 선택하여 MultiScope 트리거링을 활성화합니다.

6. 장비를 활성화하여 장비-장비 설정에서 두 장비를 트리거하려면 트리거 보내기(Sends Trigger)를 선택합니다. 다른 장비는 트리거를 수신하도록 자동 설정됩니다. 허브를 사용하지 않는 경우 트리거를 제공하는 장비에서 모든 트리거 유형을 사용할 수 있습니다.



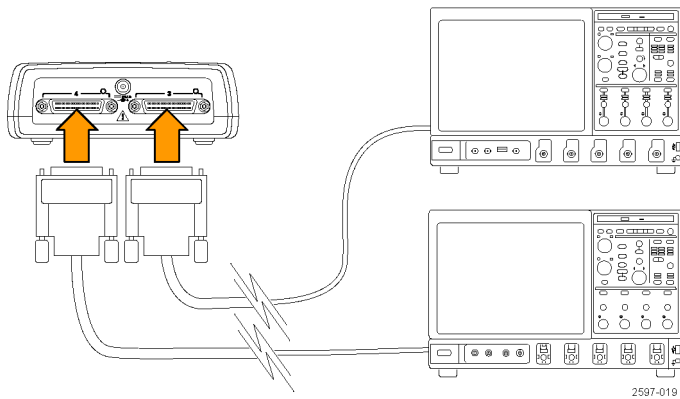
7. MultiScope 트리거를 교정하려면 교정(Calibrate) 버튼을 누릅니다.



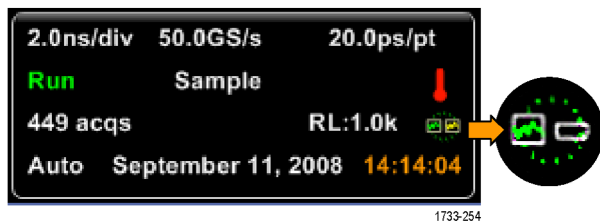
여러 대의 장비 연결

TekLink 허브를 사용하여 두 대 이상의 장비를 연결할 수 있습니다.

1. TekLink 허브 및 케이블을 사용하여 두 대 이상의 장비를 연결합니다.



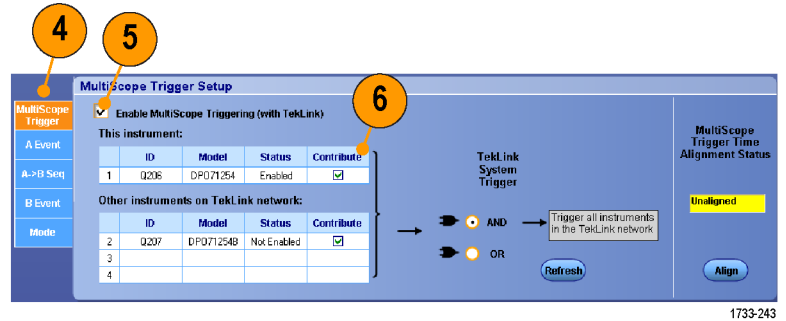
2. TekLink 연결 상태는 수평 판독값에 표시됩니다.



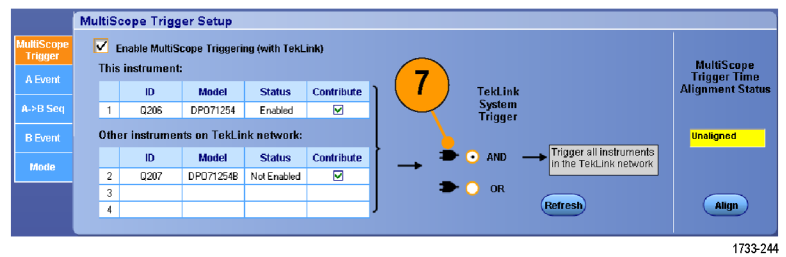
3. 트리거(Trig) > A 이벤트(주) 트리거 설정...(A Event (Main) Trigger Setup...)을 선택합니다.



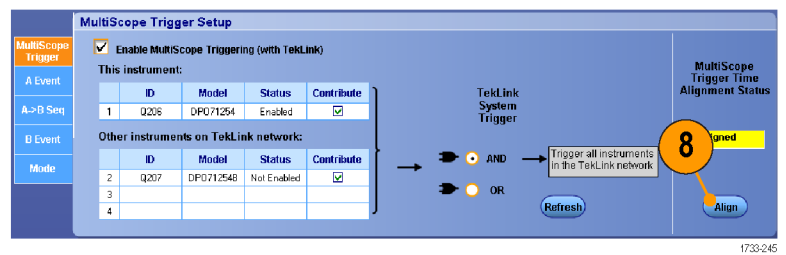
4. MultiScope 트리거 (MultiScope Trigger) 탭을 선택합니다.
5. TekLink로 MultiScope 트리거링 활성화(Enable MultiScope Triggering (with TekLink))를 선택하여 MultiScope 트리거링을 활성화합니다.
6. 장비를 활성화하여 TekLink 설정에서 트리거를 공급하려면 포함(Contribute)을 선택합니다. 다른 장비는 트리거를 수신하도록 자동 설정됩니다.



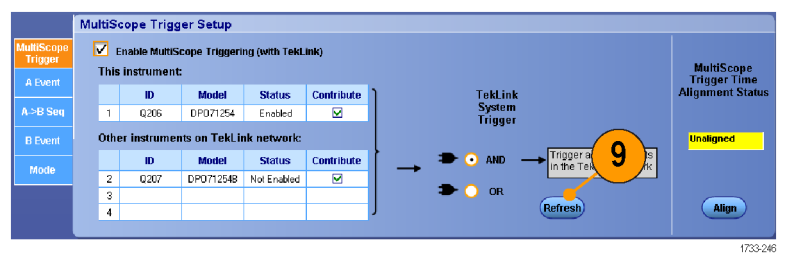
7. AND를 선택하거나, TekLink 설정에서 모든 장비를 트리거하기 전에 포함된 모든 트리거를 결합하도록 OR를 선택합니다.
허브를 사용하는 AND 트리거링은 에지 및 패턴 트리거 유형에서 작동합니다.
허브를 사용하는 OR 트리거링은 모든 트리거 유형에서 작동합니다.



8. MultiScope 트리거를 정렬하려면 정렬(Align) 버튼을 누릅니다.



9. 장비가 TekLink 네트워크를 검색하여 TekLink 네트워크에 연결된 장비를 확인하게 하려면 새로 고침(Refresh) 버튼을 누릅니다.



10. MultiScope 트리거링이 활성화되면 트리거 판독값에 표시됩니다.



Pinpoint 트리거

Pinpoint 트리거 시스템은 A 및 B 트리거에서 모두 사용할 수 있는 고급 트리거 유형과 함께 제공되며, 특정 이벤트 횟수 또는 특정 시간 이후 B 이벤트가 발생하지 않는 경우 트리거 순서를 재설정할 수 있습니다. Pinpoint 트리거는 가장 복잡한 트리거 이벤트 또는 트리거 이벤트 순서를 기준으로 하는 이벤트 포착을 지원합니다.

이 절에는 트리거 시스템 사용을 위한 개념 및 절차가 포함되어 있습니다.

트리거링 개념

트리거 이벤트

트리거 이벤트는 파형 레코드의 0시간 포인트를 설정합니다. 모든 파형 레코드 데이터는 해당 포인트와 관련된 시간 내에 위치합니다. 장비는 계속해서 파형 레코드의 사전 트리거 부분을 채우기에 충분한 샘플 포인트를 획득 및 유지합니다. 트리거 이벤트가 발생하면 장비가 파형 레코드의 사후 트리거 부분을 만들기 위해 샘플을 획득합니다. 사후 트리거 부분은 트리거 이벤트 뒤 또는 오른쪽에 표시됩니다. 트리거가 인식되면 획득이 완료되고 홀드오프 시간이 만료될 때까지 장비에서 다른 트리거를 받아들이지 않습니다.

트리거 모드

트리거 모드는 트리거 이벤트 부재 시 장비가 동작하는 방법을 결정합니다.

- 보통 트리거 모드에서는 트리거된 경우에만 장비가 파형을 획득할 수 있습니다. 트리거가 발생하지 않으면 마지막으로 획득한 파형 레코드가 디스플레이에 유지됩니다. 마지막 파형이 없으면 파형이 표시되지 않습니다.
- 자동 트리거 모드에서는 트리거가 발생하지 않아도 장비가 파형을 획득할 수 있습니다. 자동 모드는 트리거 이벤트가 발생한 후 시작되는 타이머를 사용합니다. 타이머 시간이 초과되기 전에 검출된 다른 트리거 이벤트가 없으면 장비가 강제로 트리거됩니다. 트리거 이벤트를 대기하는 시간은 시간 기반 설정에 따라 다릅니다.

자동 모드는 유효한 트리거링 이벤트 부재 시 강제 트리거할 경우 디스플레이의 파형과 동기화되지 않습니다. 파형은 화면을 가로질러 표시됩니다. 유효한 트리거가 발생하면 안정적으로 표시됩니다.

트리거 설정(Trigger Setup) 제어창의 강제 트리거(Force Trigger) 버튼을 눌러 예지-트리거 모드에서 장비가 강제로 트리거되도록 할 수도 있습니다.

트리거(Trig) > 모드(Mode) 메뉴에서 트리거 모드를 선택합니다. 자세한 내용은 장비 온라인 도움말을 참조하십시오.

트리거 홀드오프

트리거 홀드오프를 통해 획득 시작 후 이후의 트리거 인식이 제한되는 기간을 연장하여 트리거링을 안정시킬 수 있습니다. 이러한 연장은 시스템이 되풀이되는 이벤트 버스트의 남은 이벤트를 건너뛰므로 항상 각 버스트의 첫 번째 이벤트에서 트리거할 수 있도록 돕습니다. 장비가 원치 않는 트리거 이벤트에서 트리거될 경우 홀드오프를 조정하여 안정적인 트리거링을 얻을 수 있습니다.

트리거(Trig) > 홀드오프(Holdoff) 메뉴에서 트리거 홀드오프를 설정합니다. 자세한 내용은 장비 온라인 도움말을 참조하십시오.

트리거 커플링

트리거 커플링은 신호의 어떤 부분을 트리거 회로로 전달할지 결정합니다. 에지 트리거링에서는 제공되는 모든 커플링 유형을 사용할 수 있습니다. 여기에는 AC, DC, 저주파수 제거, 고주파수 제거 및 노이즈 제거 등이 있습니다. 다른 모든 트리거 유형은 DC 커플링만 사용합니다.

트리거(Trig) > A 이벤트(주) 트리거 설정(A Event (Main) Trigger Setup) 메뉴에서 트리거 커플링을 선택합니다. 자세한 내용은 장비 온라인 도움말을 참조하십시오.

수평 위치

수평 위치는 파형 레코드에서 트리거가 발생하는 위치를 정의합니다. 수평 위치를 사용하면 트리거 이벤트 이전 및 이후에 장비가 획득하는 양을 선택할 수 있습니다. 트리거 이전에 발생하는 레코드 부분은 사전 트리거 부분이고 트리거 이후에 발생하는 레코드 부분이 사후 트리거 부분입니다.

사전 트리거 데이터는 문제를 해결할 때 유용하게 사용할 수 있습니다. 예를 들어 테스트 회로에서 원치 않는 글리치의 원인을 찾으려는 경우 글리치에서 트리거하고 글리치 전에 데이터를 포착할 수 있을 만큼 사전 트리거 주기를 크게 할 수 있습니다. 글리치 전에 어떤 상황이 발생하는지 분석하면 글리치의 원인을 찾아내는 데 도움이 되는 정보를 얻을 수 있습니다. 트리거 이벤트로 인해 시스템에서 일어나는 상황을 확인하려면 사후 트리거 주기를 트리거 이후의 데이터를 포착할 수 있을 만큼 길게 설정하십시오.

기울기 및 레벨

기울기 컨트롤은 장비가 신호의 상승 또는 하강 에지 중 어디에서 트리거 포인트를 찾는지 결정합니다. 레벨 컨트롤은 해당 에지에서 트리거 포인트가 발생하는 위치를 결정합니다.

지연된 트리거 시스템

A(주) 트리거 시스템 하나만으로 트리거할 수도 있고, A(주) 트리거와 B(지연) 트리거를 결합해 순차적 이벤트에 대해 트리거할 수도 있습니다. 순차적 트리거링을 사용할 경우 A 트리거 이벤트는 트리거 시스템을 준비하고 B 트리거 이벤트는 B 트리거 상태가 충족되면 장비를 트리거합니다. A 및 B 트리거는 일반적으로 별도의 소스를 갖고 있습니다. B 트리거 상태는 시간 지연이나 지정된 이벤트 수를 기반으로 할 수 있습니다. (54페이지의 *A(주) 트리거 및 B(지연) 트리거 사용* 참조)

트리거 유형 선택

장비 전면에서 기본 트리거 매개 변수를 수정할 수 있으며 트리거 설정 제어창에서 고급 트리거를 설정할 수 있습니다.

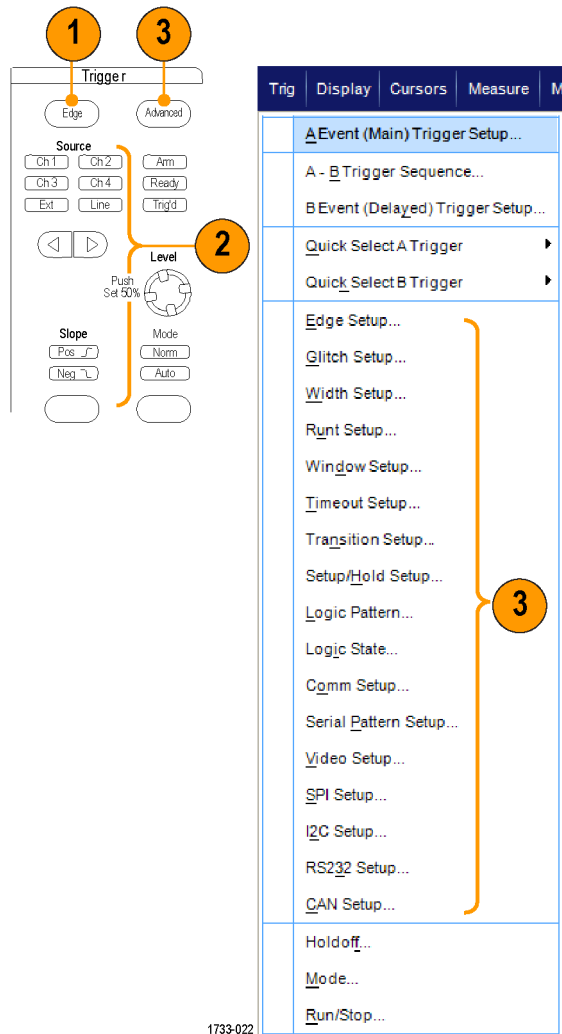
주석노트. 일부 장비에서는 일부 트리거 유형을 선택할 수 없습니다.

1. 에지(EDGE)를 누릅니다.

2. 소스, 기울기 및 모드를 설정합니다. 커플링을 설정하려면 트리거 (Trig) > 에지 설정 (Edge Setup) 메뉴를 사용합니다.

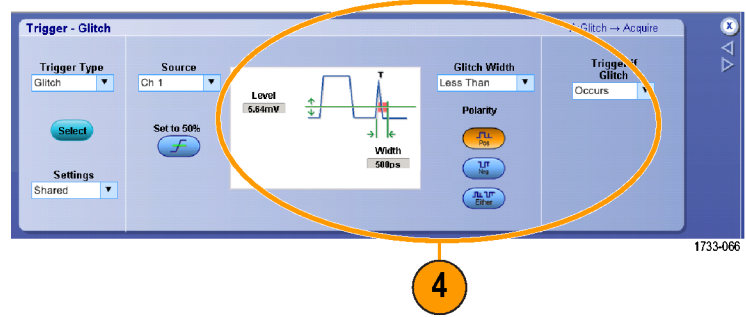
3. 다른 트리거 유형 중 하나를 선택하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

- 고급 (ADVANCED) 을 누릅니다.
- 트리거 (Trig) 메뉴에서 직접 트리거 유형을 선택합니다.



1733-022

4. 해당 트리거 유형에 대해 표시되는 컨트롤을 사용하여 트리거 설정을 완료합니다. 트리거 설정을 위한 컨트롤은 트리거 유형에 따라 다릅니다.



Pinpoint 트리거 선택

트리거 유형		트리거 상태
에지		기울기 컨트롤로 정의된 상승 에지 또는 하강 에지에서 트리거됩니다. 커플링 선택 사항으로는 DC, AC, LF 제거, HF 제거 및 노이즈 제거가 있습니다.
글리치		지정된 폭보다 좁거나 넓은 펄스에서 트리거하거나 지정된 폭보다 좁거나 넓은 글리치를 무시합니다.
폭		지정된 시간 범위 내 또는 밖에 있는 펄스에서 트리거합니다. 포지티브나 네거티브 펄스에서 트리거할 수 있습니다.
런트		하나의 임계는 교차하지만 첫 번째 임계를 다시 교차하기 전에 두 번째 임계를 교차하지 못하는 펄스 진폭에서 트리거됩니다. 포지티브 또는 네거티브 런트를 검출하거나 지정된 폭보다 넓은 런트만을 검출할 수 있습니다. 이러한 펄스를 다른 채널의 논리 상태로 검정할 수도 있습니다.
창		입력 신호가 상단 임계 레벨보다 높게 상승하거나 하단 임계 레벨보다 낮게 하강하면 트리거됩니다. 신호가 임계 창으로 들어오거나 나가면 장비를 트리거합니다. 넓으면 트리거(Trigger When Wider) 옵션을 사용하여 시간을 기준으로 트리거 이벤트를 검정하거나, 논리적이면 트리거(Trigger When Logic) 옵션을 사용하여 다른 채널의 논리 상태를 기준으로 검정합니다.
타임아웃		지정된 시간 내에 펄스가 검출되지 않으면 트리거됩니다.
변이		지정된 시간보다 빠르거나 느린 속도로 두 임계 사이를 횡단하는 펄스 에지에서 트리거됩니다. 펄스 에지는 포지티브 또는 네거티브일 수 있습니다.

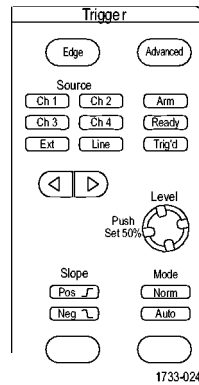
트리거 유형	트리거 상태
직렬	 최대 1.25Gb/s의 데이터 속도로 64비트 직렬 패턴에서 트리거되며 (4GHz 미만 모델), 최대 3.125Gb/s(4GHz 이상 모델에만 해당함) 또는 5Gb/s(4GHz 이상 B 모델)의 데이터 속도로 40비트 직렬 패턴에서 트리거됩니다. 무작위 비트 시퀀스를 잠급니다. 옵션 PTM 또는 PTH가 필요합니다. 이 모드에는 클럭 복구가 포함됩니다. 클럭 복구를 다시 초기화하려면 50% 설정 누름(Push Set 50%) 노브를 누릅니다. 패턴 잠금으로 설정하면 반복되는 긴 PRBS(무작위 비트 시퀀스)를 자동으로 검색해 잠급니다. 이렇게 잠근다는 것은 장비가 무작위 비트 시퀀스의 비트 길이를 알고 있고 사이클이 반복되는 시기를 예측할 수 있다는 것을 의미합니다. 패턴 잠금을 사용하면 장비는 뛰어난 시간 기준 정확도로 데이터 패턴의 특정 위치에서 샘플을 얻을 수 있습니다.
패턴	 로직 입력으로 인해 선택한 기능이 True 또는 False가 될 때 트리거됩니다. 트리거하기 전에 일정 시간 동안 로직 상태를 만족해야 하도록 지정할 수도 있습니다.
상태	 선택한 로직 함수에 대한 모든 로직 입력으로 인해 클럭 입력 상태가 변경될 때 함수가 True 또는 False가 되면 트리거됩니다.
셋업 및 홀드	 로직 입력의 상태가 셋업 및 홀드 시간 내에서 클럭에 상대적으로 변경되면 트리거됩니다. 이 모드는 셋업 앤 홀드 위반 시 트리거됩니다.
통신	 통신 코드 및 표준에 대한 마스크 테스트와 함께 트리거됩니다. 컨트롤은 함께 작동하여 트리거 이벤트의 매개 변수를 정의합니다(옵션 MTM 또는 MTH에서 사용 가능함). 이 모드에는 클럭 복구가 포함됩니다. 클럭 복구를 다시 초기화하려면 50% 설정 누름 노브를 누릅니다.
비디오	 복합 비디오 신호의 지정된 필드 또는 라인에서 트리거됩니다. 복합 신호 형식만 지원됩니다.
SPI	 SPI(직렬 주변기기 인터페이스) 신호에서 트리거됩니다.
I ² C	 Inter-IC 컨트롤(I²C) 신호 (시작, 정지, 반복되는 시작, 인식 누락, 주소, 데이터, 주소 및 데이터)에서 트리거됩니다.
RS-232	 RS-232 신호에서 트리거됩니다.
CAN	 CAN 버스 신호에서 트리거됩니다.

트리거 상태 확인

전면 패널의 상태 라이트 또는 판독값을 통해 트리거 상태를 확인할 수 있습니다.

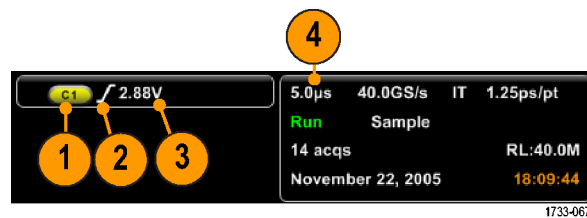
트리거 상태를 확인하려면 준비 (ARM), 준비 완료 (READY) 및 트리거 (TRIG'D) 전면 패널 컨트롤을 확인하십시오.

- 트리거가 켜져 있으면 장비가 유효한 트리거를 인식했으며 파형의 사후 트리거 부분을 채우고 있는 것입니다.
- 준비 완료가 켜져 있으면 장비가 유효한 트리거 발생을 승인할 수 있으며 발생을 기다리고 있는 것입니다. 사전 트리거 데이터가 획득됩니다.
- 준비가 켜져 있으면 트리거 회로가 파형 레코드의 사전 트리거 부분을 채우고 있는 것입니다.
- 트리거 및 준비 완료가 모두 켜져 있으면 유효한 A 이벤트 트리거가 인식되었으며 장비가 지연된 트리거를 기다리고 있는 것입니다. 지연된 트리거가 인식되면 지연된 파형의 사후 트리거 부분이 채워집니다.
- 준비, 트리거 및 준비 완료가 모두 꺼져 있으면 획득이 정지된 것입니다.



일부 주요 트리거 매개 변수를 신속하게 결정하려면 디스플레이 하단의 트리거 판독값을 확인하십시오. 판독값은 에지 및 고급 트리거에서 다음과 같이 각각 다릅니다.

1. 트리거 소스 = Ch1
2. 트리거 기울기 = 상승 에지
3. 트리거 레벨
4. 시간축



A(주) 트리거 및 B(지연) 트리거 사용

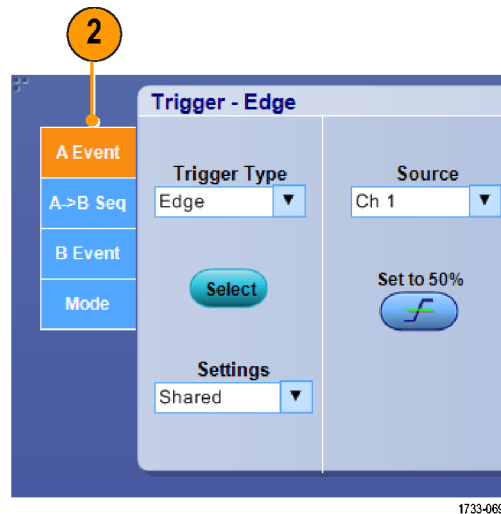
간단한 신호에 대해서는 A 이벤트(주) 트리거를 사용할 수 있으며, 주 트리거와 B 이벤트(지연) 트리거를 함께 사용하여 보다 복잡한 신호도 포착할 수 있습니다. A 이벤트가 발생하면 파형을 트리거 및 표시하기 전에 트리거 시스템이 B 이벤트를 검색합니다.

A 트리거

1. 트리거(Trig) > A 이벤트(주) 트리거 설정...(A Event (Main) Trigger Setup...)을 선택합니다.



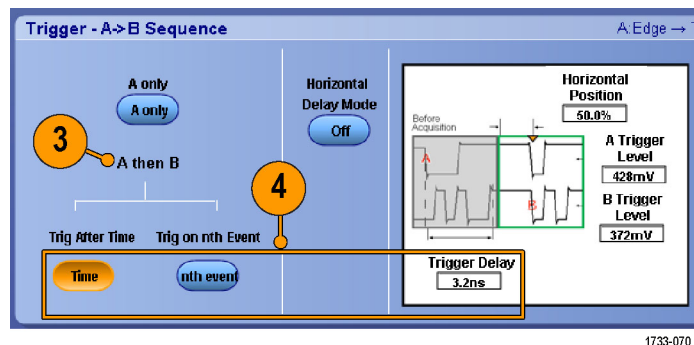
2. A 이벤트(A Event) 탭에서 A 트리거 유형 및 소스를 설정합니다.



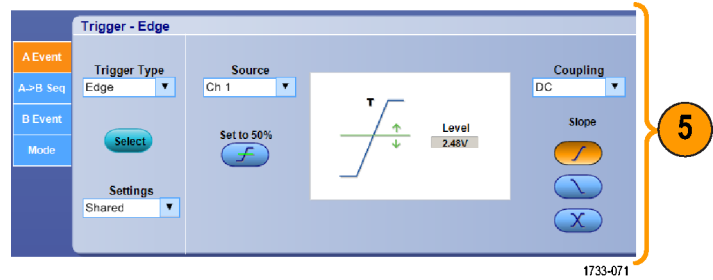
B 트리거(지연)

주석노트. B 트리거는 MultiScope 트리거가 활성화된 경우에는 사용할 수 없습니다.

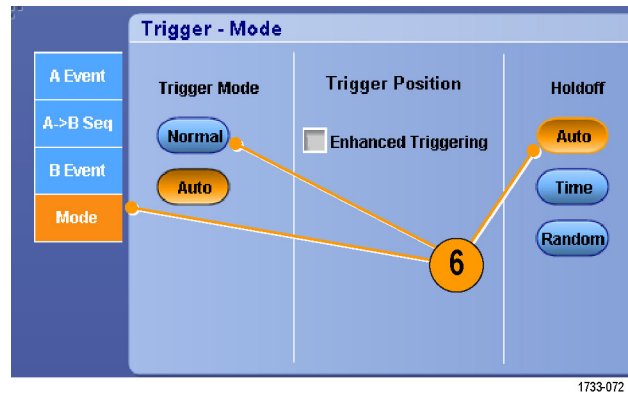
3. A → B 순서 (A → B Seq) 탭에서 함수를 선택합니다.
4. 트리거 지연 시간이나 B 이벤트의 수를 설정합니다.



5. B 이벤트 (지연)(B Event (Delayed)) 탭에서 B 트리거 특성을 설정합니다.

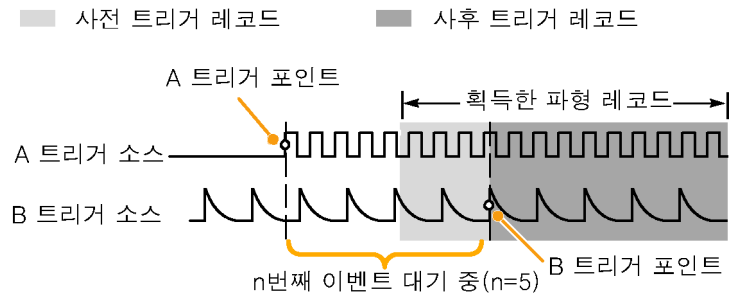


6. 모드(Mode) 탭에서 보통(Normal) 트리거 모드 및 자동(Auto) 홀드 오프를 선택합니다.



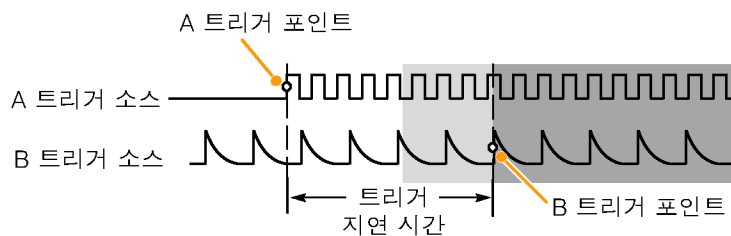
B 이벤트 트리거

A 트리거는 장비를 준비합니다. 사후 트리거 획득은 n번째 B 이벤트에서 시작됩니다.



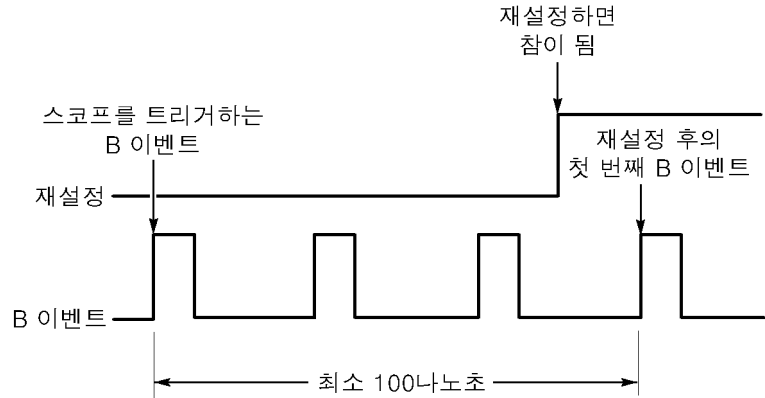
지연 시간 이후의 B 트리거

A 트리거는 장비를 준비합니다. 사후 트리거 획득은 트리거 지연 시간이 지난 후 첫 번째 B 에지에서 시작됩니다.



재설정과 함께 트리거링

트리거가 B 트리거 이벤트 전에 발생하면 트리거 시스템을 재설정하는 상태를 지정할 수 있습니다. 재설정 이벤트가 발생하면 트리거 시스템은 B 이벤트를 기다리지 않으며 A 이벤트를 다시 기다리게 됩니다.



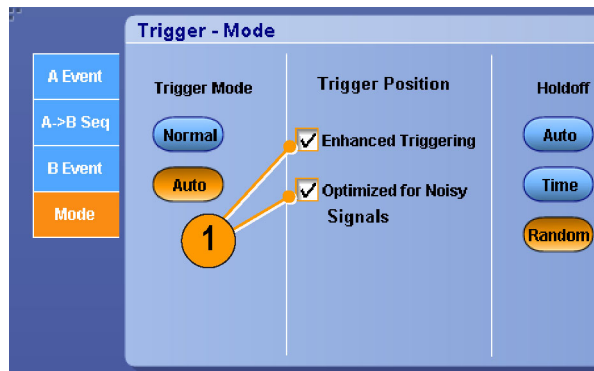
빠른 팁

- B 트리거 지연 시간과 수평 지연 시간은 독립적인 기능입니다. A 트리거 혹은 A 트리거와 B 트리거를 둘 다 사용해서 트리거 조건을 수립했을 때, 수평 지연을 사용해서 추가적으로 획득을 지연시킬 수 있습니다.

트리거 위치 보정

트리거 위치 보정은 데이터 경로와 트리거 경로의 차이를 보정하여 표시된 파형에 트리거를 더 정확하게 배치합니다. 또한 트리거 위치 보정 시 노이즈 신호에 트리거를 더 정확하게 배치할 수 있도록 평균화를 사용할 수 있습니다. 디스플레이에 에지 트리거를 더 정확하게 배치하려면 다음 절차를 수행하십시오.

1. 디스플레이에 트리거를 더 정확하게 배치하려면 **향상된 트리거링 (Enhanced Triggering)**을 선택합니다. 또한 노이즈 신호에 트리거를 더 정확하게 배치하려면 **노이즈 신호에 최적화(Optimized for Noisy Signals)**를 선택합니다. 노이즈 신호에 최적화(Optimized for Noisy Signals) 선택 항목은 **향상된 트리거링 (Enhanced Triggering)**을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.

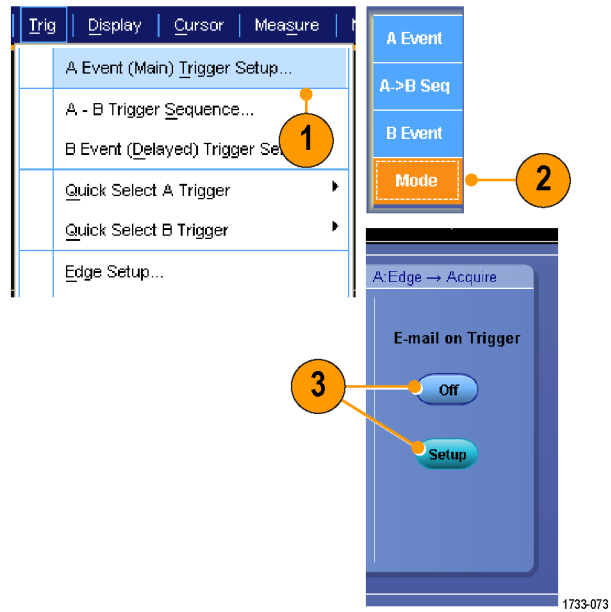


1733-259

트리거 시 전자 우편 전송

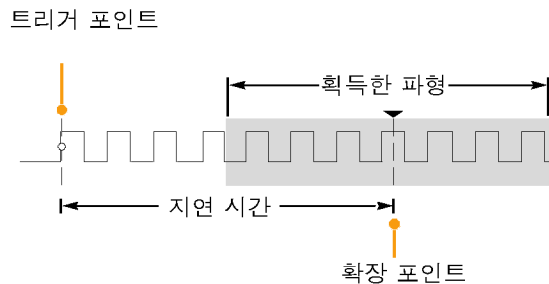
다음 절차를 수행하기 전에 이벤트에 대해 전자 우편을 구성해야 합니다. (135페이지의 *이벤트 시 전자 우편 설정* 참조)

1. 트리거(Trig) > A 이벤트(주) 트리거 설정...(A Event (Main) Trigger Setup...)을 선택합니다.
2. 모드(Mode) 탭을 선택합니다.
3. 트리거 시 전자 우편(E-mail on Trigger) 아래에서 On을 클릭한 다음 설정(Setup)을 클릭합니다. (135페이지의 *이벤트 시 전자 우편 설정* 참조)

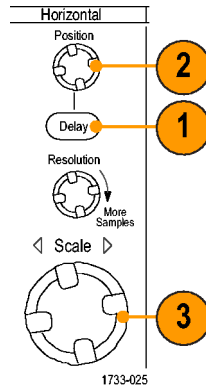


수평 지연 사용

트리거 위치로부터 상당한 시간을 두고 분리되어 있는 지역에 있는 파형의 세부사항을 획득하려면 수평 지연을 사용합니다.



1. 지연(DELAY)을 누릅니다.
2. 수평 위치 (POSITION) 콘트롤로 지연 시간을 조정하거나 콘트롤 창에 지연 시간을 입력합니다.
3. 수평 스케일(SCALE)을 조정하여 원하는 세부사항을 획득합니다.



빠른 팁

- MultiView Zoom 및 수평 지연을 동시에 사용하여 지연된 획득을 확대할 수도 있습니다.
- 수평 지연을 켜거나 꺼서 서로 다른 두 관심 영역, 즉 트리거 위치 근처의 한 위치와 지연 시간을 중심으로 하는 다른 위치의 신호 세부사항을 빠르게 비교할 수 있습니다.

파형 표시

이 절에는 파형을 표시하는 개념 및 절차가 설명되어 있습니다. 자세한 내용은 온라인 도움말에서 확인할 수 있습니다.

화면 형태 설정

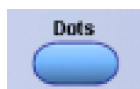
화면 형태를 설정하려면 **디스플레이 (Display) > 화면 형태 (Display Style)**를 선택하고 다음 형태 중 하나를 선택하십시오.



파형을 레코드 포인트 간에 그려진 선으로 표시합니다.



1733-075



파형 레코드 포인트를 화면에 도트로 표시합니다.



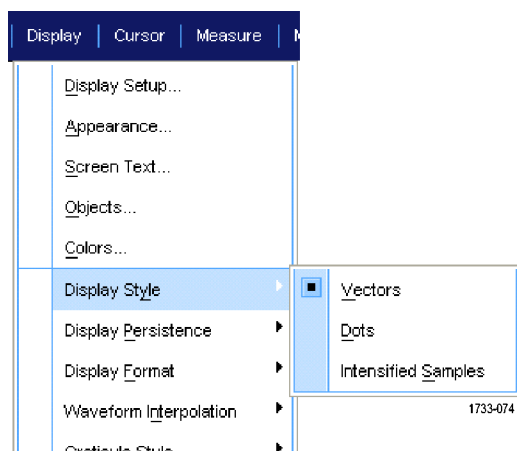
1733-076



실제 샘플을 표시합니다. 보간된 포인트는 표시되지 않습니다.



1733-077

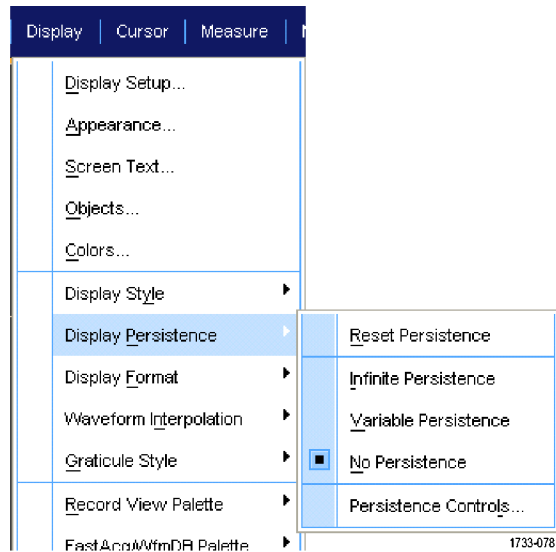


1733-074

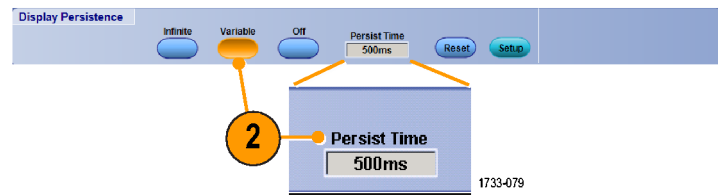
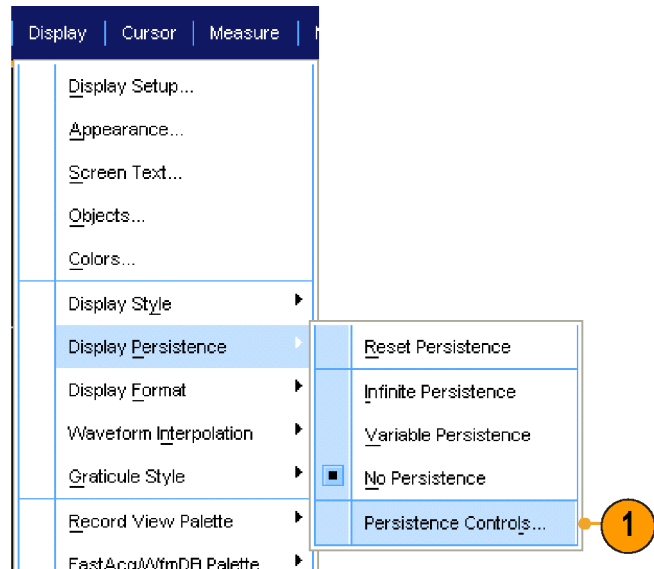
화면 지속 설정

화면 (Display) > 화면 지속 (Display Persistence)을 선택하고 지속 유형을 선택합니다.

- 지속 없음(No persistence)은 현재 획득의 레코드 포인트만을 표시합니다. 각각의 새 파형 레코드가 채널에 대해 이전에 획득한 레코드를 교체합니다.
- 무한대 지속(Infinite persistence)은 사용자가 획득 표시 설정 중 하나를 변경할 때까지 계속해서 레코드 포인트를 누적합니다. 보통 획득 엔벨로프 밖에서 발생할 수 있는 포인트를 표시하는 데 사용합니다.
- 변수 지속(Variable persistence)은 지정된 시간 간격 동안 레코드 포인트를 누적합니다. 각 레코드 포인트는 시간 간격에 따라 독립적으로 소멸됩니다.
- 지속 재설정(Reset persistence)은 지속 기능을 해제합니다.



1. 변수 지속 시간을 설정하려면 디스플레이(Display) > 화면 지속(Display Persistence) > 지속 컨트롤...(Persistence Controls...)을 선택합니다.
2. 변수(Variable), 지속 시간(Persist Time)을 클릭한 다음 범용 노브를 사용하여 지속 시간을 설정합니다.

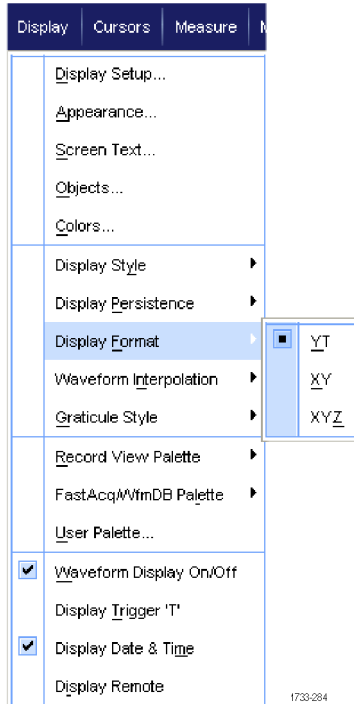


디스플레이 형식 설정

장비에는 파형이 서로 다른 세 가지 형식으로 표시될 수 있습니다. 필요에 가장 잘 맞는 형식을 선택하십시오.

디스플레이(Display) > 디스플레이 형식(Display Format)을 선택합니다.

- 시간에 따라 변화하는 신호 진폭을 표시하려면 **YT** 형식을 선택합니다.
- 파형 레코드 포인트별 진폭을 비교하려면 **XY** 형식을 선택합니다.
다음 채널을 비교합니다.
Ch 1(X) 및 Ch 2(Y),
Ch 3(X) 및 Ch 4(Y),
Ref 1(X) 및 Ref 2(Y),
Ref 3(X) 및 Ref 4(Y)
- Ch 1(X) 및 Ch 2(Y) 파형 레코드의 전압 레벨을 XY 형식처럼 포인트별로 비교하려면 **XYZ** 형식을 선택합니다. 표시된 파형 밝기는 Ch 3(Z) 파형 레코드에 의해 변조됩니다. XYZ 형식이 트리거됩니다. Ch 3에서의 -5 구간 신호(위치 및 오프셋 포함)는 빈 화면을 보여주고 +5 구간 신호는 전체 밝기를 보여줍니다.



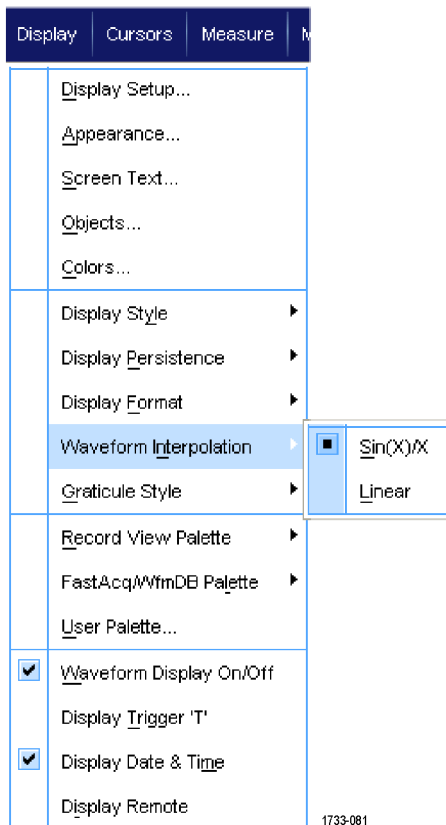
빠른 팁

- XY 형식은 리사주 패턴 등의 위상 관계를 확인하는 데 특히 유용합니다.
- XY 형식은 지속을 가질 수는 있지만 도트 전용 디스플레이입니다. XY 형식을 선택한 경우에는 벡터 스타일을 선택해도 해당 스타일이 적용되지 않습니다.

파형 보간 선택

디스플레이(Display) > 파형 보간(Waveform Interpolation)을 선택하고 다음 중 하나를 선택합니다.

- Sin(x)/x 보간은 실제 획득한 값 간의 곡선 맞춤을 사용하여 레코드 포인트를 계산합니다.
- 선형 보간은 직선 맞춤을 사용하여 실제로 획득하는 샘플 간의 레코드 포인트를 계산합니다.

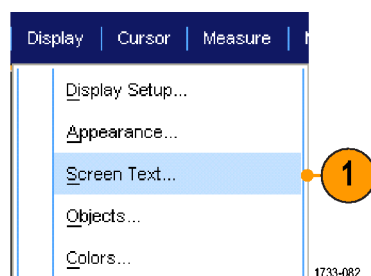


빠른 팁

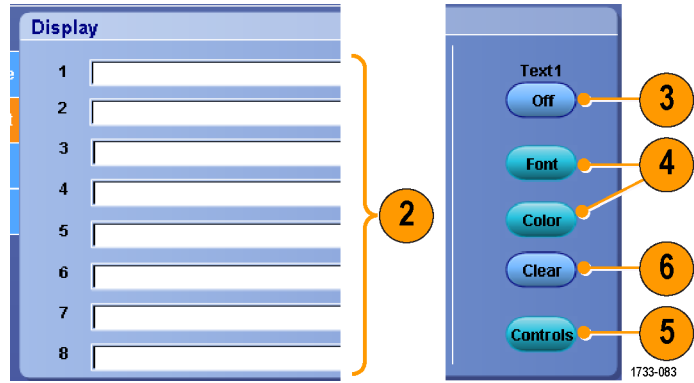
- Sin(x)/x 보간이 기본 보간 모드입니다. 이 보간은 파형을 정확하게 표현하는 데 선형 보간보다 적은 실제 샘플 포인트를 필요로 합니다.

화면 문자 추가

1. 디스플레이(Display) > 화면 문자(Screen Text)를 선택합니다.



2. 문자를 8줄까지 입력합니다.
3. 문자 디스플레이를 켜고 끄려면 문자 **끄기(OFF)** 또는 **켜기(ON)**를 클릭합니다.
4. 화면 문자의 글꼴과 색을 선택하려면 **글꼴(Font)** 또는 **색(Color)**을 클릭합니다.
5. 디스플레이에 문자의 위치를 지정하기 위한 문자 등록 정보(Text Properties) 제어창을 열려면 **컨트롤(Controls)**을 클릭합니다.
6. 선택한 줄의 문자를 모두 지우려면 **삭제(Clear)**를 클릭합니다.

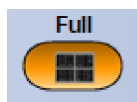


빠른 팁

- 화면 문자를 클릭하고 끌어 화면에서 위치를 변경할 수 있습니다.

계수선 유형 설정

계수선 유형을 설정하려면 디스플레이(Display) > 계수선 유형(Graticule Style)을 선택하고 다음 유형 중 하나를 선택합니다.



1733-085

파형 매개 변수를 빨리 예측하는 데 사용합니다.



1733-086

십자선이 필요하지 않은 경우 커서 및 자동 판독값과 함께 전체 화면 측정 기능을 보는 데 사용합니다.



1733-087

자동 판독값 및 기타 데이터를 위해 보다 많은 공간을 남겨 두면서 파형을 빠르게 예측하는 데 사용합니다.



1733-088

표시 기능이 필요하지 않은 경우 자동 판독값 및 기타 화면 문자와 함께 사용합니다.



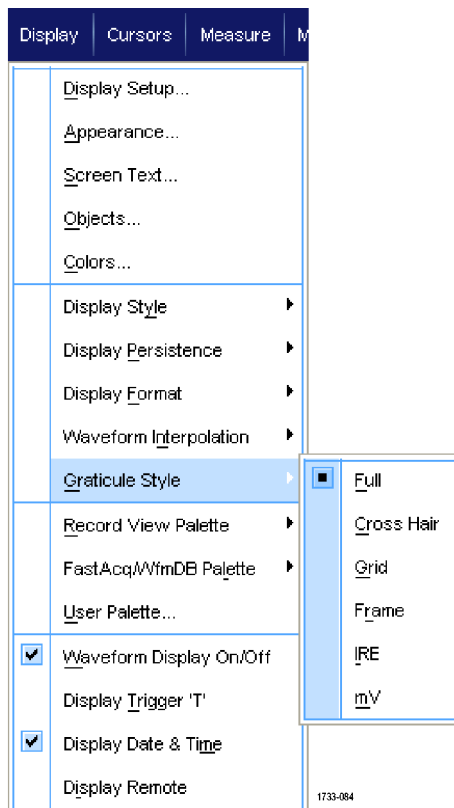
1733-201

NTSC 비디오 신호에 사용합니다.



1733-202

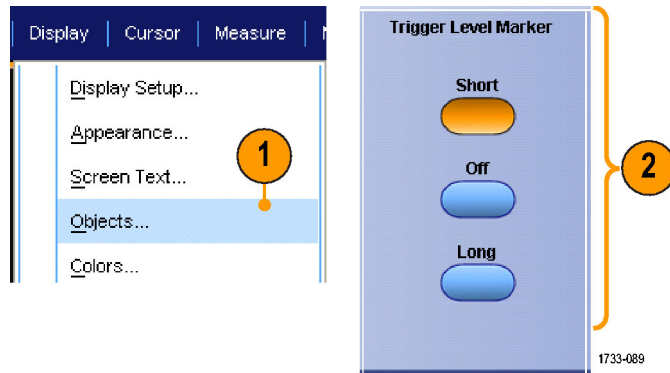
NTSC 이외의 비디오 신호에 사용합니다.



1733-084

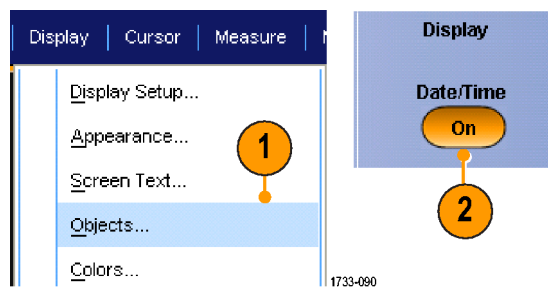
트리거 레벨 마커 설정

1. 디스플레이 (Display) > 오브젝트...(Objects...)를 선택합니다.
2. 다음 중 하나를 선택합니다.
 - **짧음 (Short)**을 선택하면 계수선의 측면에 짧은 화살표가 표시됩니다.
 - **김 (Long)**을 선택하면 계수선을 가로질러 수평선이 표시됩니다.
 - **Off**를 선택하면 트리거 레벨 마커가 꺼집니다.



날짜 및 시간 표시

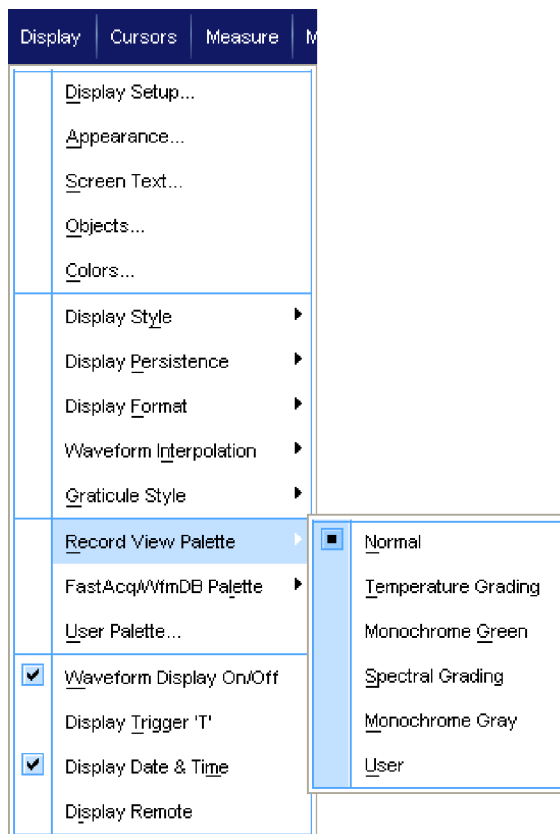
1. 디스플레이 (Display) > 오브젝트...(Objects...)를 선택합니다.
2. 계수선의 날짜 및 시간 표시를 전환합니다. 유틸리티 (Utilities) 메뉴를 사용하여 날짜 및 시간을 설정합니다.



컬러 팔레트 사용

디스플레이(Display) > 레코드 보기 팔레트(Record View Palette) 또는 고속 획득/WfmDB 팔레트(FastAcq/WfmDB Palette)를 선택하고 파형 및 계수선에 대해 다음 색 구성표 중 하나를 선택합니다.

- 보통 컬러 팔레트는 전체적으로 가장 잘 볼 수 있는 채도와 밝기를 표시합니다. 각 채널 파형의 색은 해당 전면 패널 수직 노브의 색과 일치합니다.
- 온도 그레이딩 컬러 팔레트는 샘플 밀도가 가장 높은 파형 영역을 빨간색 음영으로 표시합니다. 샘플 밀도 가장 낮은 영역은 파란색 음영으로 표시됩니다.
- 모노 녹색 컬러 팔레트는 샘플 밀도가 가장 높은 파형 영역을 연한 녹색 음영으로 표시합니다. 샘플 밀도 가장 낮은 영역은 진한 녹색 음영으로 표시됩니다. 이는 아날로그 오실로스코프 디스플레이와 가장 비슷합니다.



- 스펙트럼 그레이딩 컬러 팔레트는 샘플 밀도가 가장 높은 파형 영역을 파란색 음영으로 표시합니다. 샘플 밀도 가장 낮은 영역은 빨간색 음영으로 표시됩니다.
- 모노 녹색 컬러 팔레트는 샘플 밀도가 가장 높은 파형 영역을 연한 회색 음영으로 표시합니다. 샘플 밀도 가장 낮은 영역은 진한 회색 음영으로 표시됩니다.

- 사용자가 지정할 수 있는 컬러 팔레트는 사용자가 지정하는 색으로 파형을 표시합니다.

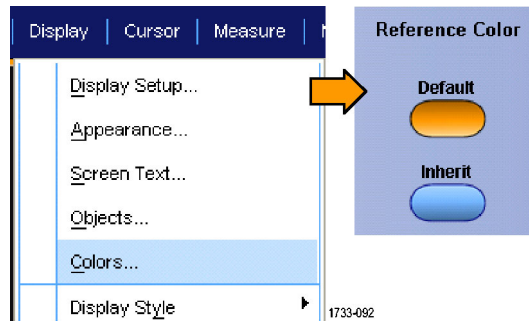
빠른 팁

- 디스플레이(Display) > 색(Colors) 제어창에서 컬러 그레이딩 팔레트 중 하나를 선택하면 여러 샘플 밀도가 서로 다른 색으로 표시됩니다.
- 컬러 팔레트는 레코드 보기용 및 고속 획득/WfmDB용의 두 개가 있습니다.

기준 색 설정

디스플레이(Display) > 색...(Colors...)을 선택하고 다음 중 하나를 선택합니다.

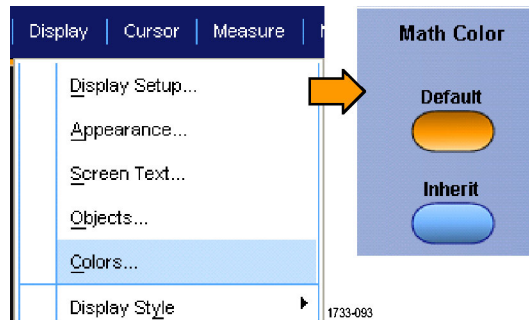
- 기준 파형에 대해 기본 시스템 색을 사용하려면 기본값(Default)을 선택합니다.
- 기준 파형에 대해 원래 파형과 같은 색을 사용하려면 상속(Inherit)을 선택합니다.



Math 색 설정

디스플레이(Display) > 색...(Colors...)을 선택하고 다음 중 하나를 선택합니다.

- Math 파형에 대해 기본 시스템 색을 사용하려면 기본값(Default)을 선택합니다.
- math 파형이 math 함수의 기준이 되는 숫자가 가장 낮은 채널과 같은 색을 사용하도록 하려면 상속(Inherit)을 선택합니다.



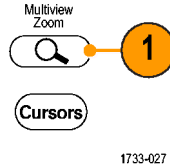
빠른 팁

- math 파형 및 기준 파형의 기본 색은 각 파형마다 다릅니다.

MultiView Zoom 사용

파형을 수평, 수직 또는 양방향으로 동시에 확대하려면 MultiView Zoom 기능을 사용합니다. 확대된 파형은 정렬하거나 잠그거나 자동으로 스크롤할 수 있습니다. 스케일 및 위치는 실제 파형 데이터가 아닌 디스플레이에만 영향을 줍니다.

1. MultiView Zoom을 누르면 화면이 나뉘면서 확대 계수선이 나타납니다.

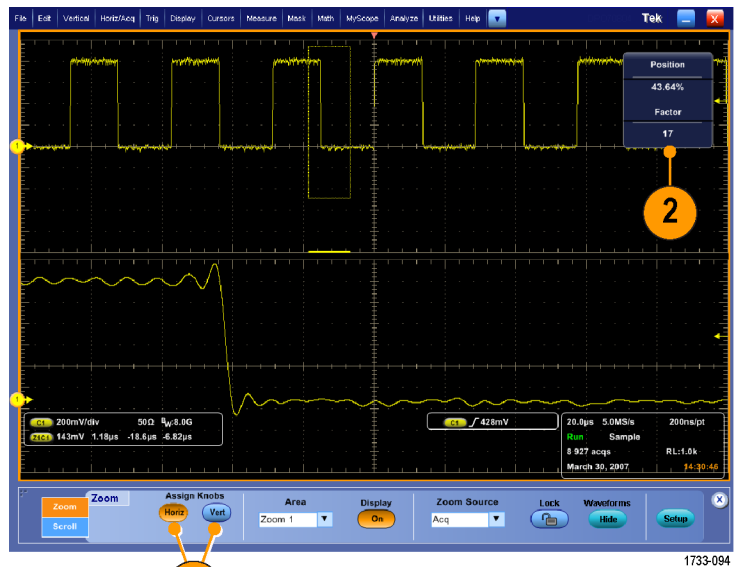


1733-027

2. 수평(HORIZ) 또는 수직(VERT)을 눌러 확대 계수선에서 확대할 축을 선택합니다. 범용 노브를 사용하여 확대된 파형의 스케일 및 위치를 조정할 수 있습니다.

이 예에서 주 계수선은 계수선의 상단부이고 확대된 계수선은 계수선의 하단부입니다.

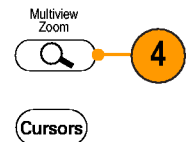
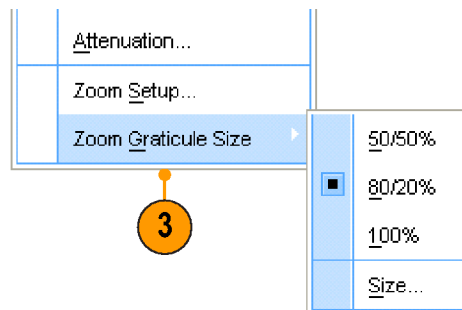
주석노트. 파형 숨기기(Hide)를 누른 다음 표시할 확대된 파형을 선택하여 확대된 파형을 숨기거나 표시할 수 있습니다.



1733-094

3. 확대 계수선 크기를 조정하려면 수직(Vertical) 또는 수평/획득(Horiz/Acq) 메뉴에서 확대 계수선 크기(Zoom Graticule Size)를 선택합니다.

4. 줌을 끄려면 전면 패널 버튼을 누릅니다.



1733-095

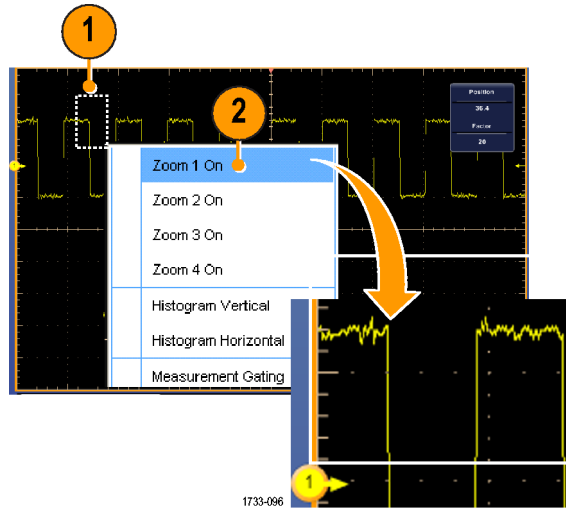
빠른 팁

- 확대 설정 메뉴를 사용하여 확대된 파형의 계수선 크기를 변경할 수도 있습니다.

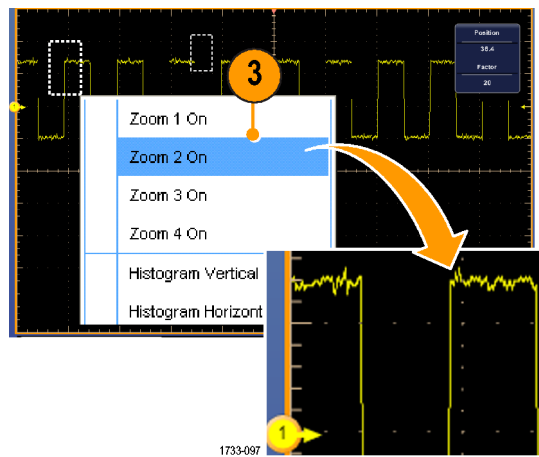
여러 영역 확대

한 레코드의 여러 영역을 동시에 보고 비교하려는 경우에는 다음 절차를 사용하십시오.

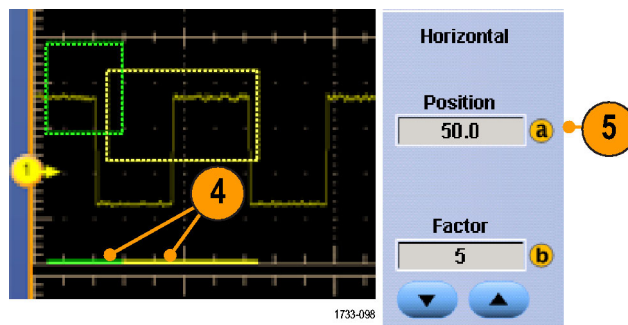
1. 확대할 파형 영역 주위로 상자를 그려 클릭하고 끕니다.
2. 줌 1 켜기(Zoom 1 On)를 선택합니다.



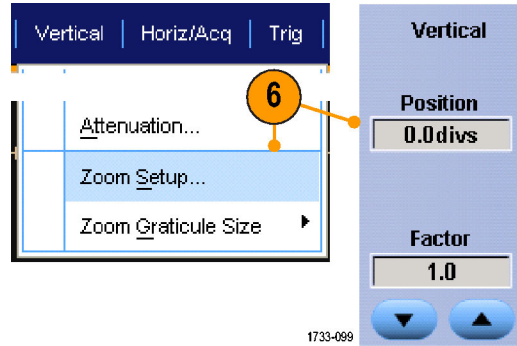
3. 확대할 파형의 다른 영역 주위로 상자를 그려 클릭하고 끈 다음 줌 2 켜기(Zoom 2 On)를 선택합니다.



4. 확대된 영역을 수평으로 조정하려면 줌(Zoom) 상자 아래의 수평 마커를 클릭하여 확대된 영역을 선택합니다.
5. 범용 노브를 사용하여 선택한 줌 영역의 수평 위치 및 계수를 조정합니다.



6. 확대된 영역을 수직으로 조정하려면 수직 (Vertical) > 줌 설정...(Zoom Setup...)을 선택하고 수직 필드를 클릭한 다음 범용 노브를 사용하여 수직 위치 및 계수를 조정합니다.

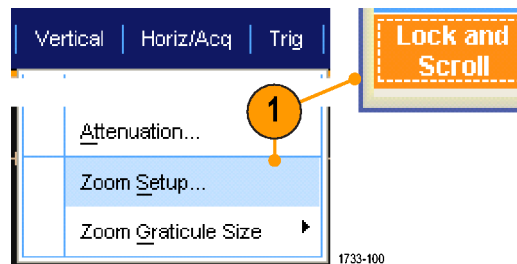


빠른 팁

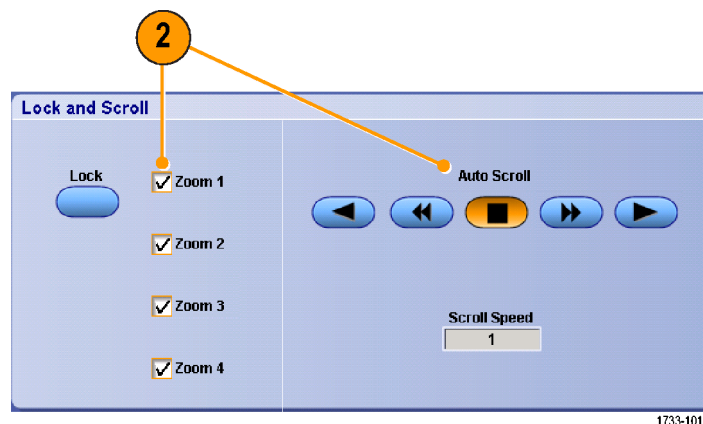
- 확대 영역을 삭제하려면 줌 설정 (Zoom Setup) 제어창에서 위치 계수 재설정 (Position Factor Reset)을 클릭합니다.
- 줌 설정 제어창에서 각 줌 디스플레이를 켜고 끌 수 있습니다.
- 모든 줌 디스플레이를 켜거나 끄려면 **MultiView Zoom** 버튼을 누릅니다.
- 확대된 영역의 위치를 수평으로 변경하려면 줌 상자 하단의 수평 마커를 클릭하여 끕니다.

확대된 파형 잠금 및 스크롤

1. 잠금 및 스크롤을 사용하려면 수직 (Vertical) 또는 수평/획득 (Horiz/Acq) 메뉴에서 줌 설정...(Zoom Setup...)을 선택한 다음 잠금 및 스크롤 (Lock and Scroll) 탭을 선택합니다.

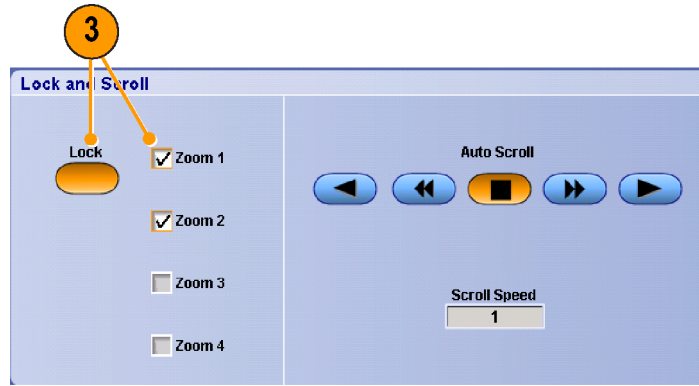


2. 확대된 단일 영역을 스크롤하려면 줌 1-4 (Zoom 1-4) 확인란 중 하나를 선택한 다음 자동 스크롤 (Auto Scroll) 버튼을 클릭합니다.



3. 확대된 여러 영역을 동시에 스크롤하려면 **잠금(Lock)**을 클릭한 다음 스크롤할 **줌 1-4(Zoom 1-4)** 확인란 중 스크롤할 줌을 선택합니다.

확대된 영역을 잠그면 상대 수평 위치도 잠깁니다. 하나의 잠겨 있는 확대된 영역의 수평 위치를 변경하면 모든 영역의 수평 위치가 변경됩니다.



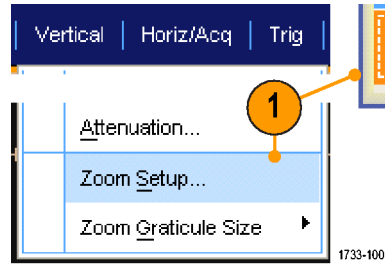
1733-102

빠른 팁

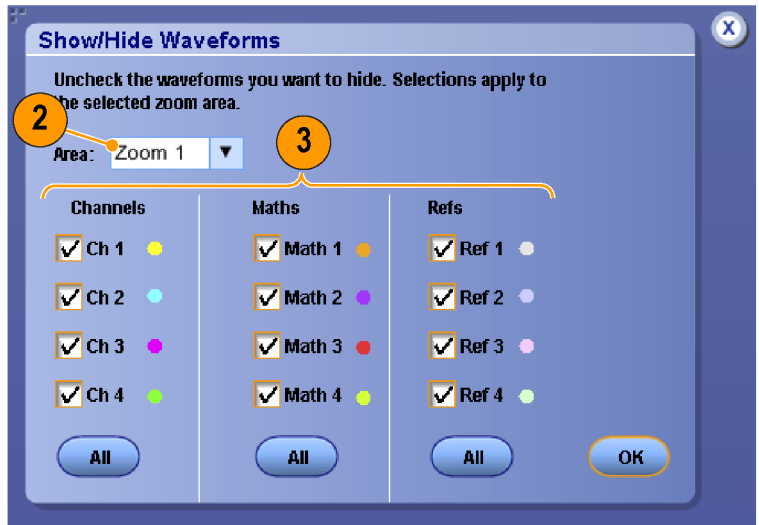
- 여러 확대 영역을 선택했지만 잠그지 않은 경우에는 가장 큰 숫자가 지정된 확대 영역이 자동 스크롤되고 다른 확대 영역은 고정된 상태로 유지됩니다.

확대된 창에서 파형 숨기기

1. 파형을 숨기거나 표시하려면 수직 (Vertical) 또는 수평 / 획득 (Horiz/Acq) 메뉴에서 **줌 설정...(Zoom Setup...)**을 선택하고 **컨트롤(Controls)**을 누른 다음 파형 숨기기(Hide)를 누릅니다.



2. 표시하거나 숨길 파형을 포함하고 있는 확대된 영역을 선택합니다.
3. 숨길 채널, math 또는 기준 파형을 선택 취소합니다.



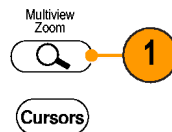
파형 검색 및 표시

획득한 파형에 원하는 위치를 표시할 수 있습니다. 이 표시는 분석을 파형의 특정 영역으로 제한하는데 도움이 됩니다. 파형의 영역이 일부 특수 기준을 만족하는 경우 이 영역을 자동으로 표시하거나 원하는 각 항목을 수동으로 표시할 수 있습니다. 표시 사이(원하는 구역 사이)를 이동할 수 있습니다. 고급 검색 및 표시(Advanced Search and Mark) 옵션을 사용하면 트리거할 수 있는 동일한 여러 매개 변수를 자동으로 검색 및 표시할 수 있습니다. 대부분의 검색 매개 변수는 트리거 시간 제한이 없습니다. Math 및 기준 파형을 검색할 수 있습니다. 특정 유형의 모든 획득한 이벤트를 검색할 수 있습니다.

검색 표시는 기준에 대한 파형 영역을 표시하는 방법을 제공합니다. 검색 기준으로 표시를 자동으로 설정할 수 있습니다. 특정 에지, 펄스 폭, 런트, 로직 상태, 상승/하강 시간, 셋업 앤 홀드 위반 및 버스 검색 유형을 사용하여 영역을 검색하고 표시할 수 있습니다.

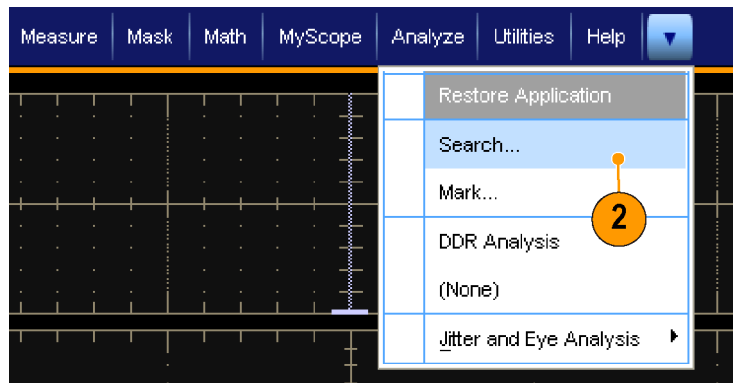
표시를 수동으로 설정하고 지우려면(삭제하려면)

1. Multiview Zoom을 누릅니다. 줌 1이 표시와 함께 사용됩니다.



1733-027

2. 분석(Analyze) > 검색(Search)을 선택합니다.



1733-305

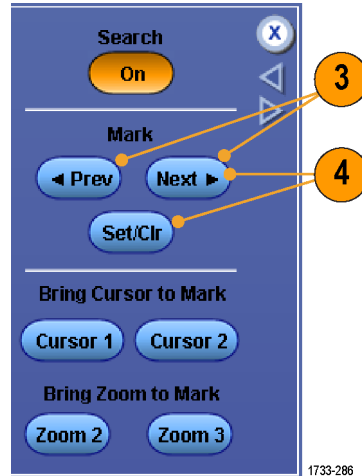
3. 범용 노브를 돌려 검색 표시를 설정하거나 지우려는 파형의 구역으로 줌 상자를 이동합니다.

다음(Next) 또는 이전(Prev) 버튼을 눌러 기존 표시로 이동합니다.

4. 설정/지우기(Set/Clr)를 누릅니다.

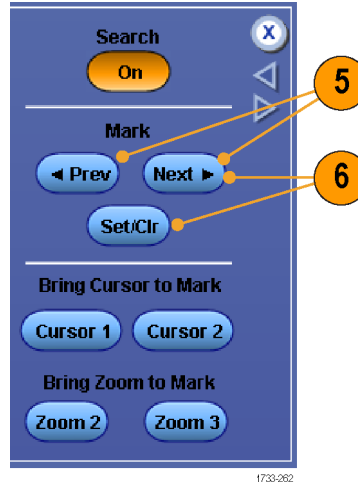
화면 중앙에 검색 표시가 없으면 장비가 하나를 추가합니다.

표시가 만들어지면 수평 줌 계수가 저장됩니다. 다음(Next) 또는 이전(Prev)을 사용하여 표시 사이를 이동할 경우 줌 계수가 복원됩니다.



1733-286

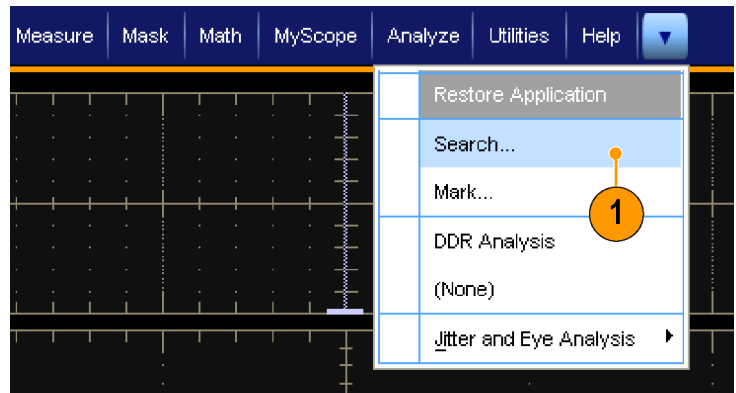
5. 검색 표시 사이를 이동하면서 파형을 조사합니다. **다음(Next)** 또는 **이전(Prev)** 버튼을 사용하여 다른 컨트롤은 조정하지 않으면서 표시된 위치 사이를 이동합니다.
6. 표시를 삭제합니다. **다음(Next)** 또는 **이전(Prev)** 버튼을 눌러 지우려는 표시로 이동합니다. 중앙에 있는 표시를 제거하려면 **설정/지우기(Set/Clr)**를 누릅니다. 이 사항은 자동 및 수동으로 만들어진 표시에 모두 적용됩니다.



1733-282

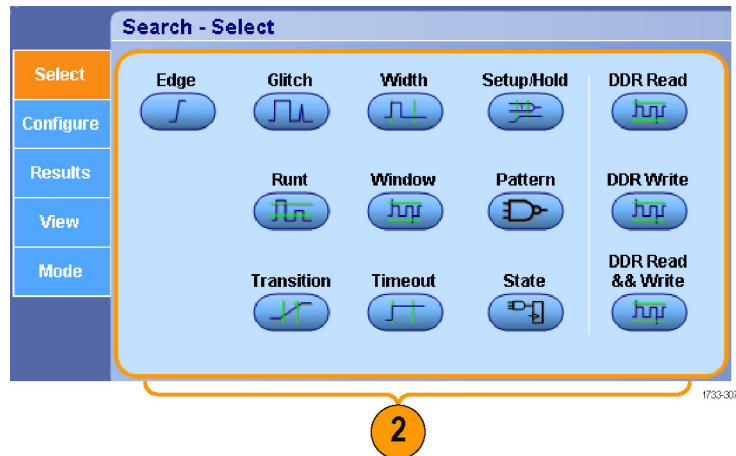
검색 표시를 자동으로 설정하고 지우려면(삭제하려면)

1. **분석(Analyze) > 검색(Search)**을 선택합니다.



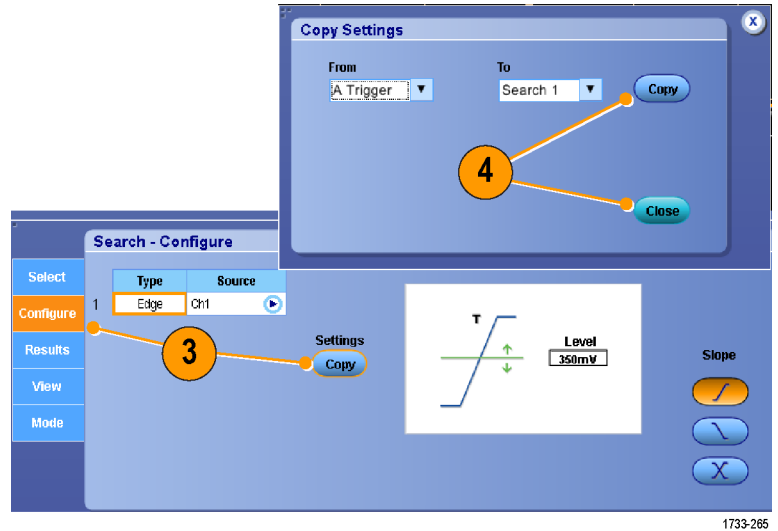
1733-306

2. 메뉴에서 원하는 검색 유형을 선택합니다.
검색 메뉴는 트리거 메뉴와 비슷합니다.
에지 유형이 표준이고 다른 검색 유형은 옵션입니다.



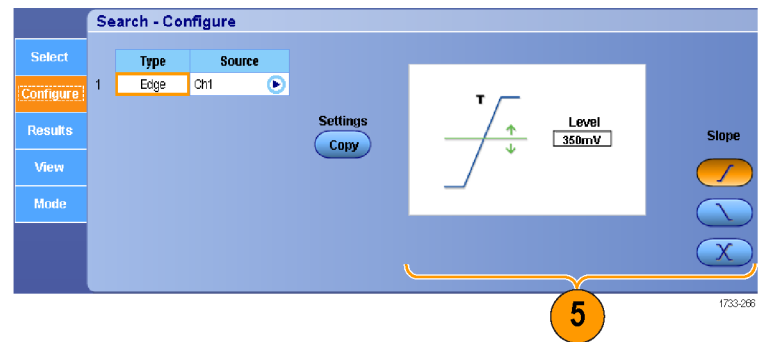
1733-307

- 구성 (Configure) 탭에서 검색을 설정합니다. 트리거 설정 또는 검색 설정을 복사하려면 설정 복사 (Settings Copy)를 누릅니다.
- 설정 복사(Copy Settings) 창에서 복사할 설정이 있는 위치와 설정을 복사할 위치를 선택합니다. 복사(Copy)를 누른 다음 닫기(Close)를 누릅니다.



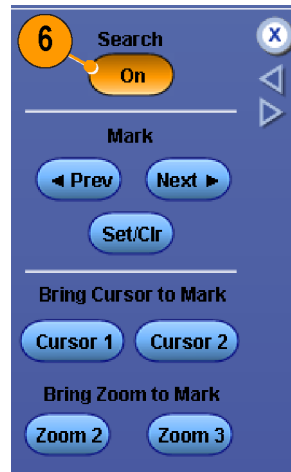
1733-265

- 현재 검색 설정을 수정하려면 표시된 컨트롤을 조정합니다. 표시된 컨트롤은 선택한 검색에 따라 다릅니다.



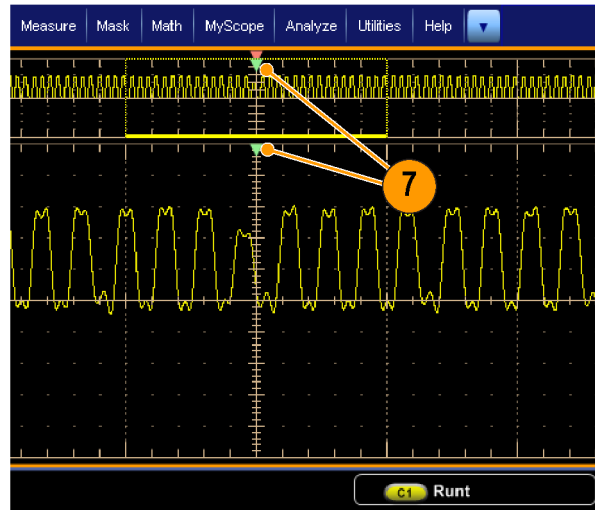
1733-266

- 아직 켜지지 않은 경우 검색 (Search)을 눌러 검색을 켜기(On)로 전환합니다.



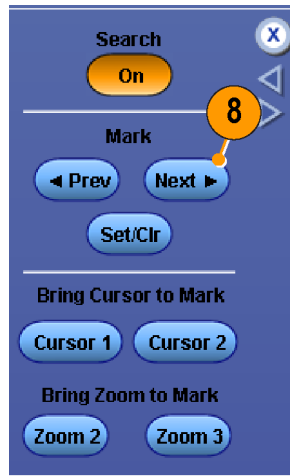
1733-267

7. 화면에서 삼각형은 자동 표시의 위치를 보여주고 흰색 삼각형은 사용자 정의 위치를 보여줍니다. 이 삼각형은 보통 및 확대된 파형 보기에 모두 나타납니다.



1733-268

8. 다음(Next) 및 이전(Prev) 화살표 버튼을 사용하여 표시 사이를 이동하면서 파형을 신속하게 살펴볼 수 있습니다. 다른 조정은 필요하지 않습니다.



1733-269

9. 검색 이벤트 카운트 또는 표시 시간 간에 표시를 전환하려면 **결과(Results)** 탭을 선택하고 보기(View) 카운트(Count)를 누릅니다.

10. 테이블에서 모든 표시를 지우려면 모든 표시(All Marks) 지우기(Clear)를 누릅니다.

11. 표시 테이블을 파일로 내보내려면 모든 표시(All Marks) 내보내기(Export)를 누릅니다.

Results: Mark Table

Index	Type	Src	Location	Time Delta					Description
				sec	ms	us	ns	ps	
1	Edge	C1	-203.12us						+Edge: level=853.63mV
2	User	C1	-229.36us	000	000	250	000	000	
3	Edge	C1	144.48us	000	000	031	600	000	+Edge: level=853.63mV
4	Edge	C1	-102.88us	000	000	094	660	000	+Edge: level=853.63mV
5	Edge	C1	69.04us	000	000	171	920	000	+Edge: level=853.63mV
6	Edge	C1	146us	000	000	076	959	999	+Edge: level=853.63mV
Total Marks: 7									
				ΔZ1,Z2					
				ΔZ2,Z3					
				ΔZ1,Z3					

Search Marks: Save Save All Clear Digits >> << Digits

All Marks: Export Clear View Count

1733-270

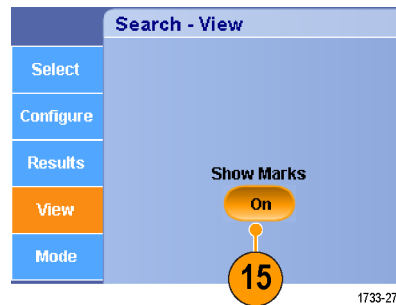
12. 표시 또는 모든 표시를 사용자 표시로 변환하려면 검색 표시 (Search Marks) **저장(Save)** 또는 **모두 저장(Save All)**을 누릅니다.
13. 현재 강조 표시된 행을 표시 테이블에서 제거하려면 검색 표시 (Search Marks) **지우기(Clear)**를 누릅니다.
14. 표시 위치를 엔지니어링 표기 또는 고정밀도 양식 간에 전환하려면 **자릿수(Digits)**를 누릅니다.
15. 표시 삼각형을 켜기(On)와 끄기(Off) 간에 전환하려면 **보기(View)** 탭을 선택하고 **표시 보기(Show Marks)**를 누릅니다.

Results: Mark Table

Index	Type	Src	Location	Time Delta					Description
				sec	ms	us	ns	ps	
1	Edge	C1	-283.12us						+Edge: level=853.63mV
2	Usar	C1	-229.36us	000	000	256	000	000	+Edge: level=853.63mV
3	Edge	C1	144.48us	000	000	031	600	000	+Edge: level=853.63mV
4	Edge	C1	-102.88us	000	000	084	880	000	+Edge: level=853.63mV
5	Edge	C1	69.04us	000	000	171	920	000	+Edge: level=853.63mV
6	Edge	C1	148us	000	000	078	959	999	+Edge: level=853.63mV
Total Marks: 7									
				ΔZ1,Z2					
				ΔZ2,Z3					
				ΔZ1,Z3					

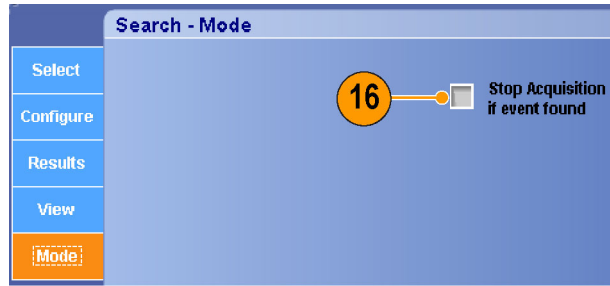
Search Marks: Save Save All Clear Digits >> << Digits All Marks: Export Clear View Count

1733-271



1733-273

16. 일치하는 항목이 발견될 경우 획득을 중지하려면 **모드(Mode)** 탭을 선택하고 **이벤트가 발견 시 획득 중지(Stop Acquisition if event found)**를 선택합니다.



1733-272

빠른 팁:

- 검색은 획득한 데이터에 대해서만 수행됩니다. 검색 중인 데이터를 획득하도록 장비를 설정하십시오.
- 검색 이벤트를 인식할 수 있도록 샘플 속도를 설정하십시오. 몇 개의 샘플 간격보다 넓은 글리치를 검색할 수 있습니다.
- 트리거 설정을 복사하여 트리거 조건을 만족하는 획득한 파형의 다른 위치를 검색할 수 있습니다. 검색 설정을 트리거로 복사할 수 있습니다.
- 에지 검색 표시는 줌 계수 없이 만들어집니다. 다른 검색 유형은 해당 줌 계수가 있는 표시를 만듭니다.
- 줌을 표시로 가져오기(Bring Zoom to Mark) **줌 2(Zoom 2)** 또는 **줌 3(Zoom 3)**을 누르면 줌 1과 동일한 줌 매개 변수를 가지는 해당 줌 보기가 표시됩니다.
- 사용자 정의 표시는 파형을 저장하고 설정을 저장할 때 파형과 함께 저장됩니다.
- 자동 검색 표시는 파형을 저장할 때 파형과 함께 저장되지 않습니다. 그러나 검색 기능을 다시 사용하여 쉽게 다시 포착할 수 있습니다.
- 검색 기준은 저장된 설정에 저장됩니다.

검색에는 다음 검색 기능이 포함됩니다.

검색	설명
에지	사용자가 지정한 임계 레벨을 사용하여 에지(상승 또는 하강)를 검색합니다.
글리치	지정된 폭보다 좁거나 넓은 펄스를 검색하거나 지정된 폭보다 좁거나 넓은 글리치를 무시합니다.
펄스	사용자 지정 펄스 폭보다 크거나 작거나 같거나 같지 않은 포지티브 또는 네거티브 펄스 폭을 검색합니다.
셋업/홀드	사용자 지정 셋업 앤 홀드 타임의 위반을 검색합니다.
런트	하나의 진폭 임계를 통과하지만 다시 첫 번째를 통과하기 전에 두 번째 임계를 통과하는 데 실패한 포지티브 또는 네거티브 펄스를 검색합니다. 모든 런트 펄스 또는 해당 기간이 사용자 지정 시간보다 크거나 작거나 같거나 같지 않은 런트 펄스만 검색합니다.

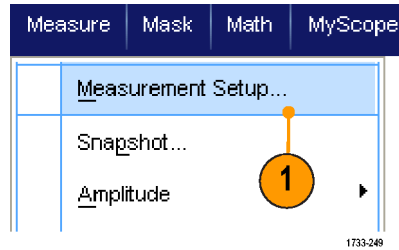
검색	설명
창	임계 창으로 들어오거나 나가는 신호를 검색합니다. 더 넓은 경우(When Wider) 옵션을 사용하여 시간을 기준으로 검색을 검정하거나, 논리적인 경우(When Logic) 옵션을 사용하여 다른 채널의 논리 상태를 기준으로 검정합니다.
패턴	각 입력이 높음(High), 낮음(Low) 또는 무정의(Don't Care)로 설정된 여러 파형에서 논리 패턴(AND, OR, NAND 또는 NOR)을 검색합니다. 사용자 지정 시간보다 크거나 작거나 같거나 같지 않은 경우에 대해 이벤트가 True가 되거나 False가 되거나 유효하게 유지되는 시점을 검색합니다. 또한 입력 중 하나를 동기 상태 검색을 위한 클럭으로 정의해야 합니다.
변이	사용자 지정 시간보다 크거나 작거나 같거나 같지 않은 상승 및/또는 하강 에지를 검색합니다.
타임아웃	지정된 시간 내에 펄스 없는지 검색합니다.
상태	선택한 로직 함수에 대한 모든 로직 입력으로 인해 클럭 입력 상태가 변경될 때 함수가 True 또는 False가 되는 경우를 검색합니다.

파형 분석

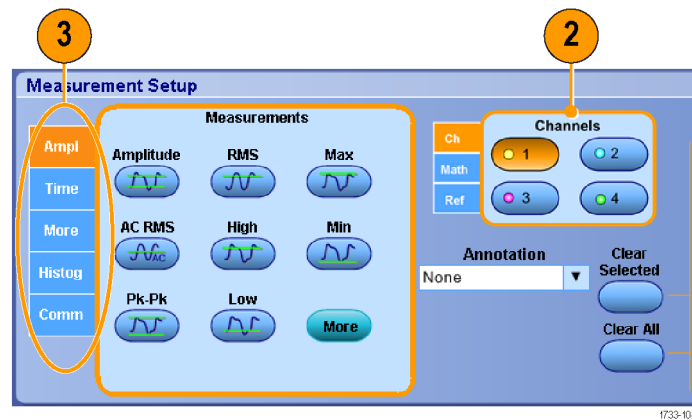
이 장비는 사용자의 파형 분석을 돕기 위한 커서, 자동 측정, 통계, 히스토그램, math, 스펙트럼 분석 및 고급 통과/실패 테스트를 제공합니다. 이 절에는 파형을 분석하기 위한 개념 및 절차가 설명되어 있습니다. 자세한 내용은 온라인 도움말에서 확인할 수 있습니다.

자동 측정 수행

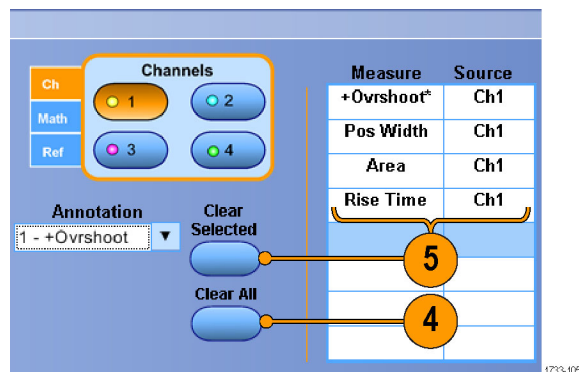
1. 측정 (Measure) > 측정 설정...(Measurement Setup...)을 선택합니다.



2. 측정할 채널, math 또는 기준 파형을 선택합니다.
3. 탭을 사용하여 5가지 범주 중에서 원하는 측정을 선택합니다.



4. 모든 측정을 제거하려면 모두 삭제 (Clear All)를 클릭합니다.
5. 여러 측정을 제거하려면 클릭하고 끌어 측정을 선택한 다음 선택한 항목 삭제 (Clear Selected)를 클릭합니다.



측정 메뉴에서 선택한 파형에 대해 측정을 직접 선택할 수도 있습니다. (84페이지의 자동 측정 선택 참조)



1733-106

빠른 팁

- 룰 모드에서는 획득을 정지해야 측정을 사용할 수 있습니다.

자동 측정 선택

다음 표에는 범주별로 각 자동 측정이 나와 있습니다. 범주에는 진폭, 시간, 기타, 히스토그램 및 통신이 있습니다. (82페이지의 *자동 측정 수행* 참조)

진폭 측정

측정	설명
진폭	전체 파형 또는 게이트된 영역에 대해 측정된 높은 값과 낮은 값의 차이입니다.
높음	이 값은 하강 시간이나 상승 시간 측정에서와 같이 높은 기준값, 중간 기준값 또는 낮은 기준값이 필요할 때마다 100%로 사용됩니다. 최소/최대 또는 히스토그램 방법을 사용하여 계산할 수 있습니다. 최소/최대 방법에서는 발견된 최대값을 사용합니다. 히스토그램 방법에서는 중간 지점 위에서 발견된 가장 일반적인 값을 사용합니다. 이 값은 전체 파형 또는 게이트된 영역에 대해 측정됩니다.
낮음	이 값은 하강 시간이나 상승 시간 측정에서와 같이 높은 기준값, 중간 기준값 또는 낮은 기준값이 필요할 때마다 0%로 사용됩니다. 최소/최대 또는 히스토그램 방법을 사용하여 계산할 수 있습니다. 최소/최대 방법에서는 발견된 최소값을 사용합니다. 히스토그램 방법에서는 중간 지점 아래에서 발견된 가장 일반적인 값을 사용합니다. 이 값은 전체 파형 또는 게이트된 영역에 대해 측정됩니다.
RMS	전체 파형 또는 게이트된 영역에 대한 참 자승 평균 평방근(RMS) 전압입니다.
AC RMS	측정 구역에 대한 참 자승 평균 평방근 전압입니다.
최대	일반적으로 가장 포지티브한 피크 전압입니다. 최대는 전체 파형 또는 게이트된 영역에 대해 측정됩니다.
최소	일반적으로 가장 네거티브한 피크 전압입니다. 최소는 전체 파형 또는 게이트된 영역에 대해 측정됩니다.
피크-피크	전체 파형 또는 게이트된 영역에서 최대 진폭 및 최소 진폭 사이의 절대차입니다.
사이클 RMS	파형의 첫 번째 사이클 또는 게이트된 영역의 첫 번째 사이클에 대한 실제 제곱 평균(RMS) 전압입니다.
포지티브 오버슈트	전체 파형이나 게이트된 영역에 대해 측정되며 다음과 같이 표현됩니다. 포지티브 오버슈트 = ((최대값 - 높은 값) / 진폭) x 100%
네거티브 오버슈트	전체 파형이나 게이트된 영역에 대해 측정되며 다음과 같이 표현됩니다. 네거티브 오버슈트 = ((낮은 값 - 최소값) / 진폭) x 100%
평균	전체 파형 또는 게이트된 영역에 대한 산술 평균입니다.
사이클 평균	파형의 첫 번째 사이클 또는 게이트된 영역의 첫 번째 사이클에 대한 산술 평균입니다.

시간 측정

측정	설명
상승 시간	파형 또는 게이트된 영역의 파형에서 첫 번째 펄스의 선행 에지가 최종값의 낮은 기준값(기본값=10%)에서 높은 기준값(기본값=90%)으로 상승하는 데 걸리는 시간입니다.
하강 시간	파형 또는 게이트된 영역의 파형에서 첫 번째 펄스의 하강 에지가 최종값의 높은 기준값(기본값=90%)에서 낮은 기준값(기본값=10%)으로 하강하는 데 걸리는 시간입니다.
상승 펄스	포지티브 펄스의 중간 기준(기본값 50%) 진폭 포인트 사이의 거리(시간)입니다. 파형 또는 게이트된 영역의 첫 번째 펄스에서 측정됩니다.

시간 측정 (계속)

측정	설명
하강 펄스	네거티브 펄스의 중간 기준(기본값 50%) 진폭 포인트 사이의 거리(시간)입니다. 파형 또는 게이트된 영역의 첫 번째 펄스에서 측정됩니다.
포지티브 듀티 사이클	백분율로 표현된 신호 주기에 대한 포지티브 펄스 폭의 비율입니다. 듀티 사이클은 파형 또는 게이트된 영역의 첫 번째 사이클에서 측정됩니다.
네거티브 듀티 사이클	백분율로 표현된 신호 주기에 대한 네거티브 펄스 폭의 비율입니다. 듀티 사이클은 파형 또는 게이트된 영역의 첫 번째 사이클에서 측정됩니다.
주기	파형이나 게이트된 영역의 첫 번째 사이클을 완료하는 데 걸리는 시간입니다. 주기는 주파수의 역수로, 초 단위로 측정됩니다.
주파수	파형 또는 게이트된 영역의 첫 번째 사이클 주파수입니다. 주파수는 주기의 역수로, 헤르츠(Hz) 단위로 측정되며 1Hz는 초당 한 개의 사이클을 나타냅니다.
지연	서로 다른 두 파형의 중간 기준(기본값 50%) 진폭 포인트 사이의 시간입니다.

기타 측정

측정	설명
구역	전체 파형 또는 게이트된 영역에 대한 구역(볼트-초 단위)입니다. 접지 위에서 측정된 구역은 포지티브이고 접지 아래에서 측정된 구역은 네거티브입니다.
사이클 구역	파형의 첫 번째 사이클 또는 게이트된 영역의 첫 번째 사이클에 대한 구역으로, 볼트-초 단위로 표시됩니다. 일반 기준 포인트 위에 있는 구역은 포지티브인 반면 일반 기준 포인트 아래에 있는 영역은 네거티브입니다.
위상	하나의 파형이 다른 파형보다 빠르거나 느린 시간으로, 도 단위로 표현됩니다. 360°가 하나의 파형 사이클을 구성합니다.
버스트 폭	버스트(일련의 일시적 이벤트)의 기간으로, 전체 파형 또는 게이트된 영역에 대해 측정됩니다.

히스토그램 측정

측정	설명
파형 수	히스토그램에 포함된 파형 수를 표시합니다.
상자에서 히트	히스토그램 상자 안 또는 위에 있는 포인트 수를 표시합니다.
피크 히트	가장 큰 히스토그램 빈에 있는 포인트 수를 표시합니다.
중간	히스토그램 상자의 중간 지점을 표시합니다. 히스토그램 안 또는 위에서 획득된 모든 포인트 중 절반은 이 값보다 작으며 절반은 이 값보다 큼니다.
최대	수직 히스토그램의 가장 큰 0이 아닌 값을 가진 빈의 전압 또는 수평 히스토그램의 0이 아닌 값을 가진 가장 오른쪽 빈의 시간을 표시합니다.
최소	수직 히스토그램의 가장 작은 0이 아닌 값을 가진 빈의 전압 또는 수평 히스토그램의 0이 아닌 값을 가진 가장 왼쪽 빈의 시간을 표시합니다.
피크-피크	히스토그램의 피크-피크 값을 표시합니다. 수직 히스토그램은 가장 큰 0이 아닌 값을 가진 빈의 전압에서 가장 낮은 0이 아닌 값을 가진 빈의 전압을 뺀 값을 표시합니다. 수평 히스토그램은 0이 아닌 값을 가진 가장 오른쪽 빈의 시간에서 0이 아닌 값을 가진 가장 왼쪽 빈의 시간을 뺀 값을 표시합니다.
평균	히스토그램 상자 안 또는 위에서 획득한 모든 포인트의 평균을 측정합니다.

히스토그램 측정 (계속)

측정	설명
표준 편차	히스토그램 안 또는 위에서 획득한 모든 포인트의 표준 편차, 즉 RMS(자승 평균 평방근) 편차를 측정합니다.
평균 ± 1 표준 편차	히스토그램 평균의 한 표준 편차 내에 있는 히스토그램의 포인트 백분율을 표시합니다.
평균 ± 2 표준 편차	히스토그램 평균의 두 표준 편차 내에 있는 히스토그램의 포인트 백분율을 표시합니다.
평균 ± 3 표준 편차	히스토그램 평균의 세 표준 편차 내에 있는 히스토그램의 포인트 백분율을 표시합니다.

통신 측정

측정	설명
소광비	아이 하단 대 아이 상단 비율입니다. 이 측정은 파형 데이터베이스 또는 파형 데이터베이스 모드에서 저장한 기준 파형에 대해서만 사용할 수 있습니다.
소광비 %	백분율로 표현된 아이 상단 대 아이 하단 비율입니다. 이 측정은 파형 데이터베이스 또는 파형 데이터베이스 모드에서 저장한 기준 파형에 대해서만 사용할 수 있습니다.
소광비(dB)	데시벨 단위로 표현된 아이 하단 대 아이 상단 비율입니다. 이 측정은 파형 데이터베이스 또는 파형 데이터베이스 모드에서 저장한 기준 파형에 대해서만 사용할 수 있습니다.
아이 높이	볼트 단위의 아이 높이 측정입니다.
아이 너비	초 단위의 아이 폭 측정입니다.
아이 상단	소광비 측정에 사용되는 상단 값입니다.
아이 하단	소광비 측정에 사용되는 하단 값입니다.
교차 %	아이 높이의 백분율로 표현된 아이 교차 포인트입니다.
지터 P-P	현재 수평 단위의 에지 지터 피크-피크 값입니다.
지터 RMS	현재 수평 단위의 에지 지터 RMS 값입니다.
지터 6 Sigma	현재 수평 단위의 에지 지터 RMS 값에 6을 곱한 값입니다.
노이즈 P-P	사용자가 지정한 신호의 상단 또는 하단 노이즈에 대한 피크-피크 값입니다.
노이즈 RMS	사용자가 지정한 신호의 상단 또는 하단 노이즈에 대한 RMS 값입니다.
S/N 비율	사용자가 지정한 신호의 상단 또는 하단 노이즈에 대한 신호 진폭 비율입니다.
사이클 왜곡	중간 기준값에서 아이 구간의 백분율로 측정된 첫 번째 아이 교차의 피크-피크 시간 편차입니다.
Q-계수	노이즈 대 아이 크기 비율입니다.

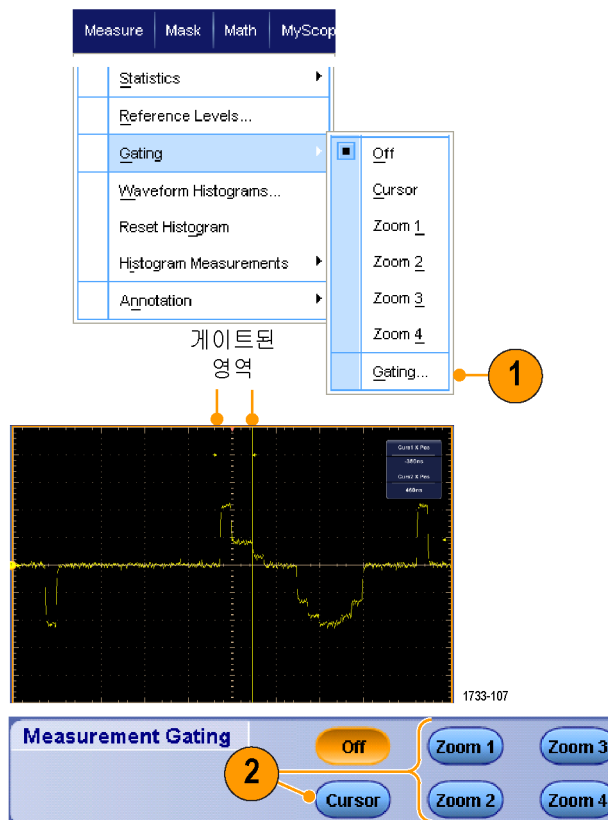
자동 측정 사용자 정의

게이팅, 측정 통계 수정 또는 측정 기준 레벨 조정 등을 통해 자동 측정을 사용자 정의할 수 있습니다.

게이팅

게이팅을 사용해서 측정을 파형의 일정 부분에만 한정합니다.

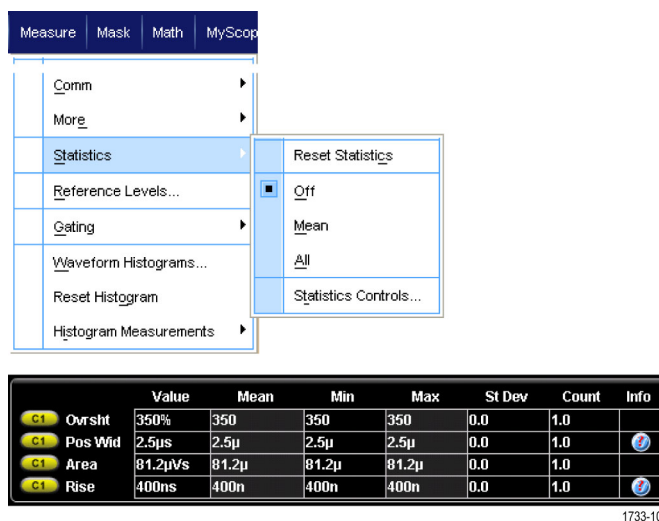
1. 측정(Measure) > 게이팅(Gating) > 게이팅...(Gating ...)을 선택합니다.
2. 다음 중 하나를 수행하여 게이트의 위치를 지정합니다.
 - 커서(Cursor)를 클릭하여 게이트된 영역을 커서 사이의 영역으로 설정합니다.
 - 줌 1-4 (Zoom (1-4))를 클릭하여 게이트된 영역을 줌(1-4) 계수선으로 설정합니다.



통계

통계는 측정과 함께 자동으로 켜집니다. 통계는 측정의 안정성을 특성화합니다.

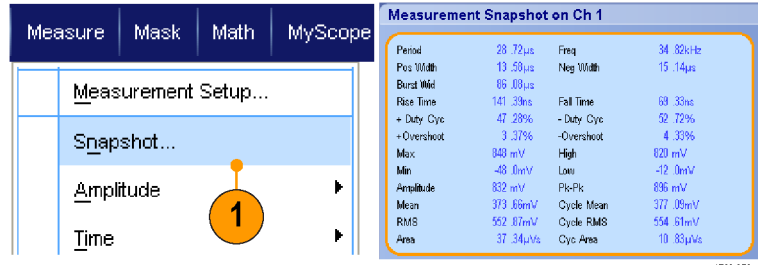
1. 표시되는 통계를 변경하려면 측정(Measure) > 통계(Statistics)를 선택한 다음 평균(Mean) 또는 모두(All)를 선택합니다. 모두에는 최소, 최대, 평균, 표준 편차 및 채우기가 포함됩니다.
2. 통계를 제거하려면 Off를 선택합니다.



스냅 샷

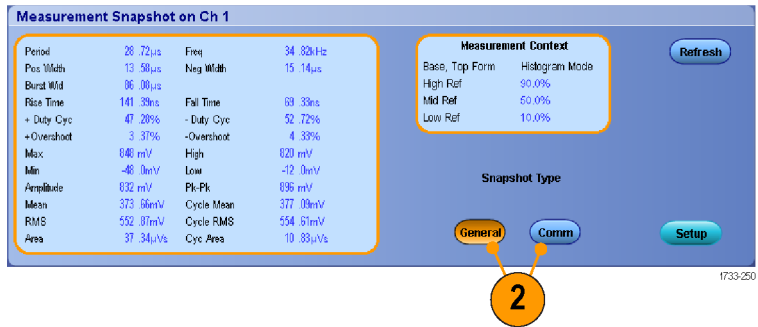
유효한 모든 측정의 1회 보기를 표시하려면 **측정 (Measure) > 스냅 샷 (Snapshot)**을 선택합니다.

주석노트. 측정에 대한 설정이 잘못된 경우 해당 측정의 결과는 세 개의 물음표로 표시됩니다.



1733-253

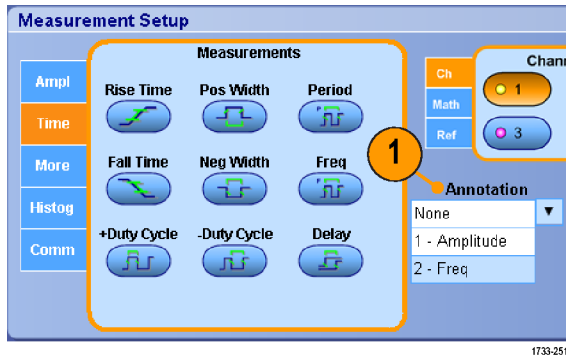
일반 측정의 스냅 샷 찍기 또는 통신 측정의 스냅 샷 찍기 사이에서 선택하려면 일반(General) 또는 통신(Comm)을 선택합니다.



1733-250

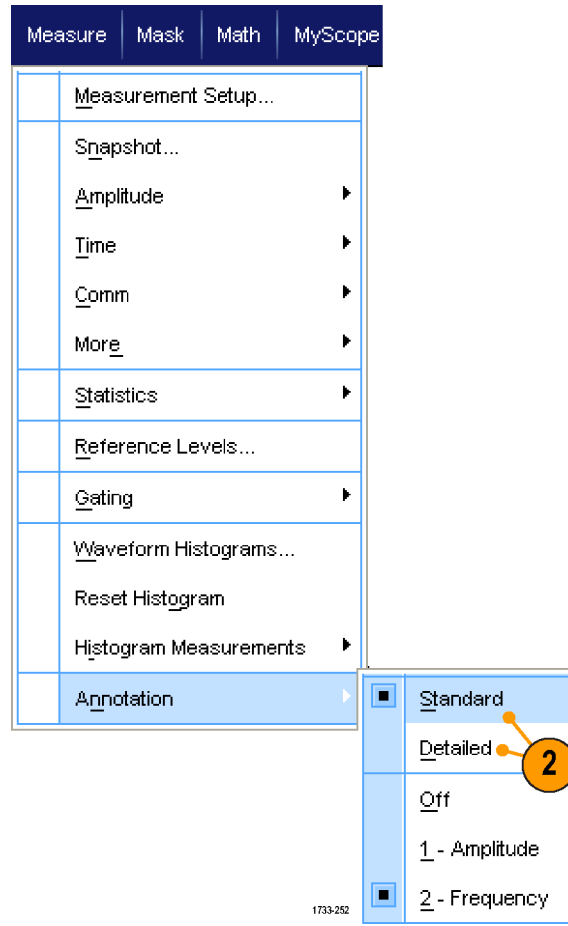
측정 주석 달기

1. 측정에 주석을 달려면 측정 설정 (Measurements Setup) 제어창에서 주석(Annotation)을 선택합니다. 드롭다운 목록에서 주석을 달 측정을 선택합니다.



1733-251

2. 측정 주석 세부 사항의 양을 선택하려면 **측정 (Measure) > 주석 (Annotation) > 표준 (Standard)** 또는 **자세히 (Detailed)**를 선택합니다.



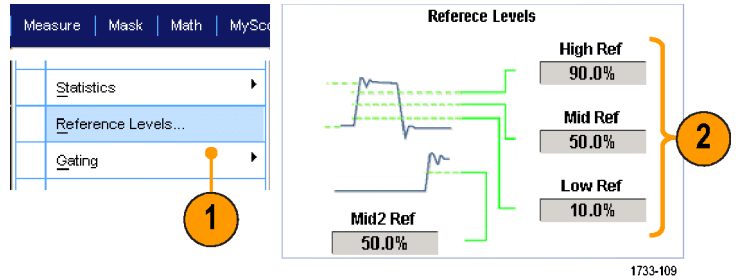
기준 레벨

기준 레벨은 시간 관련 측정을 수행하는 방법을 결정합니다.

1. 측정 (Measure) > 기준 레벨...(Reference Levels...)을 선택합니다.

2. 서로 다른 상대 또는 절대 값에 따라 측정 기준 레벨을 조정합니다.

- 고 기준 및 저 기준은 상승 및 하강 시간을 계산하는 데 사용됩니다. 기본 고 기준은 90%이고 기본 저 기준은 10%입니다.
- 펄스 폭 같은 에지 사이의 측정을 위해서는 중간 기준을 사용합니다. 기본 레벨은 50%입니다.
- 중간2 기준은 지연 또는 위상 측정에서 지정된 두 번째 파형에 사용됩니다. 기본 레벨은 50%입니다.



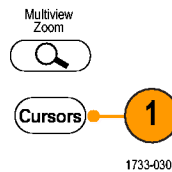
빠른 팁

- 정확한 노이즈 값을 얻으려면 아이 신호를 측정할 때 신호 유형을 아이로 설정해야 합니다.

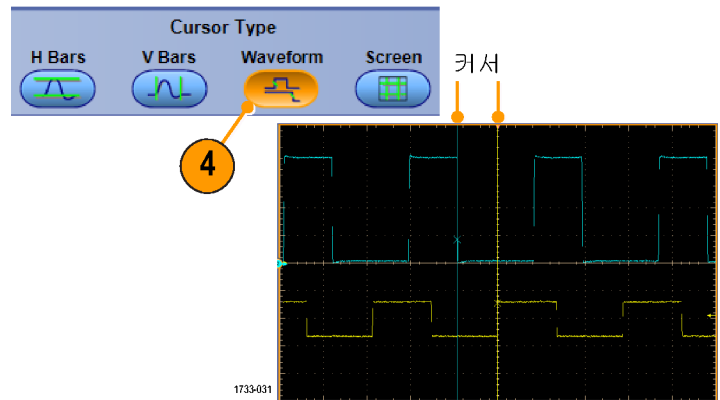
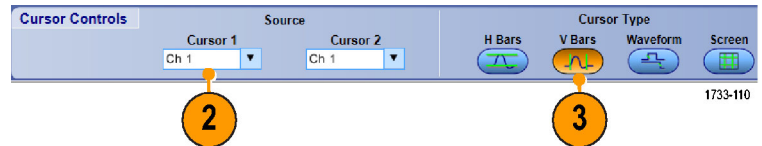
커서 측정

커서를 사용하여 획득한 데이터를 측정할 수 있습니다.

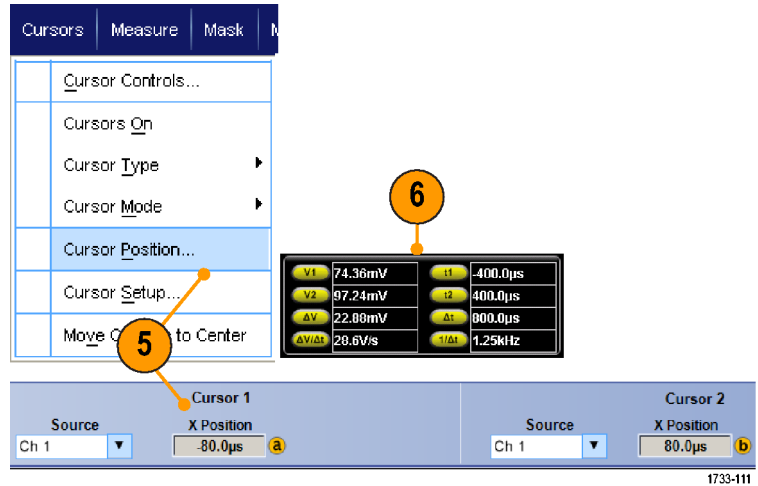
1. 커서(Cursors)를 누릅니다.



2. 커서 소스를 선택합니다.
3. 다음 중에서 커서 유형을 선택합니다.
 - 수평 막대는 진폭(보통 볼트 또는 암페어 단위)을 측정합니다.
 - 수직 막대는 수평 매개 변수(보통 시간)를 측정합니다.
 - 파형 및 화면 커서는 수직 및 수평 매개 변수를 동시에 측정합니다. 파형 커서는 파형에 연결되며, 화면 커서는 파형에 연결되지 않은 상태로 플로팅됩니다.
4. 두 파형 사이에서 측정을 수행하려면 **파형(Waveform)**을 선택한 다음 각 커서의 파형 소스를 선택합니다.



5. 커서 (Cursors) > 커서 위치...(Cursor Position...)를 선택한 다음 범용 노브를 사용하여 커서 위치를 조정합니다.
6. 화면에서 커서의 측정값을 읽습니다.



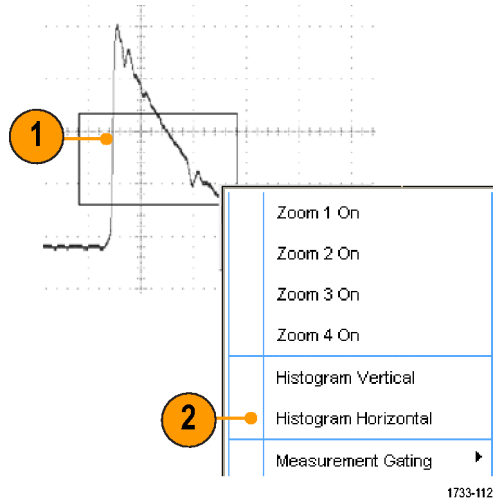
빠른 팁

- 커서 추적 모드를 사용하면 커서가 한꺼번에 이동하도록 설정할 수 있습니다. 커서 독립 모드를 사용하면 커서가 독자적으로 움직입니다.
- 확대 계수선을 사용하면, 커서를 직접 특정한 파형의 포인트에 갖다 댄으로써 정밀 측정이 가능합니다.
- 커서를 클릭하여 새 위치로 끄는 방법으로 이동할 수도 있습니다.
- 또한 **커서를 중앙으로 이동(Move Cursors to Center)**을 눌러 디스플레이의 중앙으로 커서를 이동할 수 있습니다.
- 실선 또는 점선 커서를 선택할 수 있습니다.
- 수직 커서는 트리거 포인트에서 수직 커서까지의 시간을 측정합니다.

히스토그램 설정

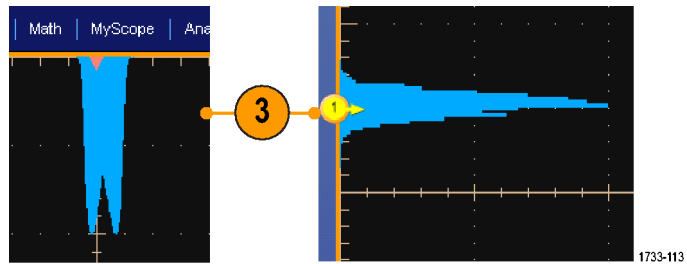
수직(전압) 또는 수평(시간) 히스토그램을 표시할 수 있습니다. 히스토그램 측정을 사용하면 한 축을 따라 파형 구역의 통계적 측정 데이터를 얻을 수 있습니다.

1. 히스토그램으로 나타내고자 하는 파형의 세그먼트를 클릭한 다음 포인터를 끕니다. 예를 들어, 수평 히스토그램 상자의 경우에는 높이보다 폭이 더 크도록 만듭니다.
2. 바로 가기 메뉴에서 수직 히스토그램(Histogram Vertical) 또는 수평 히스토그램(Histogram Horizontal)을 선택합니다.



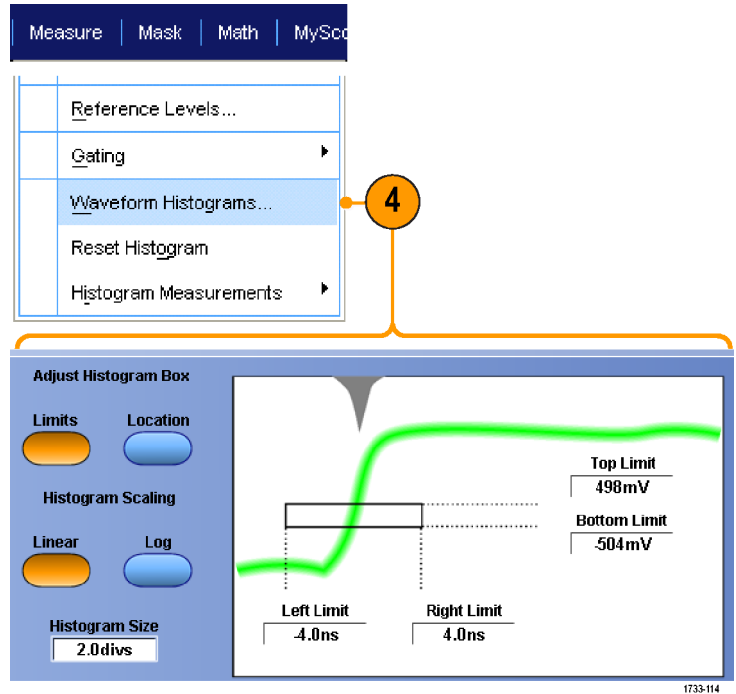
1733-112

3. 히스토그램을 상단(수평 히스토그램의 경우) 또는 계수선의 왼쪽 에지(수직 히스토그램의 경우)에서 봅니다.



1733-113

4. 히스토그램 스케일 또는 히스토그램 상자의 크기나 위치를 조정하려면 **측정 (Measure) > 파형 히스토그램 (Waveform Histograms)** 을 선택한 다음 히스토그램 설정 (Histogram Setup) 제어창을 사용하여 조정합니다.
5. 히스토그램 데이터를 자동으로 측정할 수도 있습니다. (82페이지의 **자동 측정 수행 참조**)



빠른 팁

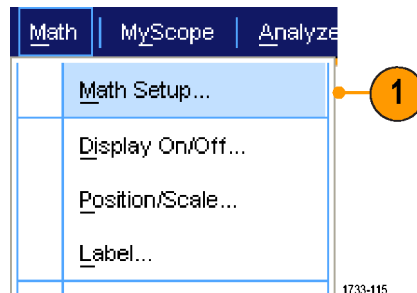
- 신호 노이즈를 측정하려면 수직 히스토그램을, 신호 지터를 측정하려면 수평 히스토그램을 사용합니다.
- 클릭하여 끌기 방법을 사용하여 히스토그램 디스플레이를 끌 수 있는 바로 가기 메뉴를 활성화합니다.

Math 파형 사용

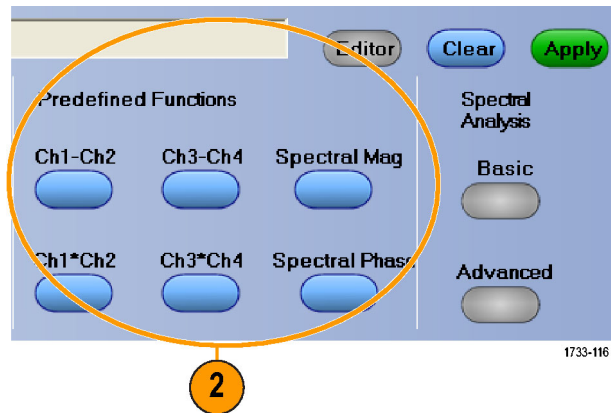
채널 및 기준 파형의 분석을 지원하려면 math 파형을 만드십시오. 소스 파형 및 기타 데이터를 결합하고 math 파형으로 변환하면 애플리케이션에서 요구하는 데이터 보기를 파생시킬 수 있습니다.

사전 정의된 연산 방정식의 경우 다음 절차를 사용합니다.

1. **연산(Math) > 연산 설정...(Math Setup...)**을 선택합니다.

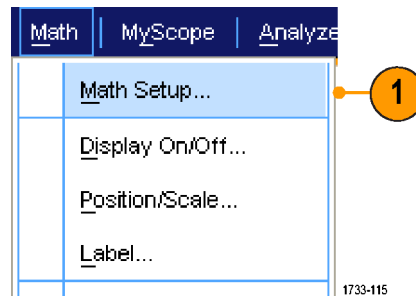


2. 사전 정의된 연산 등식 중 하나를 선택합니다.

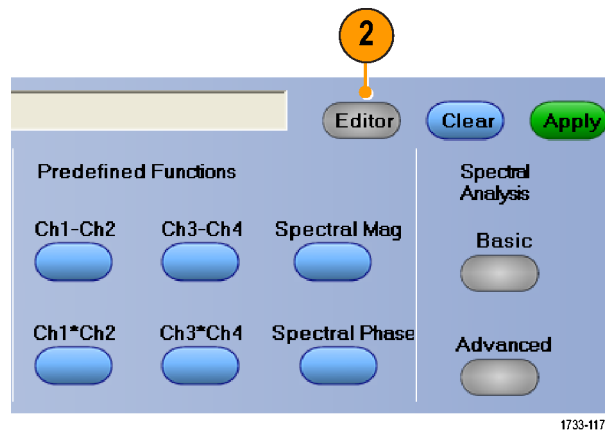


고급 math 파형 수식을 만들려면 다음 절차를 사용합니다.

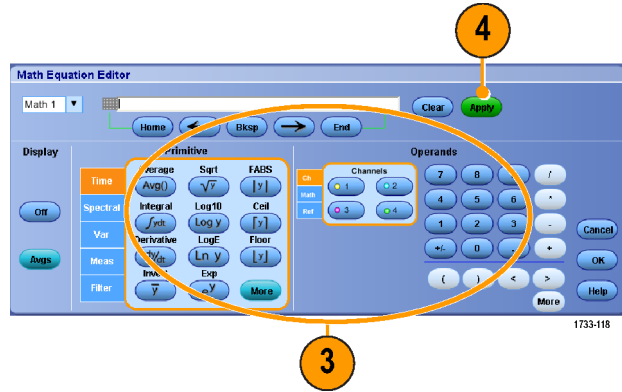
1. 연산(Math) > 연산 설정...(Math Setup...)을 선택합니다.



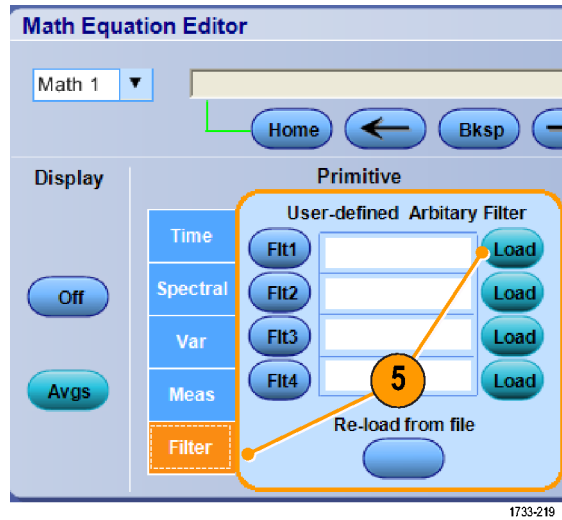
2. 편집기(Editor)를 클릭합니다.



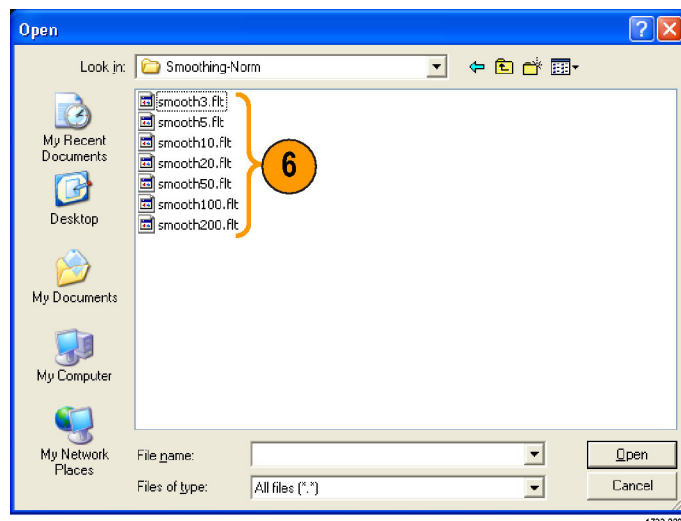
3. 소스, 연산자, 상수, 측정, 변수, 함수 등을 사용해서 고급 math 파형 수식을 만듭니다.
4. 원하는 대로 수식을 정의했으면 **적용(Apply)**을 클릭합니다.



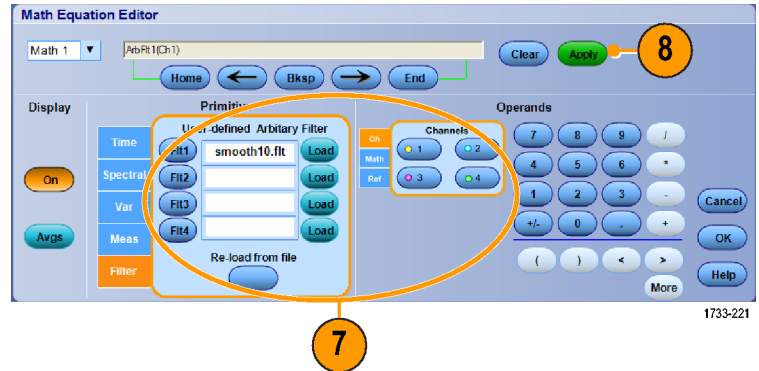
5. 사용자가 선택한 필터를 추가하려면 **필터(Filter)** 탭을 클릭합니다. **로드(Load)**를 클릭합니다.



6. 사용할 필터가 들어 있는 폴더를 두 번 클릭합니다. 사용할 필터를 두 번 클릭합니다.



7. 선택한 필터를 사용하여 연산 수식을 만듭니다.
8. 원하는 대로 수식을 정의했으면 적용(Apply)을 클릭합니다.



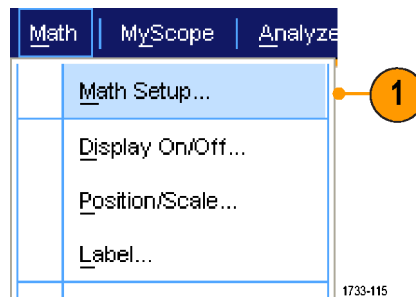
빠른 팁

- 소스가 유효하지 않으면 연산 정의는 구현되지 않습니다.
- math 파형은 채널 파형, 기준 파형, math 소스 파형 및 측정값으로 작성할 수 있습니다.
- math 파형 측정은 채널 파형과 똑같은 방법으로 수행할 수 있습니다.
- math 파형은 연산 수식의 소스에서 해당 수평 스케일 및 위치를 파생시킵니다. 소스 파형에 대한 이 컨트롤을 조정하면 math 파형도 조정됩니다.
- MultiView Zoom을 사용하여 math 파형을 확대할 수 있으며 마우스를 사용하여 확대된 영역의 위치를 지정할 수 있습니다.
- 임의 연산 필터에 대한 자세한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오.

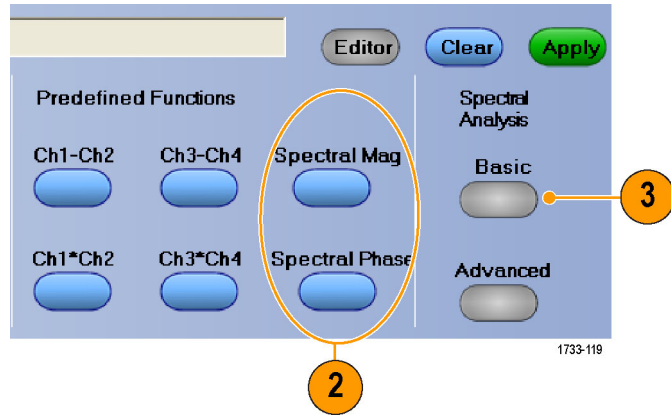
스펙트럼 분석 사용

사전 정의된 스펙트럼 연산 수식의 경우 다음 절차를 사용합니다. 자세한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오.

1. 연산(Math) > 연산 설정...(Math Setup...)을 선택합니다.

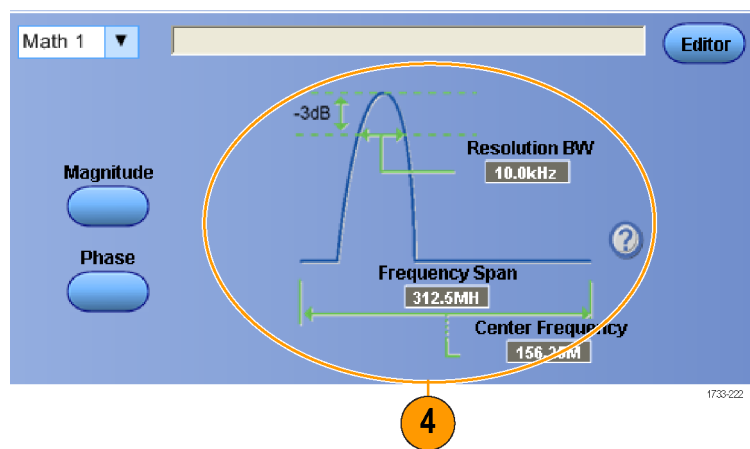


- 사전 정의된 스펙트럼 연산 수식 중 하나를 선택합니다.
- 기본(Basic)을 클릭합니다.



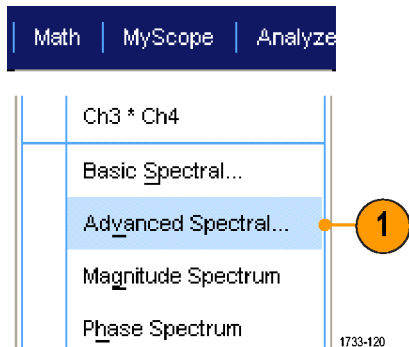
- 해상도 대역폭(Resolution BW) 또는 주파수 범위(Frequency Span)를 클릭하고 키패드나 범용 노브를 사용하여 스펙트럼 디스플레이를 조정합니다.

주석노트. 해상도 대역폭(Resolution BW) 또는 주파수 범위(Frequency Span)는 수동 수평 모드에서만 조정할 수 있습니다.

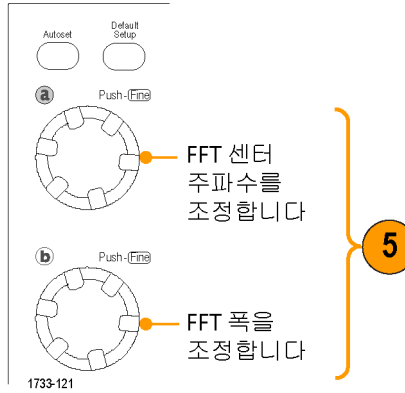
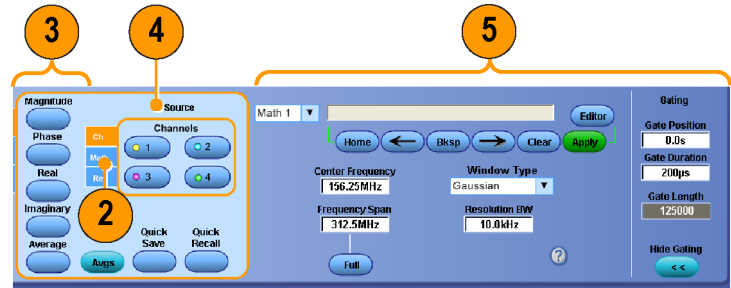


고급 스펙트럼 연산 수식을 만들려면 다음 절차를 사용합니다.

- 연산(Math) > 고급 스펙트럼...(Advanced Spectral...)을 선택합니다.

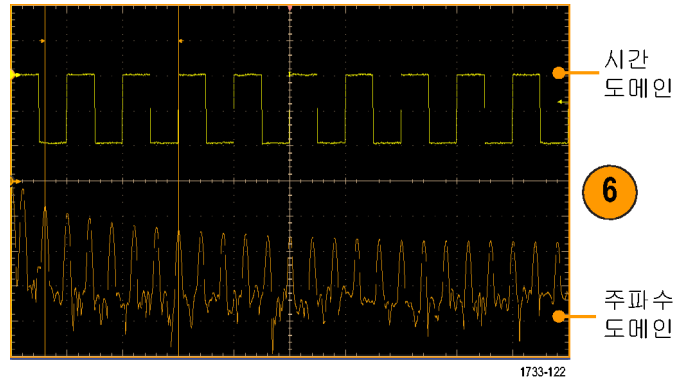


2. 정의할 math 파형을 선택합니다.
3. 작성할 스펙트럼 파형 유형을 클릭합니다. 파형을 다시 정의하려면 삭제(Clear)를 클릭합니다.
4. 소스 파형을 선택합니다.
5. 스펙트럼 설정(Spectral Setup) 제어창의 컨트롤 및 범용 노브를 사용하여 스펙트럼 파형을 조정합니다.



6. 시간 도메인과 주파수 도메인의 파형을 동시에 볼 수 있습니다.

게이팅을 사용하여 스펙트럼 분석의 시간 도메인 파형에서 일부분을 볼 수도 있습니다. (87페이지의 *게이팅* 참조)



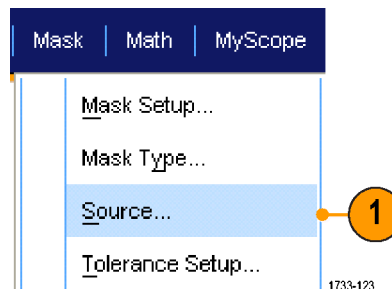
빠른 팁

- 스펙트럼 math 파형의 소스는 채널 파형 또는 기타 math 파형이어야 합니다.
- 장비 응답 시간을 단축하려면 짧은 레코드 길이를 사용합니다.
- 신호에 상대적인 노이즈를 줄이고 주파수 해상도를 높이려면 긴 레코드 길이를 사용합니다.
- 각 창 기능마다 스펙트럼에서 생성되는 필터 응답 모양이 다르므로 해상도 대역폭도 달라집니다. 자세한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오.
- RBW(해상도 대역폭)은 게이트 폭을 직접 제어합니다. 그러므로 콘트롤을 조정하면 시간 도메인 게이트 마커가 이동합니다.
- 스펙트럼에서 실제 데이터 또는 가상 데이터의 선형 크기를 표시할 수 있습니다. 이는 스펙트럼을 오프라인에서 처리한 다음 시간 도메인 추적으로 다시 변환하는 경우에 유용합니다.

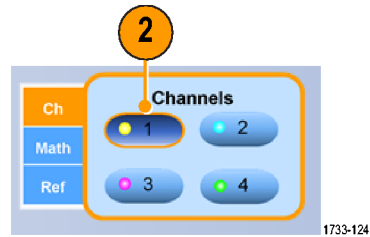
마스크 테스트 사용

직렬 통신 마스크 테스트(옵션 MTM 또는 MTH)를 사용하면 신호를 사전 정의된 템플릿 또는 마스크와 비교할 수 있습니다. 테스트를 통과하려면 신호는 마스크가 정의하는 세그먼트 외부에 있어야 합니다. 일반적으로 ANSI 등의 표준 기관에서 마스크를 정의합니다. 마스크 테스트를 수행하려면 다음을 수행하십시오.

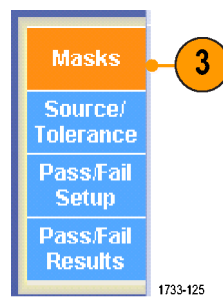
1. 마스크 (Masks) > 소스...(Source...)를 선택합니다.



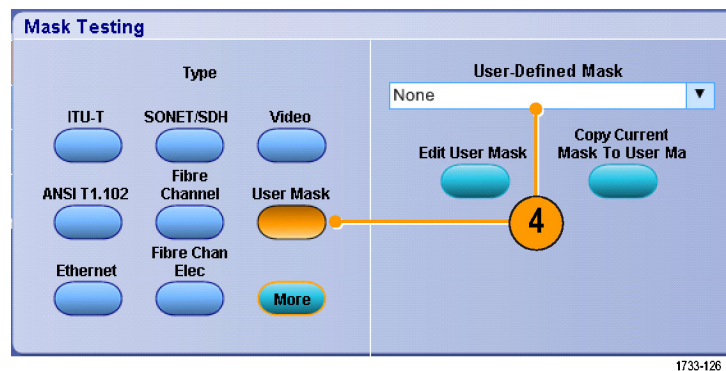
2. 신호 소스를 선택합니다.



3. 마스크(Masks) 탭을 클릭합니다.

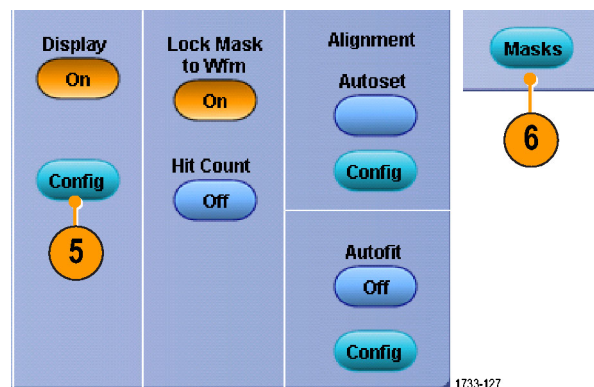


4. 유형 및 표준을 선택합니다.

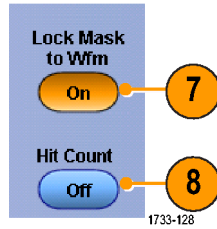


5. 마스크와 위반이 표시되는 방법 및 마스크 자동 설정 (Mask Autoset) 및 자동 맞춤(Autofit)이 구성되는 방법을 조정할 수 있는 마스크 구성(Mask Configuration) 제어창에 액세스하려면 구성(Config)을 클릭합니다.

6. 마스크 구성(Mask Setup) 제어창으로 돌아가려면 마스크(Masks)를 클릭합니다.

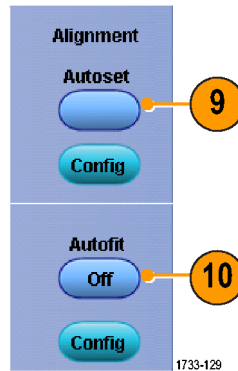


7. 수평 또는 수직 설정값에서 마스크 변경 사항을 추적하려면 마스크를 파형에 잠금(Lock Mask to Wfm) **On**을 클릭합니다.



8. 마스크 테스트 중의 위반을 강조하려면 적중수(Hit Count) **On**을 전환합니다.

9. 입력 신호의 특성을 기준으로 파형을 마스크에 자동 정렬하려면 **자동 설정 (Autoset)**을 클릭합니다.

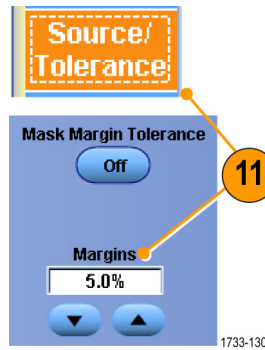


10. 각 획득 후에 파형 위치를 자동으로 변경하여 적중을 최소화하려면 자동 맞춤(Autofit) **On**을 전환합니다.

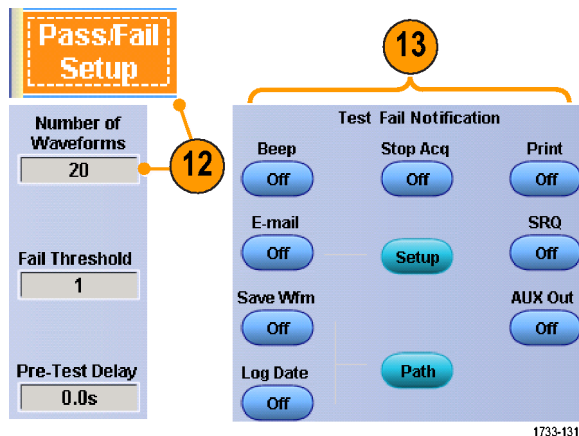
11. **공차(Tolerance)** 탭을 클릭한 다음 공차를 설정합니다.

공차를 0%보다 크게 설정하면 마스크 테스트를 통과하기가 어려워지며, 0%보다 작게 설정하면 테스트를 통과하기가 쉽습니다.

마스크를 표준에 지정된 대로 사용하려면 공차 값으로 0%를 사용하십시오. 이 백분율을 변경하면 한도 테스트를 수행할 수 있습니다.



12. **통과/실패 설정(Pass/Fail Setup)** 탭을 선택한 다음 통과/실패 매개변수를 설정합니다. 획득 모드가 파형 데이터베이스인 경우 파형 수 라벨은 샘플이 됩니다.



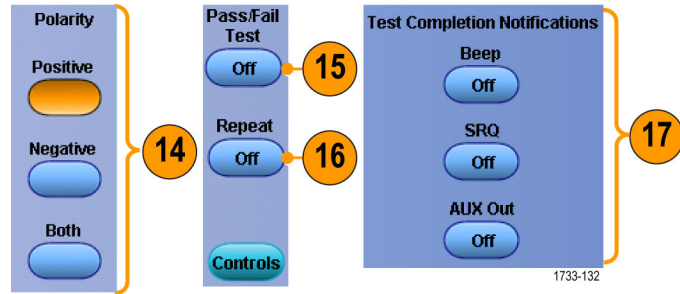
13. 통과/실패 테스트 알림(Pass/Fail Test Notifications)을 선택합니다.

14. 테스트할 극성을 선택합니다.

15. 통과 / 실패 테스트 (Pass/Fail Test) On을 전환하여 마스크 테스트를 시작합니다.

16. 반복(Repeat) On을 전환하여 마스크 테스트를 계속 실행합니다.

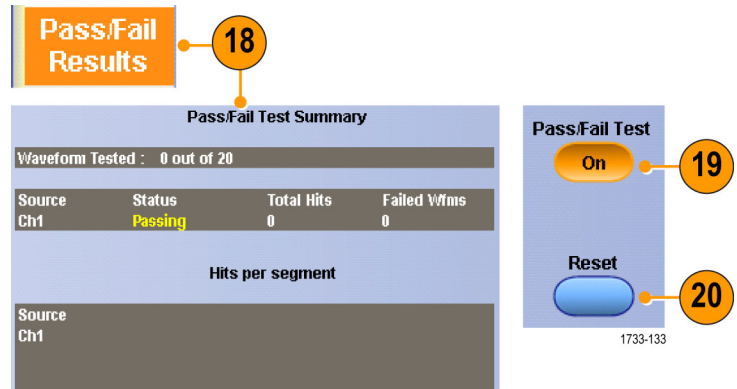
17. 테스트가 완료되면 원하는 알림을 선택합니다.



18. 통과 / 실패 결과 (Pass/Fail Results) 탭을 클릭하여 테스트 결과를 봅니다.

19. 통과 / 실패 테스트 (Pass/Fail Test) On을 클릭하여 마스크 테스트를 시작합니다.

20. 재설정 (Reset)을 클릭하여 전체 결과 값을 재설정하고 모든 위반을 삭제합니다.



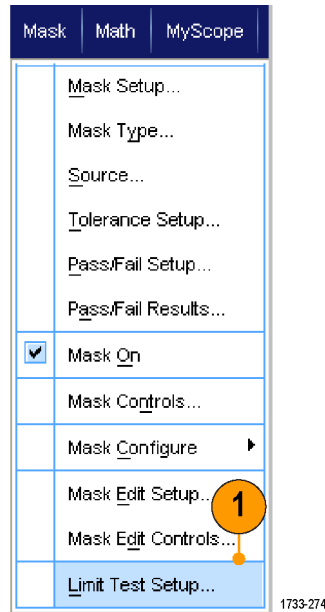
빠른 팁

- 신호가 마스크 내에 있지 않으면 자동 설정(Autoset)을 활성화하여 파형이 마스크 중앙에 오도록 하십시오.

한계 테스트 사용

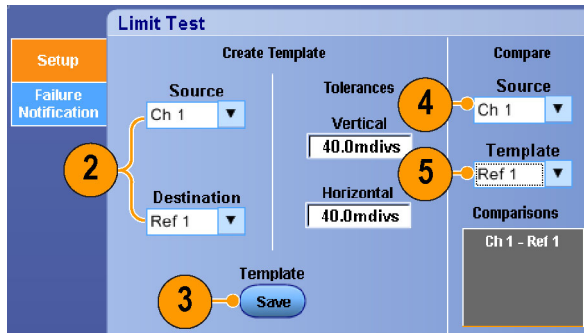
선택적인 한계 테스트는 활성 신호를 템플릿 파형과 비교하는 기능입니다. 알려진 양호한 신호를 통해 템플릿 파형을 작성하고 활성 신호와 비교하여 통과/실패 테스트를 수행합니다.

1. 마스크(Masks) > 한계 테스트 설정...(Limit Test Setup...)을 선택합니다.



1733-274

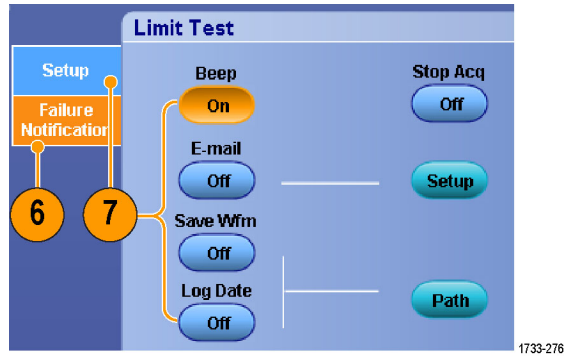
2. 소스(Source), 대상(Destination) 및 공차(Tolerances)를 선택하여 템플릿을 만듭니다. 범용 노브를 사용하여 공차를 조정합니다. 공차는 한계 테스트가 실패하기 전까지의 신호의 허용 한도를 지정합니다.



1733-275

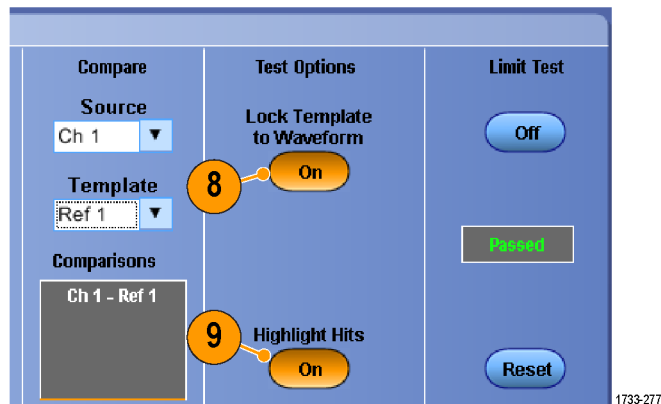
3. 저장(Save)을 클릭합니다. 여러 템플릿을 만들고 나중에 사용하기 위해 저장할 수 있습니다.
4. 템플릿과 비교할 소스 파형을 선택합니다.
5. 소스 파형과 비교할 템플릿을 선택합니다. (일반적으로 이 템플릿은 3 단계에서 만든 템플릿입니다.)

6. 실패 알림(Failure Notification)을 클릭하여 실패 알림을 설정합니다.
7. 실패 알림을 선택한 다음 설정(Setup)을 클릭하여 설정 제어창으로 돌아갑니다.



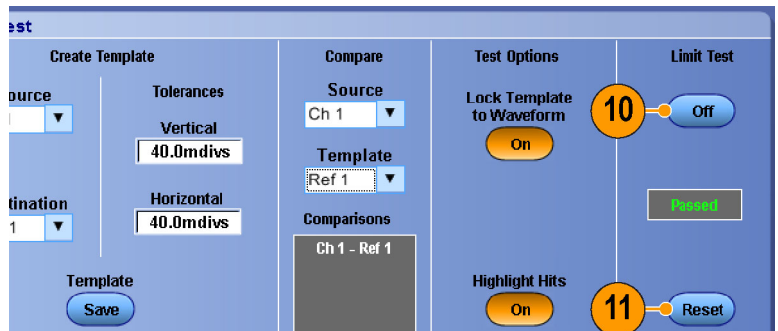
1733-276

8. 템플릿을 파형에 잠금(Lock Template to Waveform) 켜기(On)를 클릭하여 템플릿의 수직 스케일 또는 위치를 소스 파형의 수직 스케일 또는 위치에 잠급니다.
9. 적중수 강조 표시(Highlight Hits) 켜기(On)를 클릭하여 템플릿 외부에 있는 포인트를 다른 색으로 표시합니다.



1733-277

10. 한계 테스트(Limit Test)를 켜기(On)로 전환하여 테스트를 시작합니다.
11. 재설정(Reset)을 클릭하여 모든 위반을 지우고 테스트를 재설정합니다.



1733-278

빠른 팁

- 활성 또는 저장된 파형을 사용하여 한계 테스트 템플릿을 만들 수 있습니다.
- 평균 획득 모드를 사용하면 더 부드러운 템플릿 파형이 만들어집니다.
- 엔벨로프 획득 모드를 사용하면 우발적인 오버슈트를 고려한 템플릿이 만들어집니다.

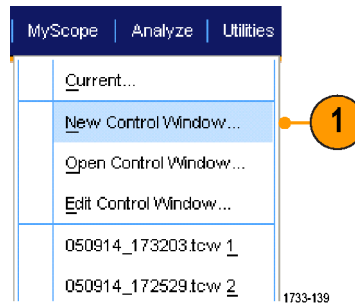
MyScope

MyScope를 사용하면 정기적으로 사용하는 컨트롤만을 포함하는 사용자 정의 제어창을 작성할 수 있습니다. 그러면 여러 제어창 간을 전환하는 대신 사용하는 컨트롤을 사용자 정의 제어창에 넣을 수 있습니다.

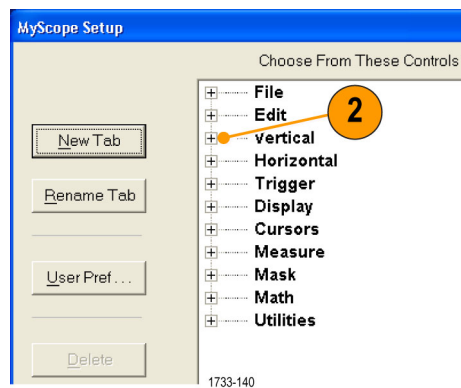
이 절에는 MyScope 제어창 작성 및 사용을 위한 절차가 설명되어 있습니다. 자세한 내용은 온라인 도움말에서 확인할 수 있습니다.

새 MyScope 제어창 작성

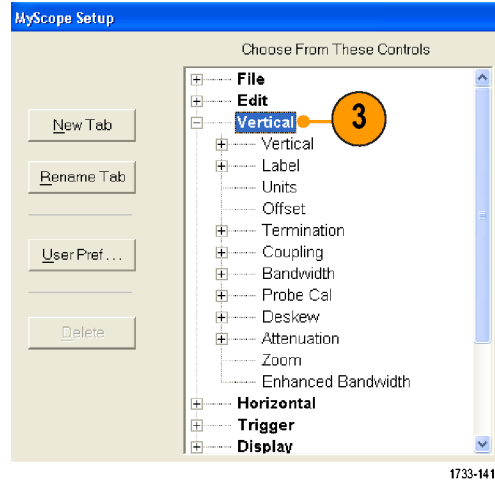
1. MyScope > 새 제어 창...(New Control Window...)을 선택합니다.



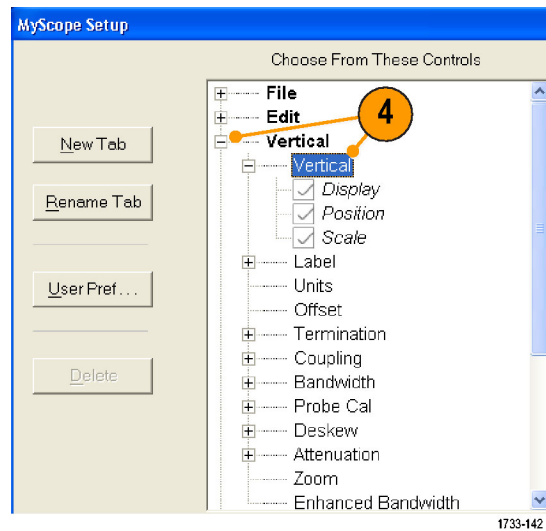
2. +를 클릭하여 범주를 확장합니다. MyScope 제어창에 추가할 수 있는 컨트롤이 각 범주 내에 포함되어 있습니다. 사용자가 일반적으로 사용하는 컨트롤을 쉽게 찾을 수 있도록 이러한 범주는 메뉴 막대와 일치합니다.



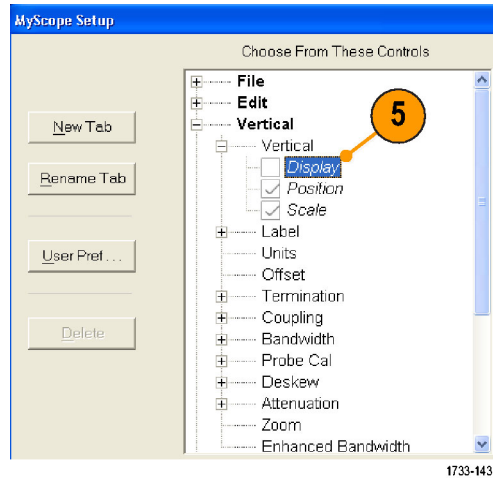
3. 컨트롤을 클릭하여 미리 봅니다.



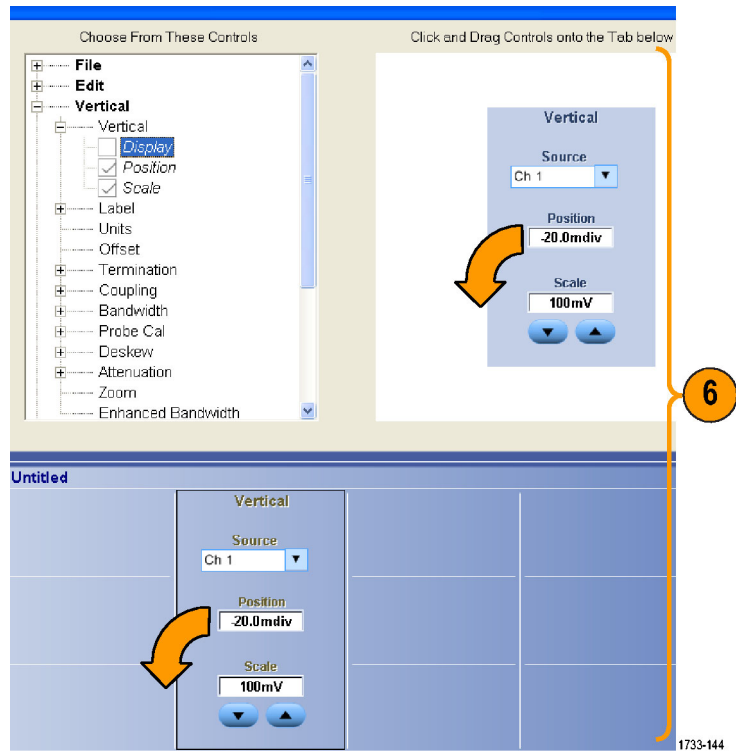
4. 컨트롤을 두 번 클릭하거나 +를 클릭하여 컨트롤 목록을 확장합니다. +가 없으면 해당 컨트롤은 더 이상 사용자 정의할 수 없는 것입니다.



5. 확인란 선택을 취소하여 컨트롤에 포함하지 않을 요소를 제거합니다.



6. 컨트롤을 클릭하여 MyScope 제어창으로 끕니다. 마우스를 놓으면 컨트롤은 가장 가까운 격자 위치로 스냅됩니다. MyScope 제어창에서 컨트롤을 클릭하여 끌어서 위치를 변경할 수 있습니다.

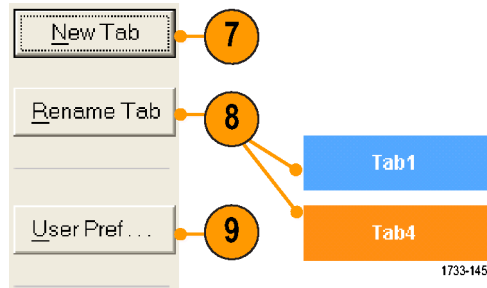


7. 새 탭 (New Tab) 을 클릭 하여 MyScope 제어창에 탭을 추가합니다. 탭은 최대 6개까지 추가할 수 있습니다.

8. 탭의 이름을 변경하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

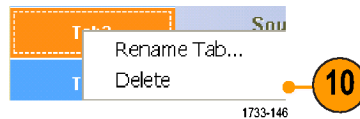
- 탭 이름 변경(Rename Tab)을 클릭합니다.
- 탭을 두 번 클릭한 다음 새 이름을 입력합니다.

9. 사용자 기본 설정...(User Pref...) 을 클릭하여 MyScope 제어창과 함께 로드되는 사용자 기본 설정을 지정합니다.

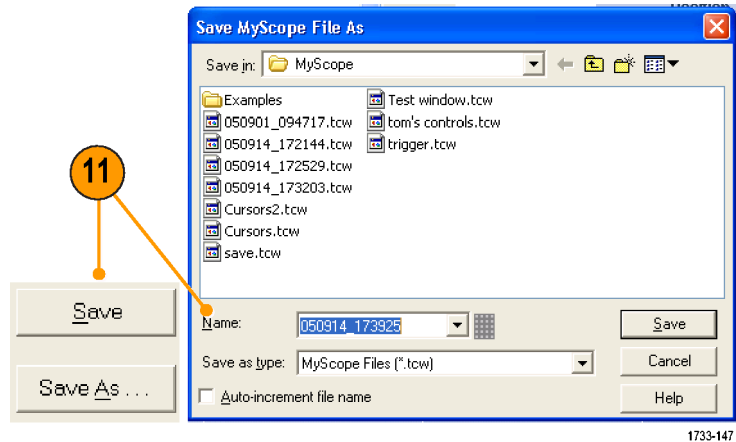


10. 컨트롤을 삭제하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

- 탭을 선택한 다음 삭제(Delete)를 클릭합니다. 그러면 해당 탭과 탭의 모든 컨트롤이 삭제됩니다.
- 컨트롤을 선택한 다음 삭제(Delete)를 클릭합니다. 그러면 선택한 컨트롤만 삭제됩니다.



11. 저장(Save)을 클릭하고 MyScope 제어창 이름을 입력하거나 기본 이름을 사용합니다.



1733-147

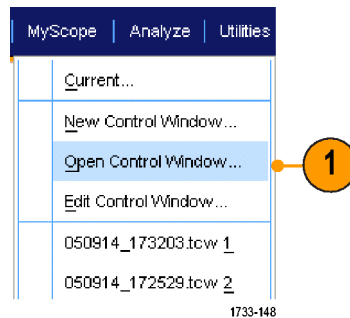
빠른 팁

- 컨트롤을 다시 구성하려면 해당 컨트롤을 클릭하여 미리 보기 창으로 다시 끕니다. 그런 다음 컨트롤에 추가할 요소의 확인란은 선택하고 컨트롤에서 제거할 요소의 확인란은 선택을 취소합니다.
- 탭 순서를 변경하려면 탭을 클릭하여 새 위치로 끕니다.
- 컨트롤을 삭제하려면 해당 컨트롤을 클릭하여 화면 상단부(MyScope 제어창 바깥쪽)로 끕니다.

MyScope 제어창 사용

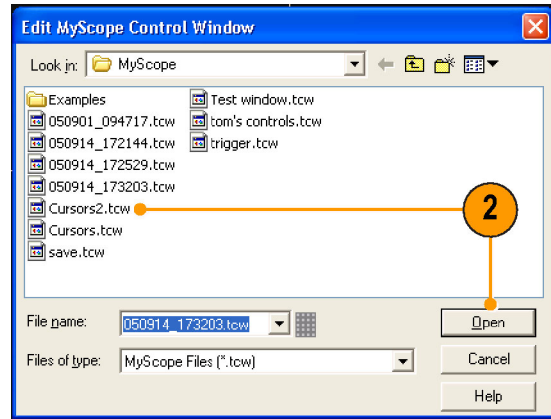
이전에 정의한 MyScope 제어창을 열려면 다음을 수행합니다.

1. **MyScope > 제어창 열기...(Open Control Window...)**를 선택하거나 최근에 사용한 5개 MyScope 창 중 하나를 선택합니다.



1733-148

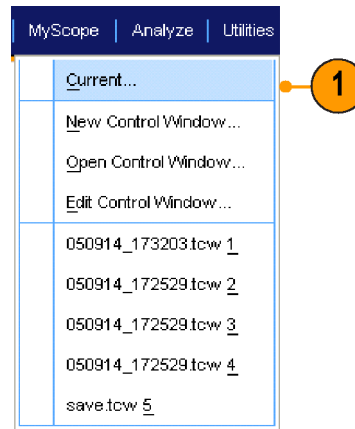
2. 사용할 MyScope 제어창을 선택한 다음 열기(Open)를 클릭합니다.



1733-149

활성 MyScope 제어창을 표시하려면 다음을 수행 합니다:

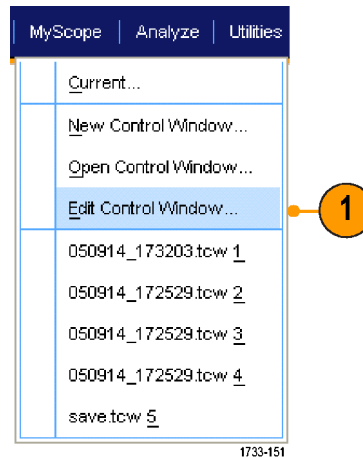
1. **MyScope > 현재...(Current...)** 선택하거나 도구 모음 모드에서 **MyScope** 를 클릭 합니다 . MyScope 제어창은 표시되지 않아도 활성 상태로 유지됩니다.



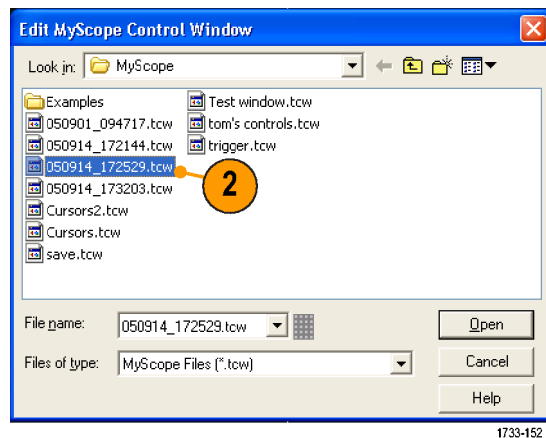
1733-150

MyScope 제어창을 편집하려면 다음을 수행 합니다:

1. MyScope > 제어창 편집...(Edit Control Window...)을 선택합니다.



2. 편집할 제어창을 선택한 다음 열기(Open)를 클릭합니다.



빠른 팁

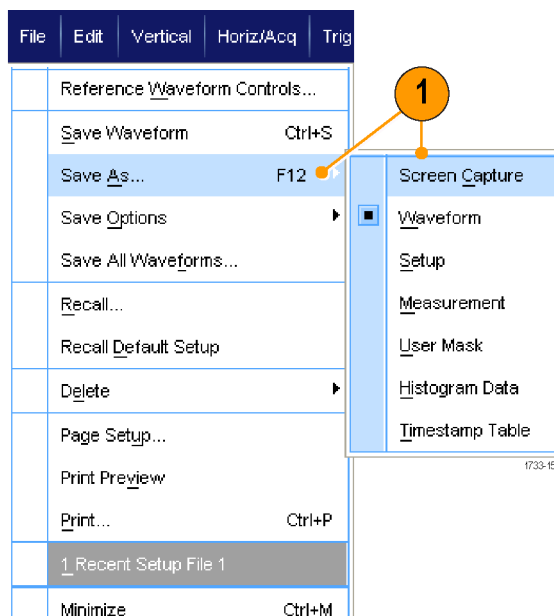
- 일부 컨트롤은 MyScope 제어창에서 표준 제어창과는 다르게 작동합니다. 자세한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오.
- MyScope 제어창(.tcw 파일)을 다른 DPO7000 및 DPO/DSA70000/B 시리즈 장비로 복사할 수 있습니다.

정보 저장 및 호출

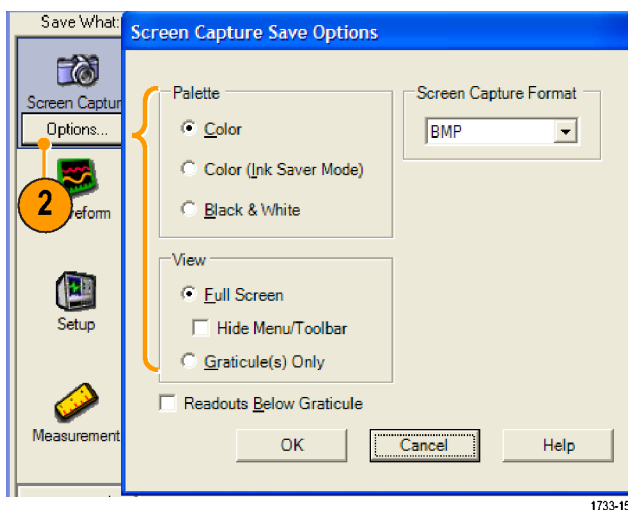
이 절에는 화면 포착 및 설정 저장과 호출, 측정값 저장, 클립보드 사용 및 장비에서 인쇄 작업을 위한 절차가 설명되어 있습니다. 자세한 내용은 온라인 도움말에서 확인할 수 있습니다.

화면 포착 저장

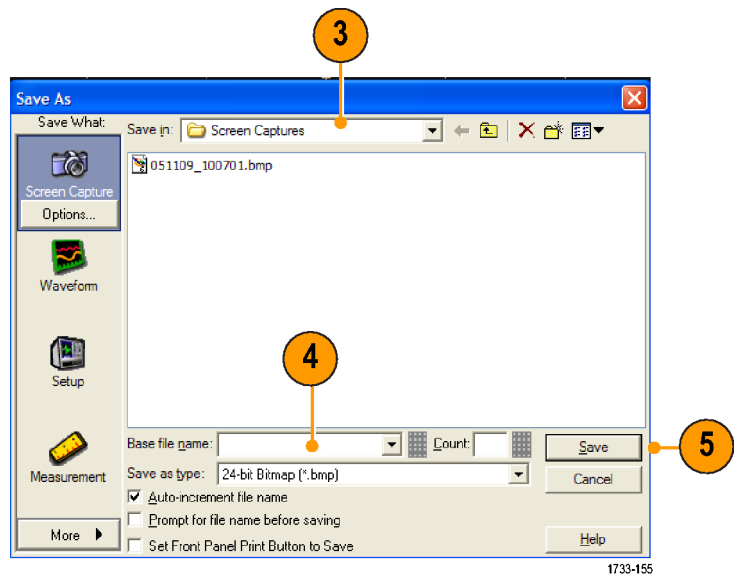
1. 파일(File) > 저장(Save) 또는 다른 이름으로 저장(Save As) > 화면 포착...(Screen Capture...)을 선택합니다.



2. 팔레트(Palette), 보기(View), 이미지(Image) 또는 화면 포착 형식(Screen Capture Format) 옵션을 설정하려면 옵션...(Options...)을 클릭합니다. 그렇지 않은 경우에는 3단계로 건너뛵니다.



3. 화면 포착을 저장할 위치를 선택합니다.
4. 화면 포착의 이름을 입력하거나 기본 이름을 사용하고 파일 유형을 선택합니다.
5. 저장(Save)을 클릭합니다.

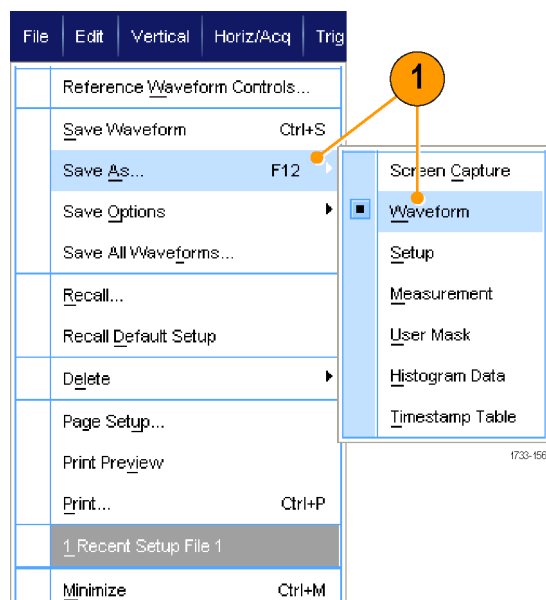


빠른 팁

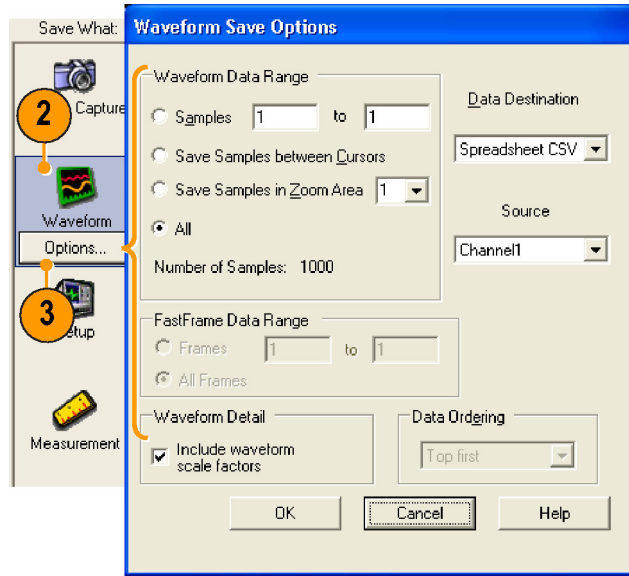
- 여러 화면 포착을 빠르게 저장하려면 **전면 패널 인쇄 버튼으로 저장하도록 설정(Set Front Panel Print Button to Save)**을 선택한 다음 저장(Save)을 클릭합니다. 이렇게 하면 전면 패널 인쇄 버튼을 눌러 화면 포착을 저장할 수 있습니다.

파형 저장

1. 파형을 저장하려면 **파일(File) > 저장(Save) 또는 다른 이름으로 저장(Save As) > 파형...(Waveform...)**을 선택합니다.

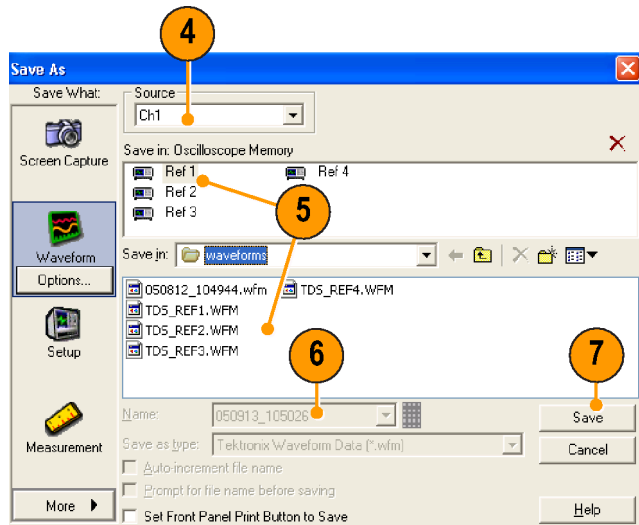


2. 파형(Waveform)을 클릭합니다.
3. 파형 데이터 범위(Waveform Data Range), FastFrame 데이터 범위(FastFrame Data Range), 파형 세부 사항(Waveform Detail), 데이터 대상(Data Destination), 소스(Source) 또는 데이터 순서(Data Ordering)를 지정하려면 옵션...(Options...)을 선택합니다. 그렇지 않은 경우에는 4 단계로 건너뛵니다.



1733-157

4. 소스를 선택합니다.
5. 파형을 기존 파형으로 장치 메모리에 저장할 수도 있고 Windows 디렉토리에 .wfm 파일로 저장할 수도 있습니다. 파형을 참조로 저장하려면 참조 1-4를 선택합니다. 파형을 .wfm 파일로 저장하려면 파형을 저장할 위치를 선택합니다.
6. .wfm 파일로 저장하는 경우 파일 이름을 입력하거나 기본값을 사용합니다.
7. 저장(Save)을 클릭합니다.



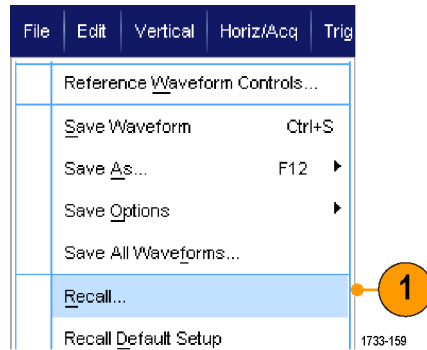
1733-158

빠른 팁

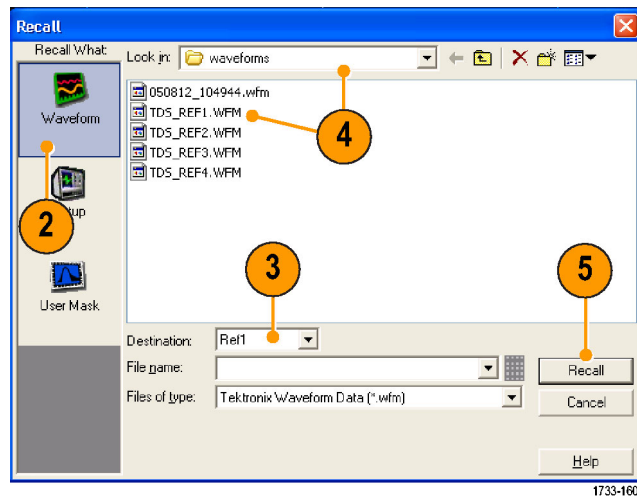
- 전체 이름을 다시 입력할 필요 없이 많은 수의 유사한 파형을 저장하려면 파일 이름 자동 증분(Auto-increment file name)을 선택합니다.
- 여러 파형을 빠르게 저장하려면 전면 패널 인쇄 버튼으로 저장하도록 설정(Set Front Panel Print Button to Save)을 선택한 다음 저장(Save)을 클릭합니다. 이렇게 하면 전면 패널 인쇄 버튼을 눌러 파형을 저장할 수 있습니다.

파형 호출

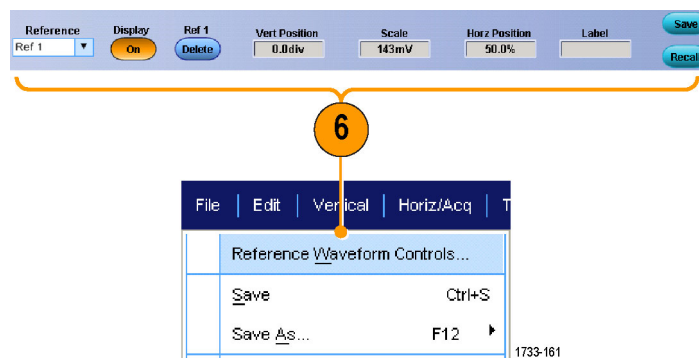
1. 파일(File) > 호출...(Recall...)을 선택 합니다.



2. 파형(Waveform)을 클릭 합니다.
3. 호출할 파형의 대상을 선택 합니다.
4. 호출할 파형을 선택 합니다.
5. 호출(Recall)을 클릭 합니다. 호출을 클릭하면 기준 파형이 켜지고 기준 파형 제어창이 활성화 됩니다.



6. 컨트롤을 사용하여 기준 파형을 조정 합니다. 파일(File) > 기준 파형 컨트롤(Reference Waveform Controls...)을 선택하여 기준 파형(Reference Waveform) 제어창에 액세스 할 수도 있습니다.

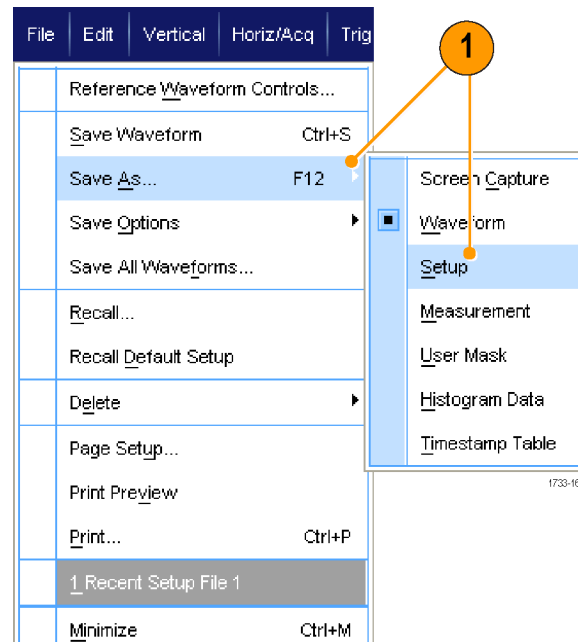


빠른 팁

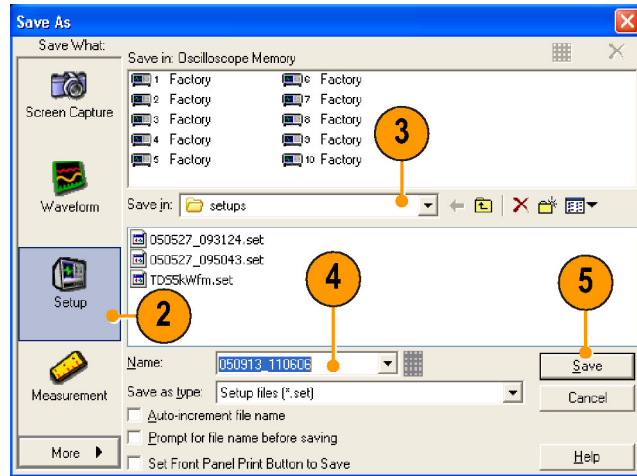
- 여러 파일 유형을 저장할 수는 있지만 설정(*.setup) 파일 및 파형(*.wfm) 파일만 호출할 수 있습니다.

장비 설정 저장

1. 파일 (File) > 저장 (Save) 또는 다른 이름으로 저장 (Save As) > 설정...(Setup...)을 선택합니다.



2. 설정(Setup)을 클릭합니다.
3. 설정을 저장할 위치를 선택합니다. 설정은 10개의 설정 스토리지 위치 중 하나에 있는 장비 메모리에 저장할 수도 있고, Windows 디렉토리에 .set 파일로 저장할 수도 있습니다.
4. 파일 이름을 입력하거나 기본 이름을 사용합니다. 장비 메모리에 저장되는 설정의 파일 이름을 입력하려면 팝업 키보드를 사용하십시오.
5. 저장(Save)을 클릭합니다.



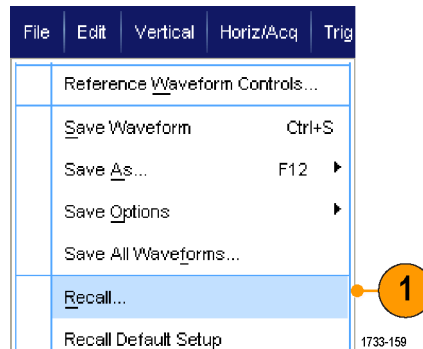
1733-163

빠른 팁

- 터치 스크린이 활성화되어 있는 경우 팝업 키패드를 사용하여 설정에 라벨을 지정하면 쉽게 식별할 수 있습니다.
- 전체 파일 이름을 다시 입력할 필요 없이 많은 수의 유사한 파일을 저장하려면 파일 이름 자동 증분을 사용합니다.
- 여러 설정을 빠르게 저장하려면 **전면 패널 인쇄 버튼으로 저장하도록 설정(Set Front Panel Print Button to Save)**을 선택한 다음 저장(Save)을 클릭합니다. 이렇게 하면 전면 패널 인쇄 버튼을 눌러 설정을 저장할 수 있습니다.

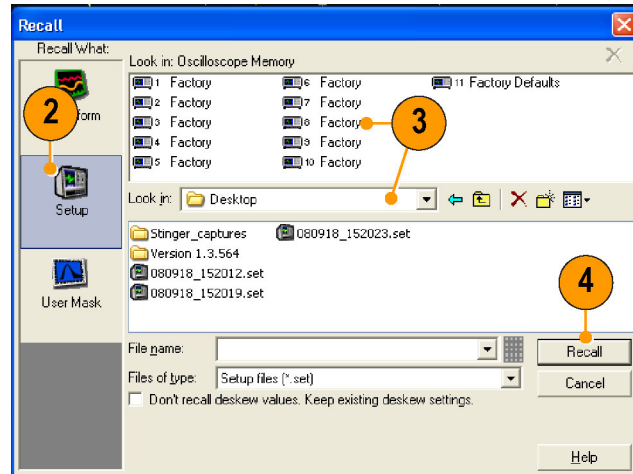
장비 설정 호출

1. 파일(File) > 호출...(Recall...)을 선택합니다.



1733-159

2. 설정(Setup)을 클릭합니다.
3. 호출할 설정을 선택합니다. 장비 메모리의 10개 위치 중 하나 또는 Windows 디렉토리에서 설정 파일을 호출할 수 있습니다.
현재 지연시간 보정 설정을 유지하려면 **지연시간 보정 값을 호출하지 않음(Don't recall deskew values)**을 클릭합니다.
4. 호출(Recall)을 클릭합니다.



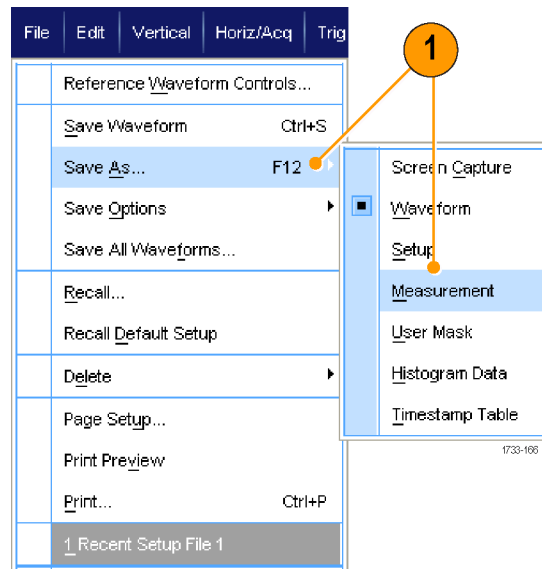
1733-164

빠른 팁

- 디스크에 저장된 설정을 호출하여 내부 설정 스토리지 위치에 저장하면 해당 설정에 보다 빨리 액세스할 수 있습니다.

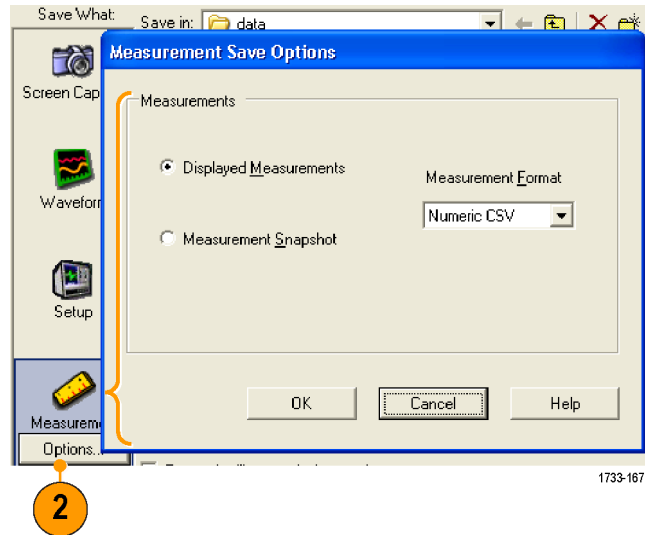
측정값 저장

1. 파일(File) > 저장(Save) 또는 다른 이름으로 저장(Save As) > 측정값...(Measurement...)을 선택합니다.

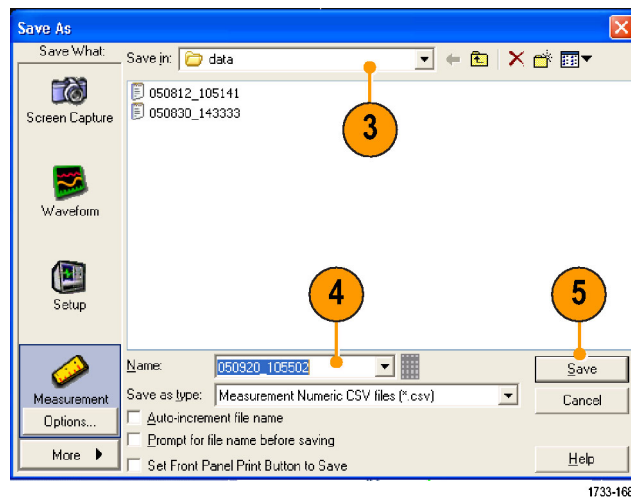


1733-166

2. 표시된 측정값(Displayed Measurements), 측정값 스냅샷(Measurement Snapshot) 또는 측정값 형식(Measurement Format)을 지정하려면 **옵션...(Options...)**을 클릭합니다. 그렇지 않은 경우에는 3단계로 건너뜁니다.



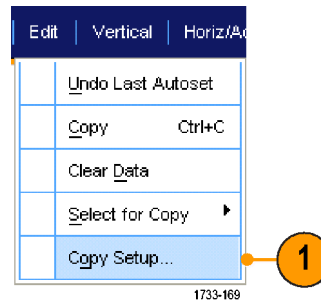
3. 측정값을 저장할 위치를 선택합니다.
4. 측정값 이름을 입력한 다음 파일 유형을 선택합니다.
5. **저장(Save)**을 클릭합니다.



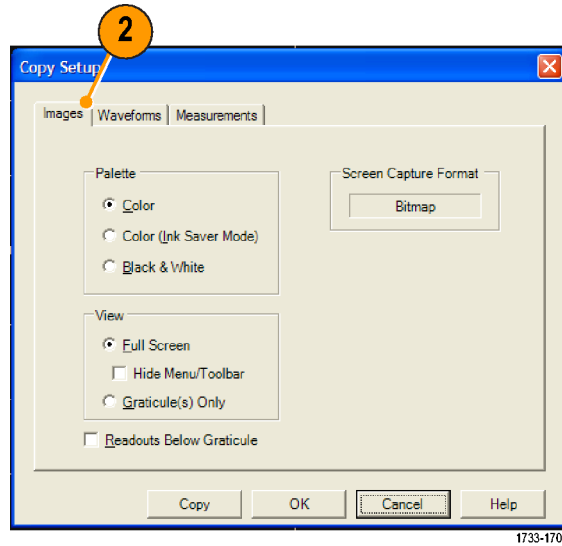
결과를 클립보드에 복사

이미지, 파형 및 측정값의 출력 내용 및 형식을 Microsoft 클립보드로 복사하도록 설정하려면 다음 절차를 사용하십시오.

1. 편집 (Edit) > 복사 설정...(Copy Setup...)을 선택합니다.



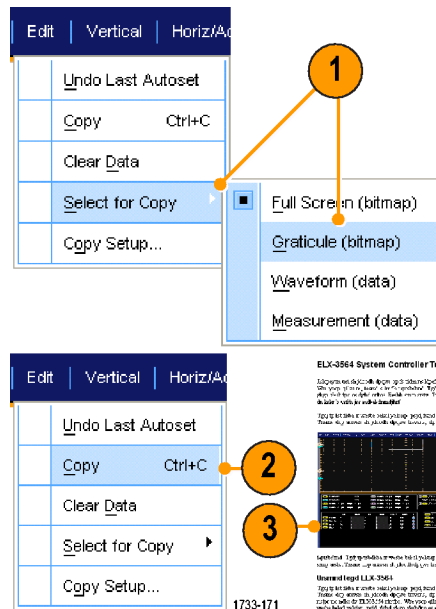
2. 이미지 (Images), 파형 (Waveforms) 또는 측정값 (Measurements) 탭을 클릭하고 원하는 옵션을 선택합니다.



1733-170

이미지, 파형 또는 측정값을 복사하려면 다음 절차를 수행하십시오:

1. 복사할 항목을 선택합니다.
2. 편집(Edit) > 복사(Copy)를 선택하거나 Ctrl+C를 누릅니다.
3. Ctrl+V를 눌러 항목을 Windows 애플리케이션에 붙여 넣습니다.

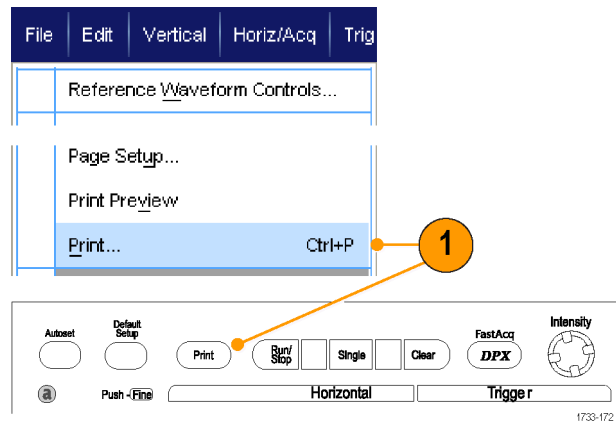


1733-171

하드 카피 인쇄

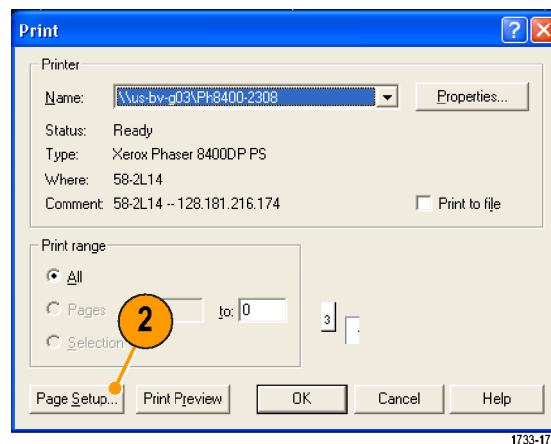
1. 하드 카피를 인쇄하려면 다음 중 하나를 수행 합니다.

- 인쇄 (PRINT)를 누릅니다.
- 파일 (File) > 인쇄 (Print)을 선택합니다. 필요할 경우 페이지 설정 (Page Setup) 대화 상자에서 페이지의 쪽 모양을 변경할 수 있습니다.

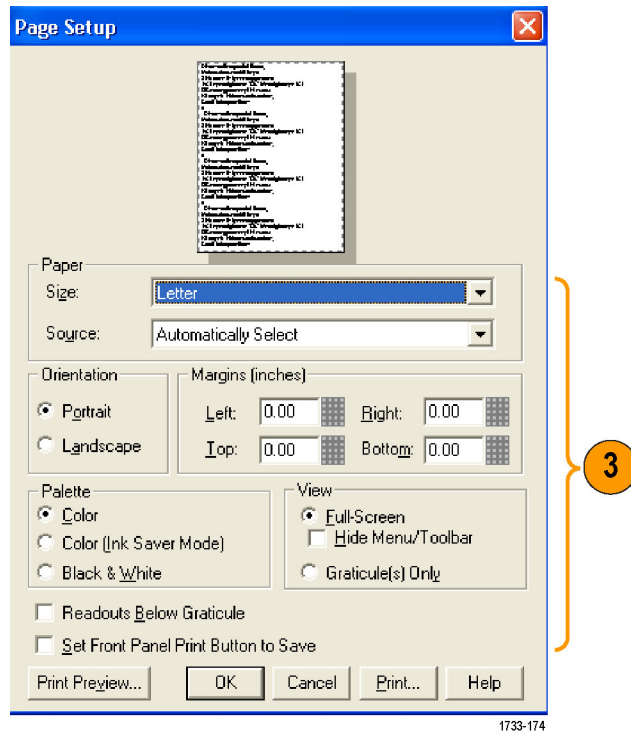


인쇄 및 페이지 설정 대화 상자는 사용하는 프린터에 따라 달라집니다.

2. 페이지 설정...(Page Setup...)을 클릭합니다.



3. 인쇄 매개 변수를 선택합니다.



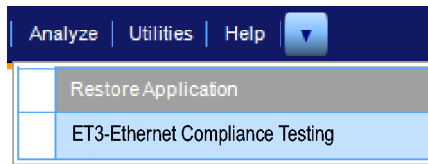
애플리케이션 소프트웨어 실행

옵션 애플리케이션 소프트웨어 CD에는 장비에 설치하여 무료로 5회 시험 사용할 수 있는 옵션 애플리케이션 소프트웨어가 들어 있습니다. 이러한 애플리케이션은 애플리케이션 관련 측정 솔루션을 제공합니다. 일부 예제에 대해서는 아래 설명되어 있습니다. 추가 패키지를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Tektronix 대리점에 문의하거나 www.tektronix.com의 자사 웹 사이트를 방문하십시오.

- **ASM** 고급 이벤트 검색 및 표시를 사용하여 중요한 이벤트를 강조 표시하고 중요하지 않은 이벤트를 건너뛰면서 데이터를 검색할 수 있습니다.
- **CP2**를 사용하여 ITU-T G.703 및 ANSI T1.102 통신 표준에 대해 마스크 및 측정 표준 준수 테스트를 수행할 수 있습니다.
- **DDRA** 메모리 버스 분석을 사용하여 DDR1, LP-DDR1, DDR2, DDR3 및 GDDR3 읽기와 쓰기를 자동으로 식별할 수 있습니다.
- **DSPT** 디스플레이 포트 표준 준수 소프트웨어를 사용하여 IC, 마더보드 및 그래픽 카드를 확인할 수 있습니다.
- **DVI** 표준 준수 테스트 솔루션 소프트웨어를 사용하여 DVI 물리층 표준 준수 테스트를 수행할 수 있습니다.
- **ET3**를 사용하여 10/100/1000 Base-T 이더넷 표준 준수 테스트를 수행할 수 있습니다.
- **FBD RTE** 모듈을 4GHz 이상 모델용 FB-DIMM 표준 준수에 사용할 수 있습니다.
- **HT3** HDMI 표준 준수 테스트 소프트웨어를 사용하여 HDMI 표준 준수 테스트를 수행할 수 있습니다.
- **IBA RTE** 모듈을 4GHz 이상 모델용 InfiniBand에 사용할 수 있습니다.
- **J2** 디스크 드라이브 측정 소프트웨어를 사용하여 IDEMA 표준에 따라 디스크 드라이브 신호를 측정할 수 있습니다.
- **JA3 Advanced** 또는 **JE3 Essentials** 지터 분석 소프트웨어를 사용하여 타이밍 성능을 특성화할 수 있습니다. 본 프로그램은 싱글 샷 획득을 이용하여, 지속적인 클럭 사이클 동안 지터를 분석합니다.
- **LSA** 직렬 분석 소프트웨어를 사용하면 CAN/LIN 프로토콜 트리거링 및 분석을 수행할 수 있습니다.
- **LT** 파형 한계 테스트를 사용하여 획득한 파형을 설정한 공차 한계와 비교할 수 있습니다.
- **MTH** 통신 마스크 테스트 소프트웨어를 사용하여 마스크 표준 준수 테스트를 수행할 수 있습니다 (4GHz 이상 모델에 사용 가능함).
- **MTM** 통신 마스크 테스트 소프트웨어를 사용하여 마스크 표준 준수 테스트를 수행할 수 있습니다 (4GHz 미만 모델에 사용 가능함).
- **RTE** 실시간 아이 측정 소프트웨어를 사용하여 직렬 표준 준수 및 분석을 수행할 수 있습니다. 많은 직렬 표준에 대한 표준 준수 모듈이 있습니다.
- **PCE RTE** 모듈을 4GHz 이상 모델용 PCI-Express에 사용할 수 있습니다.
- **PTH, PTU** 또는 **STU** 직렬 프로토콜 트리거 소프트웨어를 사용하여 고속 직렬 또는 데이터 프로토콜에서 8B/10B 데이터를 트리거 및 디코딩할 수 있습니다. 프로토콜은 5GS/s까지 트리거됩니다.
- **PTM** 및 **PTD** 직렬 프로토콜 트리거 및 디코딩 소프트웨어를 사용하여 최대 1.25Gb/s의 데이터 속도에서 데이터 종속 오류를 간단히 확인하고 격리할 수 있습니다..

- **PWR** 전원 측정 소프트웨어를 사용하여 전원 공급 스위칭 장치 및 자기 요소의 전원 소비를 빠르게 측정 및 분석할 수 있습니다.
- **SLA** 및 **SLE** 직렬 데이터 링크 분석을 사용하여 직렬 데이터 링크를 분석할 수 있습니다.
- **SST** 직렬 ATA 및 직렬 연결 SCSI 표준 준수 모듈을 옵션 RTE와 함께 사용할 수 있습니다.
- **USB**를 사용하여 마스크 테스트 및 매개 변수 테스트를 포함해 USB 2.0 신호를 특성화할 수 있습니다(소프트웨어 전용).
- **UWB** 및 **UWBE** 초광대역 스펙트럼 분석을 사용하여 WiMedia를 간단하게 처리할 수 있습니다.
- **VNM** CAN/LIN 프로토콜 분석 소프트웨어를 사용하여 CAN 및 LIN 테스트를 수행할 수 있습니다 (CAN 트리거는 포함되지 않음).

애플리케이션 소프트웨어에 나타난 지시에 따라 프로그램을 설치합니다. 소프트웨어를 실행하려면 **분석 (Analyze)**을 선택한 다음 애플리케이션을 선택합니다.



1733-175

애플리케이션 예제

이 절에는 일반적인 문제 해결 작업에서 장비를 사용하는 방법 및 장비를 보다 폭넓게 사용할 수 있는 방법이 설명되어 있습니다.

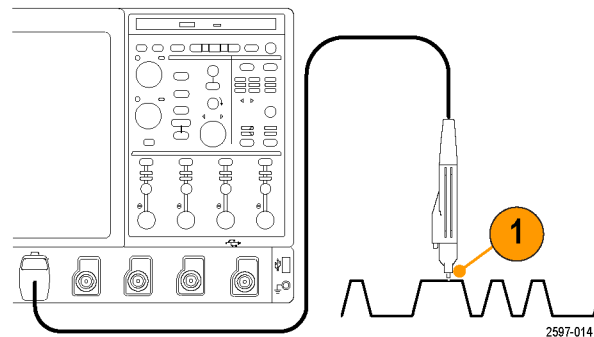
일시적인 이상 포착

설계 엔지니어들이 경험하는 가장 까다로운 작업 중 하나는 일시적인 이상의 원인을 추적하는 것입니다. 찾고 있는 이상의 유형을 아는 경우에는 오실로스코프 고급 트리거링 기능을 구성하여 쉽게 이상 현상을 포착할 수 있습니다. 그러나 이상의 유형을 모르는 경우에는 작업에 시간이 매우 많이 소요될 수 있습니다. 특히 일반적인 디지털 스토리지 오실로스코프에서 파형 포착율이 낮은 경우에는 더욱 그러합니다.

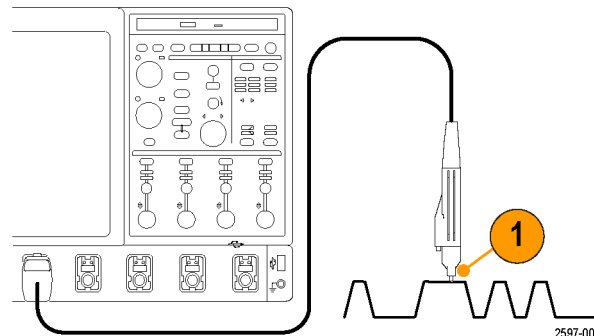
DPX 기술이 채용된 디지털 포스퍼 오실로스코프에는 고속 획득이라는 매우 빠른 획득 모드가 있기 때문에 이와 같은 이상을 몇 초나 몇 분 내에 찾을 수 있습니다. 일반 DSO의 경우에는 동일한 이벤트를 찾는 데 몇 시간이나 며칠이 걸릴 수도 있습니다.

일시적인 이상을 포착하려면 다음 절차를 사용하십시오.

1. 프로브를 입력 신호 소스에 연결합니다.

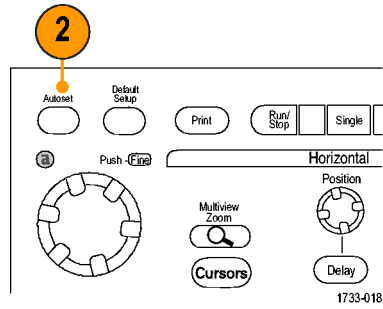


4GHz 미만 모델

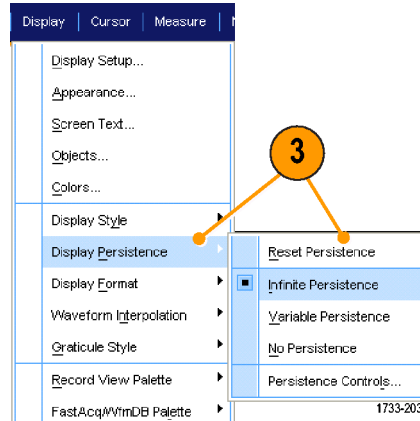


4GHz 이상 모델

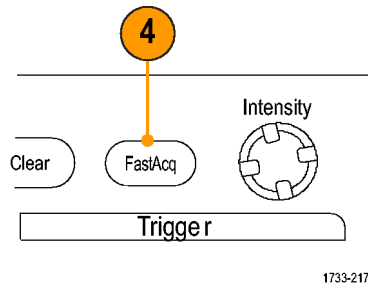
2. 자동 설정(Autoset)을 누릅니다.



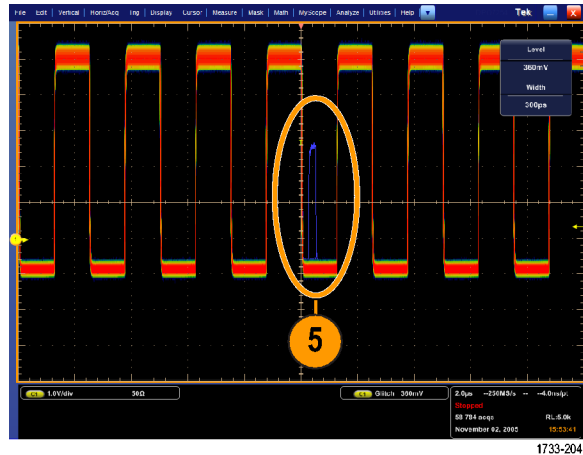
3. 디스플레이(Display) > 화면 지속(Display Persistence) > 무한대 지속(Infinite Persistence)을 선택합니다. 이 예제에서는 클럭 신호를 찾습니다. 1 - 2분 동안 신호를 관찰한 후 다른 문제를 조사하기 전에 4단계로 이동합니다.



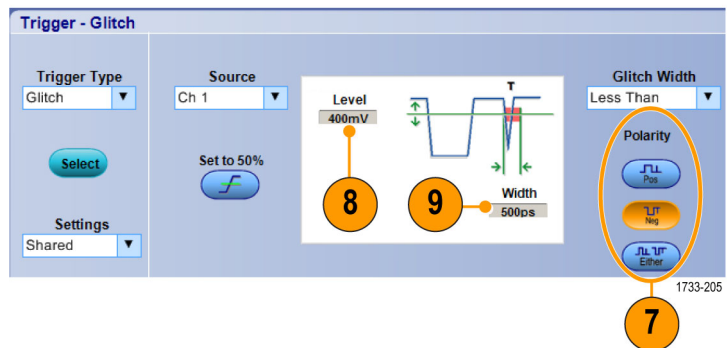
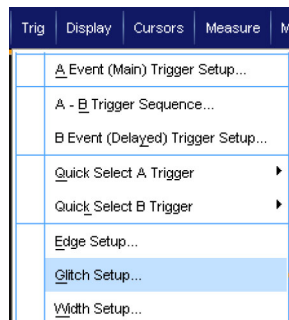
4. 고속 획득(FastAcq)을 누릅니다.



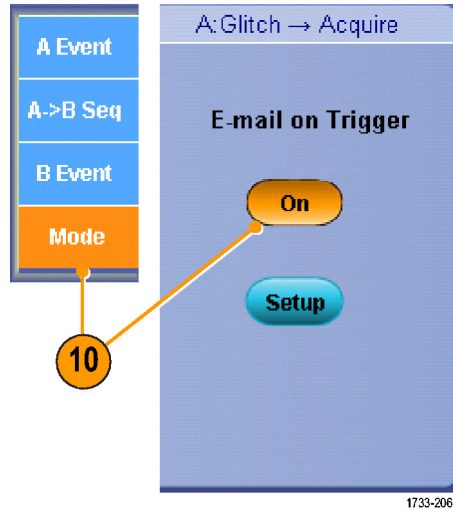
- 신호에 나타나는 글리치, 일시적인 이상 또는 기타 임의적인 이상을 찾습니다. 이 예제에서는 고속 획득이 시작된 지 단 몇 초 후에 ≈ 300 ns 포지티브 글리치가 발견되었습니다.



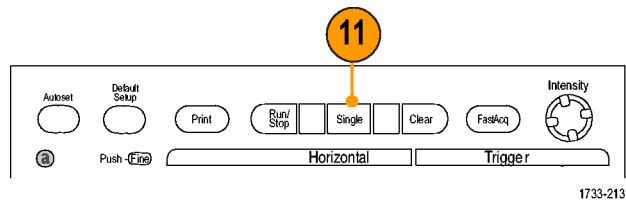
- 5단계에서 확인된 글리치에서 트리거하려면 **글리치 설정...(Glitch Setup...)**을 선택합니다.
- 적절한 극성을 선택합니다.
- 레벨(Level)**을 선택한 다음 5단계에서 찾은 이상을 기준으로 레벨을 설정합니다.
- 폭(Width)**을 선택한 다음 5단계에서 찾은 이상을 기준으로 폭을 설정합니다.



10. 트리거 시 전자 우편 전송(E-mail on Trigger) **On**을 클릭합니다.
(135페이지의 *이벤트 시 전자 우편 설정 참조*)



11. **싱글(Single)**을 클릭하여 단일 클리치에서 트리거합니다.

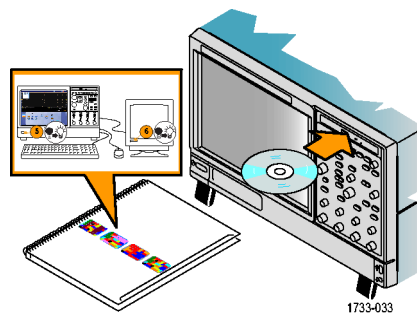


효과적인 문서화를 위한 확장 데스크톱 및 OpenChoice 구조 사용

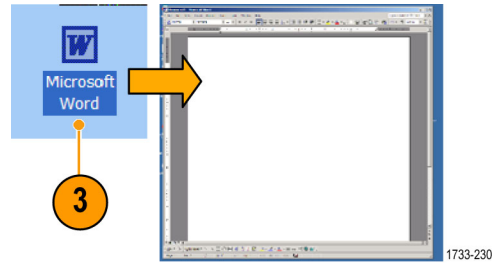
엔지니어는 나중에 참조하기 위해 업무 내용을 문서화해야 하는 경우가 많습니다. 화면 샷이나 파형 데이터를 CD 또는 USB 메모리 장치에 저장했다가 나중에 보고서를 생성하는 대신 OpenChoice를 사용하면 실시간으로 작업 내용을 문서화할 수 있습니다.

장비를 중심으로 하여 설계 및 문서화 과정을 수행하려면 다음 프로시저를 사용하십시오.

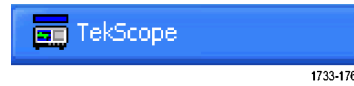
1. 장비에서 Microsoft Word 또는 Excel을 로드합니다.
2. 두 번째 모니터를 연결합니다. (9 페이지의 *두 번째 모니터 추가 참조*)



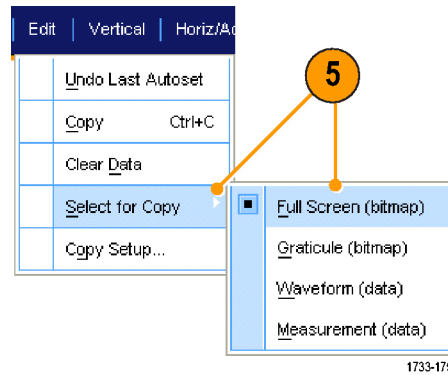
3. Microsoft Word를 열고 Word 창을 확장 데스크톱으로 끕니다.



4. TekScope를 클릭하여 장비 애플리케이션을 복원합니다.

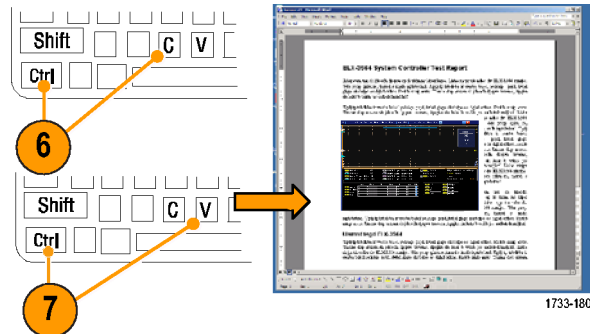


5. 편집(Edit) > 복사용으로 선택(Select for Copy) > 전체 화면(비트맵)(Full Screen (bitmap))을 선택합니다.



6. Ctrl+C를 누릅니다.

7. Word 문서에서 화면 샷을 놓을 위치를 클릭한 다음 Ctrl+V를 누릅니다.



빠른 팁

- 장비에는 사용자 설계 환경의 나머지 부분에 대해 효율성 및 연결성을 최대화하기 위한 다양한 OpenChoice 소프트웨어 도구가 포함되어 있습니다.

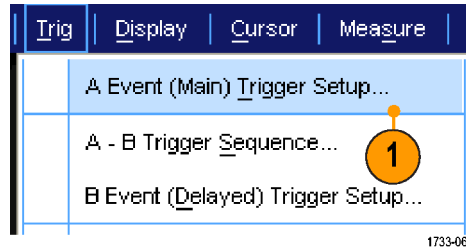
버스 트리거

장비를 사용하여 CAN(옵션), I²C 및 SPI 버스에서 트리거할 수 있습니다. 이 장비는 물리층을 아날로그 파형으로 표시하고 프로토콜 레벨 정보(CAN 및 LIN 트리거의 경우)를 디지털 및 상징적 파형으로 표시할 수 있습니다.

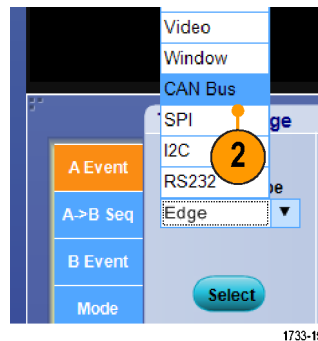
주석노트. 일부 장비에서는 일부 트리거 유형을 사용할 수 없습니다.

버스 트리거를 설정하려면

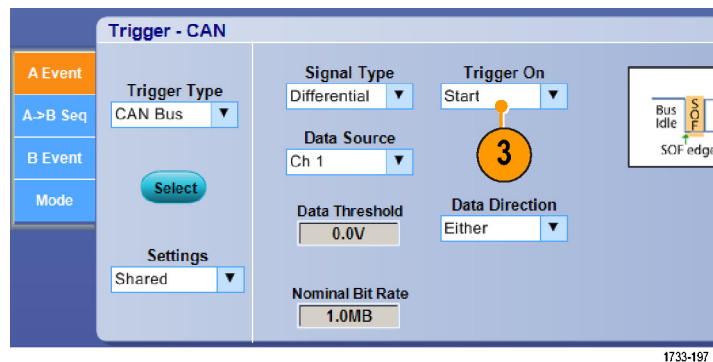
1. 트리거(Trig) > A 이벤트(주) 트리거 설정...(A Event (Main) Trigger Setup...)을 선택합니다.



2. A 이벤트(A Event) 탭에서 A 트리거 유형 및 소스를 설정합니다.



3. 트리거 On(Trigger On)에서 원하는 트리거를 선택합니다.



4. 트리거 On에서 선택하는 항목에 따라 추가적인 선택이 필요할 수도 있습니다.

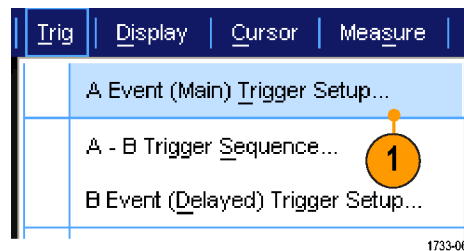
비디오 신호에서 트리거링

이 장비는 NTSC, SECAM, PAL 및 고선명 신호에서의 트리거링을 지원합니다.

비디오 필드를 트리거하려면

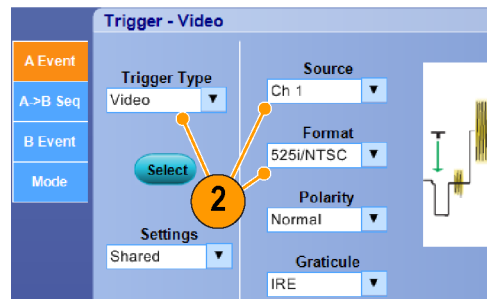
주석노트. 일부 장비에서는 비디오 트리거 유형을 사용할 수 없습니다.

1. 트리거(Trig) > A 이벤트(주) 트리거 설정...(A Event (Main) Trigger Setup...)을 선택합니다.



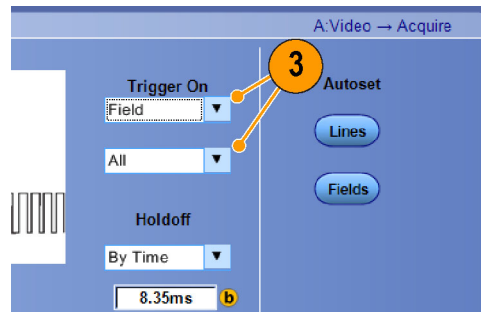
1733-068

2. A 이벤트(A Event) 탭에서 A 트리거 유형 및 소스를 설정합니다.
형식 (Format) > 525i/NTSC를 선택합니다.



1733-193

3. 트리거 On(Trigger On) > 필드 (Field)를 선택합니다.
홀수(Odd), 짝수(Even) 또는 모두 (All) 필드 중 하나를 선택합니다.

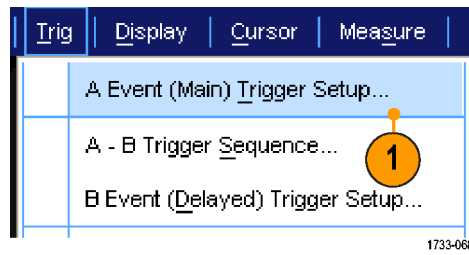


1733-199

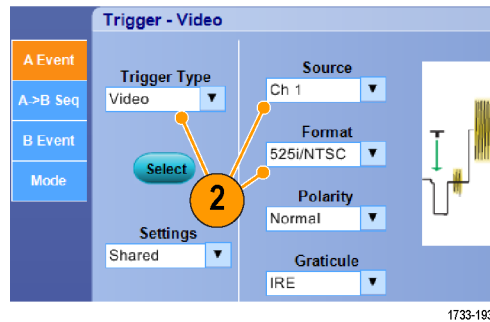
라인 트리거링

필드에서 비디오 라인을 보려면

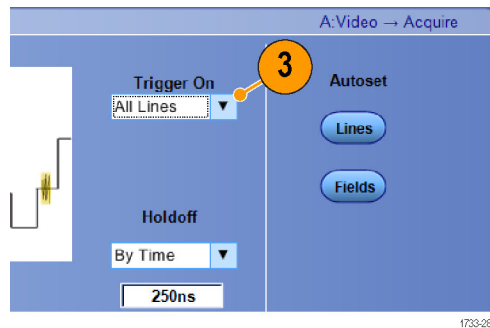
1. 트리거(Trig) > A 이벤트(주) 트리거 설정...(A Event (Main) Trigger Setup...)을 선택합니다.



2. A 이벤트(A Event) 탭에서 A 트리거 유형 및 소스를 설정합니다.
형식(Format) > 525/NTSC를 선택합니다.

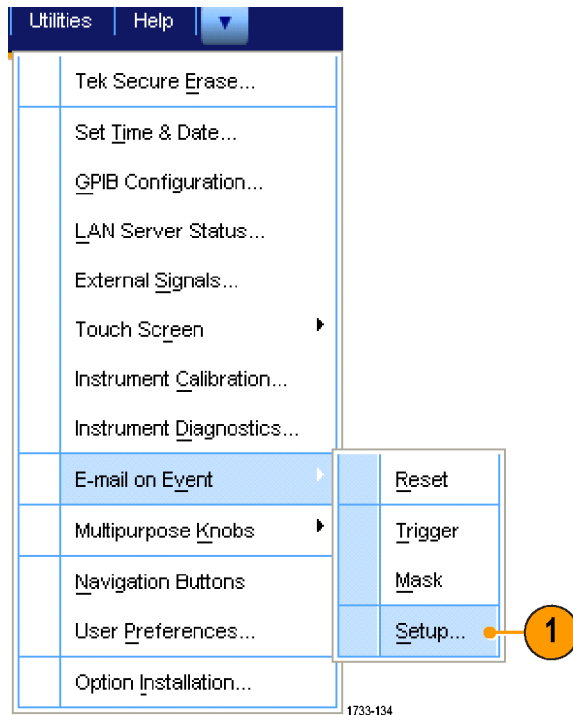


3. 트리거 On(Trigger On) > 모든 라인(All Lines)을 선택합니다.

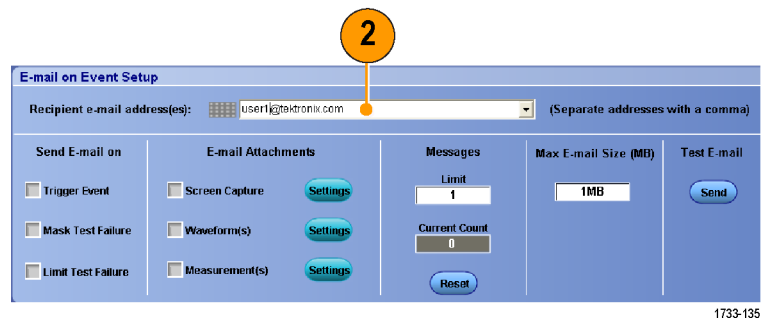


이벤트 시 전자 우편 설정

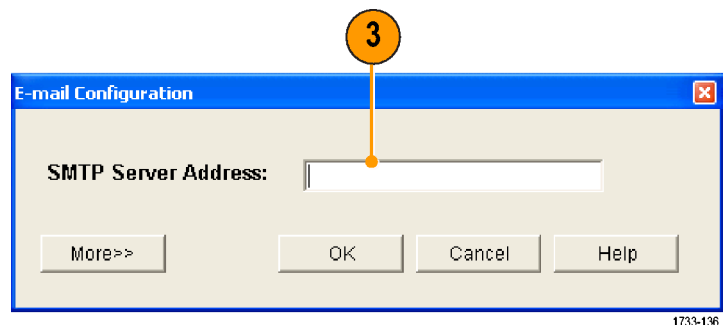
1. 유틸리티 (Utilities) > 이벤트 시 전자 우편 (E-mail on Event) > 설정...(Setup...)을 선택합니다.



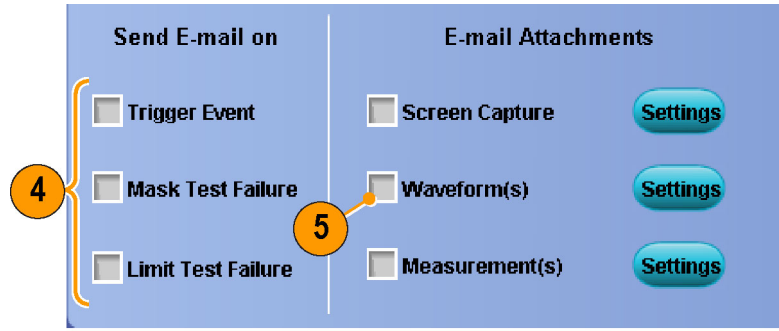
2. 받는 사람의 전자 우편 주소를 입력합니다. 여러 항목을 입력하는 경우 쉼표로 구분합니다. 전자 우편 주소 상자에는 문자를 252자까지 입력할 수 있습니다.



3. 구성 (Config) 을 클릭 한 다음 SMTP 서버 주소를 입력합니다. 올바른 주소를 확인하려면 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

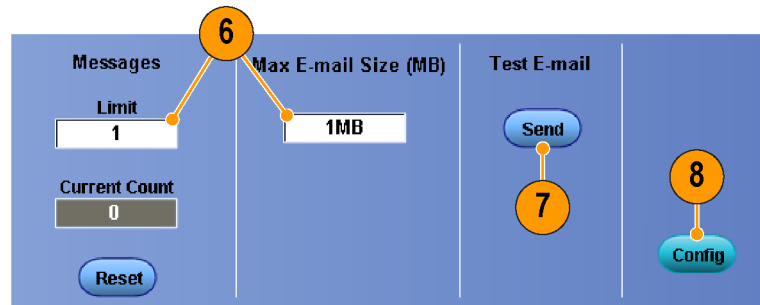


4. 전자 우편을 보낼 이벤트를 선택합니다.
5. 첨부 파일을 포함하려면 첨부 파일 유형을 선택한 다음 **설정(Settings)**을 클릭하여 형식을 지정합니다.



1733-137

6. 최대 메시지 제한 및 전자 우편 크기를 설정합니다. 최대 메시지 제한에 도달하면 **재설정(Reset)**을 클릭하여 이벤트에 대해 전자 우편을 더 보내야 합니다.
7. 전자 우편 주소를 올바르게 설정했는지 확인하려면 **보내기(Send)**를 클릭하여 테스트 우편을 보냅니다.
8. 필요한 경우 **구성(Config)**을 클릭하여 전자 우편 구성 대화 상자에 액세스해 구성을 조정합니다.



1733-138

빠른 팁

- 장비 하드 드라이브에 첨부 파일을 저장하려면 최대 메시지 크기를 0으로 설정하십시오. 첨부 파일은 기본 위치인 C:\WTekScope\Screen Captures, Waveforms 또는 Data(첨부 파일 유형에 따라 달라짐)에 저장됩니다.
- 유효한 받는 사람의 전자 우편 주소 또는 SMTP 서버 주소를 입력하지 못하면 오류 메시지가 표시됩니다.

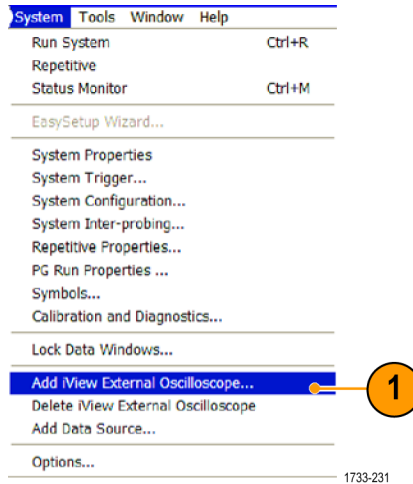
Tektronix 오실로스코프 및 로직 분석기 간의 데이터 상호 연계

거의 모든 디자인은 고속 클럭 에지와 데이터 속도를 갖춘 고속 디자인입니다. 이러한 디자인에 대해서는 회로의 복잡한 디지털 이벤트와 관련하여 고속 디지털 신호의 아날로그 특성을 확인해야 합니다. iView를 사용하면 디지털 및 아날로그 신호를 모두 확인할 수 있습니다. iView 기능을 사용하면 Tektronix 로직 분석기 및 오실로스코프의 데이터를 원활하게 통합하고 자동으로 시간 상호 연계할 수 있으므로, 마우스 클릭 한 번으로 오실로스코프의 아날로그 파형을 로직 분석기 디스플레이로 전송할 수 있습니다. 그러면 시간 상호 연계 아날로그 및 디지털 신호를 나란히 표시하여 포착하기 힘든 글리치 및 기타 문제의 원인을 분 단위로 찾아낼 수 있습니다.

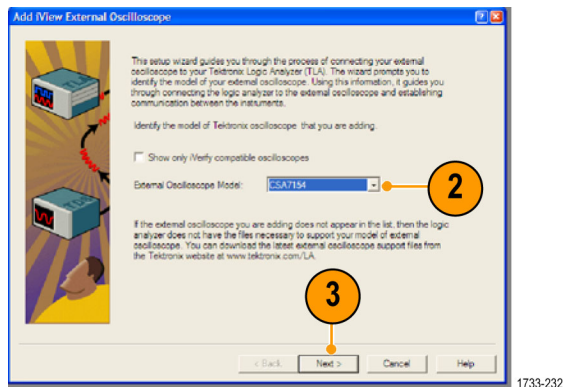
iView 외부 오실로스코프 케이블을 사용하면 로직 분석기를 Tektronix 오실로스코프에 연결할 수 있으므로 두 장비 간에 통신이 가능합니다. TLA 애플리케이션 시스템 메뉴에 제공되는 외부 오실로스코프 추가 마법사는 로직 분석기와 오실로스코프 사이에 iView 케이블을 연결하는 과정을 안내해 줍니다.

또한 오실로스코프 설정을 확인, 변경 및 테스트하는 데 도움이 되는 설정 창도 제공됩니다. 파형을 획득 및 표시하기 전에 외부 오실로스코프 추가 마법사를 사용하여 Tektronix 로직 분석기와 오실로스코프 사이의 연결을 설정해야 합니다.

1. 로직 분석기 시스템(System) 메뉴에서 **iView 외부 오실로스코프 추가...(Add iView External Oscilloscope...)**를 선택합니다.



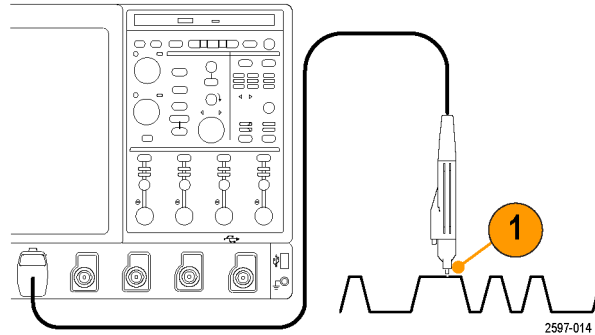
2. 오실로스코프 모델을 선택합니다.
3. 화면상의 지침을 따른 뒤 **다음 (Next)**을 클릭합니다.
4. 로직 분석기와 오실로스코프 간의 데이터 상호 연계에 대한 자세한 내용은 Tektronix 로직 분석기 설명서를 참조하십시오.



한계 테스트를 사용한 성능 확인

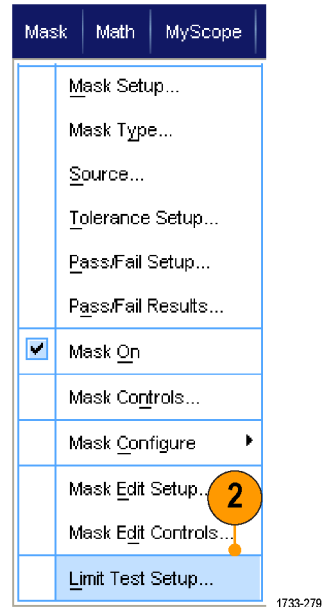
제조업 분야의 테스트 엔지니어는 제조 라인에서 제공된 제품의 성능을 알려진 양호한 기준 제품과 비교해야 하는 일이 많습니다. DUT(피검소자)로부터의 신호가 기준 제품의 사용자 정의 공차 내에 들 경우 장치는 테스트를 통과합니다. 장비에서 이 유형의 테스트를 수행하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 기준 제품에서 원하는 신호를 획득합니다.



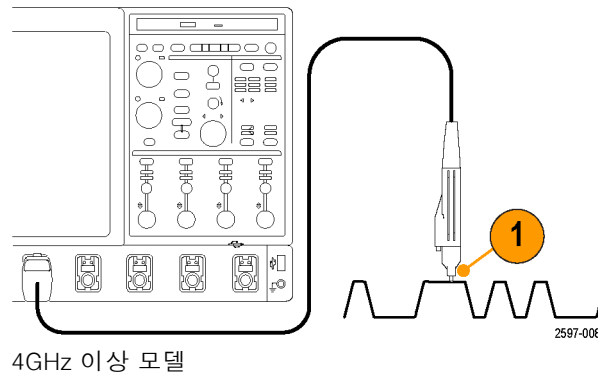
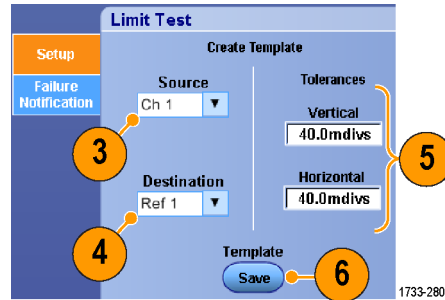
4GHz 미만 모델

2. 한계 테스트 설정...(Limit Test Setup...)을 선택합니다.

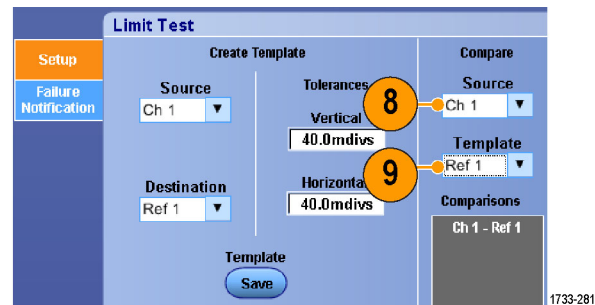


1733-279

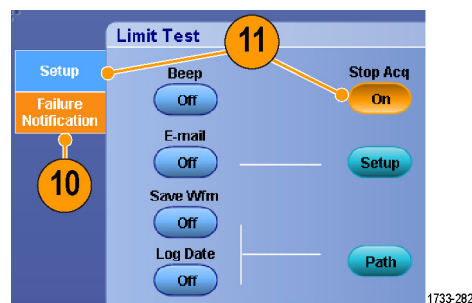
3. 소스 목록에서 알려진 양호한 기준 파형이 있는 채널을 선택합니다.
4. 대상 목록에서 템플릿을 저장할 위치를 선택합니다.
5. 수직 및 수평 공차를 입력하여 템플릿을 기준으로 한 DUT의 변이 정도를 지정합니다.
6. **저장(Save)**을 클릭합니다. 알려진 양호한 기준의 스냅샷인 템플릿이 지정된 공차가 설정된 채로 만들어집니다. 저장(Save)을 클릭하면 템플릿이 자동으로 활성화됩니다.
7. 기준 제품에서 DUT로 프로브를 이동합니다.



8. DUT에 연결된 소스 채널을 선택합니다.
9. 4 단계에서 저장한 템플릿을 선택합니다.

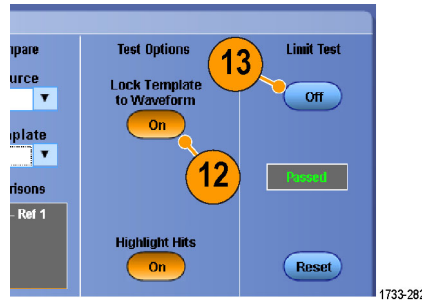


10. **실패 알림(Failure Notification)**을 클릭하여 실패 알림을 설정합니다.
11. 이 예에서는 획득 정지(Stop Acq) **켜기(On)**를 클릭한 다음 **설정(Setup)**을 클릭하여 설정 제어 창으로 돌아갑니다.



12. 템플릿을 파형에 잠금 (Lock Template to Waveform) **켜기 (On)** 및 적중수 강조 표시(Highlight Hits) **켜기(On)**를 클릭합니다.

13. 한계 테스트(Limit Test)를 **켜기 (On)**로 전환하여 테스트를 시작합니다.



파형이 템플릿과 일치하는 데 실패할 때까지 장비는 획득한 모든 파형을 템플릿과 비교합니다. 실패가 발생하면 획득이 정지되고 위반 항목이 디스플레이에 다른 색으로 표시됩니다. 다음 예는 맨 위에 Ch 1을 표시하므로 사용자는 Ch 1, 템플릿 및 적중수를 볼 수 있습니다.



청소

다음 절차에 따라 장비를 청소하십시오. 추가적인 청소가 필요한 경우 전문 서비스 담당자에게 요청하십시오.

외부 청소

보풀 없는 마른 천이나 부드러운 솔 브러시를 사용하여 새시의 외부 표면을 청소합니다. 그래도 지저분한 경우 75% 이소프로필 알코올 세정제를 적신 천이나 면봉을 사용합니다. 면봉을 사용하여 컨트롤 및 커넥터 주위의 좁은 틈을 닦아냅니다. 새시의 어떤 부분에도 합성 마모제를 사용하지 마십시오.

젖은 수건을 사용하여 켜기/대기(On/Standby) 스위치를 닦아냅니다. 스위치에 직접 물을 뿌리거나 적시지 마십시오.



주의. 부적절한 세척제나 기타 청소 방법을 사용하거나 과도한 힘을 주면 장비가 손상될 수 있습니다. 이 오실로스코프에 사용된 플라스틱을 손상시킬 수 있는 화학 세척제를 사용하지 마십시오. 전면 패널 버튼을 청소할 때는 탈이온수만 사용합니다. 탈이온수와 함께 75% 이소프로필 알코올 세정제를 클리너 및 린스로 사용합니다. 다른 유형의 클리너를 사용하려면 먼저 Tektronix 서비스 센터나 담당자에게 문의하십시오.

외부 청소 도중 장비 안에 물기가 들어가지 않도록 천이나 면봉을 적실 정도의 용액만 사용하십시오.

색인

ENGLISH TERMS

CAN, 132
 CAN 트리거
 정의됨, 52
 DSP 대역폭 향상, 36
 FastFrame, 40
 프레임 검색기, 43
 Hi Res 획득 모드, 31
 I2C, 132
 무한대 지속 (Infinite persistence), 60
 샘플 강조 (Intensified samples)
 파형을 다음으로 표시, 59
 Inter-IC 컨트롤 트리거
 정의됨, 52
 iView, 137
 연산
 파형, 94
 연산
 색, 68
 MultiScope 트리거, 44
 MultiView Zoom, 69
 MyScope
 사용, 110
 새 제어창, 106
 편집, 111
 OpenChoice
 예제, 130
 Pinpoint 트리거 선택, 51
 Pinpoint 트리거, 48
 RS-232 트리거
 정의됨, 52
 Sin(x)/x 보간, 63
 SPI, 132
 SPI 트리거
 정의됨, 52
 TekLink, 44
 변수 지속 (Variable persistence), 60
 고속 획득/WfmDB 팔레트, 67
 X-Y 디스플레이 형식, 62
 X-Y-Z 디스플레이 형식, 62
 Y-T 디스플레이 형식, 62

ㄱ

강제 트리거, 48
 검색, 74, 76
 게이트 폭 및 해상도 대역폭, 100
 게이팅, 87
 격자 계수선 유형, 65
 계수선 유형, 65
 고속 획득, 35, 127
 관련 설명서, xiii
 교정, 23
 글리치
 트리거링 켜기, 49
 포착, 31, 35, 127
 글리치 트리거
 정의됨, 51
 기본 설정, 26
 기준 레벨, 90
 기준 색, 68
 기타 측정, 85

ㄴ

날짜 및 시간, 66
 내보내기 *를 참조하십시오* 저장
 네트워크 연결, 8

ㄷ

다중 확대 영역, 70
 단일 순서, 33
 대역폭 제한, 39
 대역폭 향상, 36
 도움말, 19
 도트
 파형 레코드 포인트를 다음으로 표시, 59
 디스플레이
 색, 68
 오브젝트, 66
 지속, 60
 형태, 59
 디스플레이 맵, 16
 디스플레이 원격, 8

ㄹ

라벨, 63
 랜덤 노이즈, 31
 런트 트리거
 정의됨, 51
 레코드 보기 팔레트, 67
 로직 분석기
 데이터 상호 연계, 137
 롤 모드, 39
 롤 모드 상호 작용, 40

ㄴ

마스크
 자동 맞춤, 101
 자동 설정, 101, 103
 통과/실패 테스트, 102
 한도 공차, 102
 마스크 테스트, 100
 마지막 자동 설정 실행 취소, 27
 메뉴, 20
 모노 녹색 컬러 팔레트, 67
 모노 회색 컬러 팔레트, 67

ㅁ

바로 가기 메뉴, 20
 방법
 파형 검색 및 표시 추가, 74
 버스, 132
 버튼
 표시 설정/지우기, 75
 벡터
 파형을 다음으로 표시, 59
 변이 트리거
 정의됨, 51
 보간, 30, 63
 보통 컬러 팔레트, 67
 보통 트리거 모드, 48
 복사, 121
 비디오
 라인, 134
 비디오 트리거, 133
 정의됨, 52

人

사양

- 작동, 2
- 전력 공급기, 5
- 사용자가 지정할 수 있는 컬러 팔레트, 68
- 사용자 기본 설정, 27
- 사용자 표시, 74
- 사전 정의된 스펙트럼 연산 수식, 97
- 사전 정의된 연산 수식, 94
- 사전 트리거, 48, 49
- 사후 트리거, 48, 49
- 상태 트리거
 - 정의됨, 52
- 샘플링
 - 동등 시간, 29
 - 보간된 실시간, 29
 - 실시간, 28
- 샘플링 프로세스
 - 정의됨, 28
- 샘플 획득 모드, 31
- 선형 보간, 63
- 설명서, xiii
- 세그먼트화된 메모리, 40
- 셋업 및 홀드 트리거
 - 정의됨, 52
- 소프트웨어
 - 옵션, 125
- 수신 검사, 21
- 수직 막대 커서, 91
- 수직 위치, 26
- 수직 위치 및 자동 설정, 27
- 수평 마커, 70
- 수평 막대 커서, 91
- 수평 스케일
 - 및 math 파형, 97
- 수평 위치
 - 및 math 파형, 97
 - 정의됨, 26
- 수평 지연, 57
- 순차적 트리거링, 54
- 스냅샷, 88
- 스펙트럼 그레이딩 컬러 팔레트, 67
- 스펙트럼 분석, 97
- 스펙트럼 연산 수식
 - 고급, 98
- 시간 소인, 42
 - 정의됨, 40

- 시간 측정, 84
- 신호 입력, 25
- 십자선 모드 계수선 유형, 65

○

- 안전 사항 요약, v
- 애플리케이션 소프트웨어, 125
- 액세서리, 1
- 에지 트리거
 - 정의됨, 51
- 엔벨로프 획득 모드, 31
- 연산
 - 임의 필터, 96
- 연산
 - 편집기, 95
- 오른쪽 클릭 메뉴, 20
- 오버레이 프레임, 42
- 오브젝트
 - 표시, 66
- 온도 그레이딩 컬러 팔레트, 67
- 온라인 도움말, 19
- 외부 청소, 141
- 원격 디스플레이, 8
- 이벤트 시 전자 우편 설정, 135
- 이중 모니터, 9
- 인쇄, 123
- 인터페이스 맵, 16

ㄸ

- 자동 설정, 27
- 자동 설정 실행 취소, 27
- 자동 스크롤, 71, 73
- 자동 트리거 모드, 48
- 작동 사양, 2
- 장비 설정
 - 저장, 117
 - 호출, 118
- 저장
 - 설정, 117
 - 전자 우편 첨부 파일, 136
 - 측정값, 119
 - 파형, 114
 - 화면 포착, 113
- 전력 공급기, 5
- 전면 패널 맵, 13

- 전원 끄기, 7
- 전원 켜기, 5
- 전체 계수선 유형, 65
- 제어판, 13
- 제어판 맵, 18
- 주 트리거, 49, 54
- 준비 상태 라이트, 53
- 준비 완료 상태 라이트, 53
- 줌, 69
- 지속
 - 디스플레이, 60
- 지연된 트리거, 49, 54
- 직렬, 132
- 직렬 마스크 테스트, 100
- 진단, 21
- 진폭 측정, 84

ㄹ

- 창 트리거
 - 정의됨, 51
- 청소, 141
- 측면 패널 맵, 14
- 측정값, 82
 - 기준 레벨, 90
 - 사용자 정의, 86
 - 스냅샷, 88
 - 저장, 119
 - 정밀도, 28
 - 정의됨, 84
 - 주석, 88
 - 커서, 90
 - 통계, 87

ㄱ

- 커서 측정, 90
- 커플링
 - 트리거, 49
- 컬러 팔레트, 67

ㅍ

- 타임아웃 트리거
 - 정의됨, 51
- 통계, 87
- 통신
 - 측정값, 86
 - 트리거, 정의됨, 52

트리거

- MultiScope 트리거, 44
- 강제, 48
- 개념, 48
- 기울기, 49
- 레벨, 49
- 모드, 48
- 사전 트리거, 48, 49
- 사후 트리거, 48, 49
- 상태, 53
- 직렬, 132
- 커플링, 49
- 판독값, 53
- 홀드오프, 48
- 트리거 레벨 마커, 66
- 트리거 상태 라이트, 53
- 트리거 시 전자 우편, 57
- 트리거 위치, 56
- 트리거 유형
 - 정의됨, 51
- 트리거 유형 선택, 50
- 트리거 이벤트
 - 정의됨, 48

표

파형

- 검색 및 표시, 74
- 사용자 표시, 74
- 저장, 114
- 호출, 116
- 화면 형태, 59

파형 데이터베이스 획득 모

- 드, 31
- 파형 레코드
 - 정의됨, 30
- 파형
 - 커서를, 91
- 판독값
 - 트리거, 53
- 패턴 잠금 트리거, 52
- 패턴 트리거
 - 정의됨, 52
- 평균 획득 모드, 31
- 폭 트리거
 - 정의됨, 51
- 표시, 74, 76
- 표시 설정/지우기 버튼, 75
- 프레임 계수선 유형, 65
- 프로브
 - 교정, 28
 - 보정, 28
 - 지연시간 보정, 28
- 픽크 검출 획득 모드, 31
- 필터링 추가
 - 사용자 정의 가능, 96

응

- 하드 카피, 123
- 한계 테스트, 104
 - 예제, 138
- 향상된 대역폭, 36

호출

- 설정, 118
- 파형, 116
- 화면 문자, 63
- 화면 샷
 - 저장, 113
- 화면 커서, 91
- 확대 계수선 크기, 69
- 확대된 파형 스크롤, 71, 73
- 확대된 파형 잠금, 71, 73
- 확장 데스크톱, 9, 130
- 획득
 - 샘플링, 28
 - 입력 채널 및 디지털이
 - 저, 28
- 획득 모드
 - 변경, 32
 - 정의됨, 31
- 획득 시작, 33
- 획득 정지, 33
- 후면 패널 맵, 14
- 히스토그램 설정, 93
- 히스토그램 측정, 85